



上海合晶硅材料股份有限公司

2026 年度第一期科技创新债券募集说明书

发行人	上海合晶硅材料股份有限公司
注册金额	6 亿元
本期发行基础品种	中期票据
本期基础发行金额	人民币 0 亿元
本期发行金额上限	人民币 2 亿元
期限	3 年
担保情况	无
主承销商	中信证券股份有限公司
存续期管理机构	中信证券股份有限公司
信用评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
主体信用等级	AA+
债券信用等级	无

主承销商/簿记管理人/存续期管理机构



(住所: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)

二〇二六年八月

声明与承诺

本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的投资风险。

董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。

本募集说明书索引内容,投资人可通过规定的信息披露渠道查阅《上海合晶硅材料股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券募集说明书》、存续期信息披露等文件,相关文件链接已在对应章节进行披露。索引内容也是募集说明书的组成部分,企业、中介机构及相关人员应当对其承担相应的法律责任。

截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。

目录

声明与承诺	2
目录	4
重要提示	8
一、发行人主体提示	8
二、发行条款提示	10
三、投资人保护机制相关提示	10
四、科技创新债券相关提示	12
第一章 释义	14
一、常用名词释义	14
二、专业术语	15
第二章 风险提示及说明	19
一、与本期债务融资工具相关的风险	19
二、与发行人相关的风险	19
第三章 发行条款	28
一、主要发行条款	28
二、发行安排	29
第四章 募集资金运用	32
一、募集资金的使用	32
二、募集资金的管理	33
三、发行人承诺	34
四、偿债保障措施	35
五、本次发行符合科技创新债券的情况说明	37
第五章 企业基本情况	38
一、发行人概况	38
二、发行人历史沿革	38
三、发行人股权结构及实际控制人	42
四、发行人独立性情况	46
五、发行人重要权益投资情况	47
六、发行人公司治理和内部控制制度	50

七、企业人员基本情况	60
八、发行人主营业务情况	65
九、发行人主要在建工程及拟建工程	72
十、发行人发展战略	73
十一、行业状况	75
十二、发行人其他经营重要事项	84
第六章 企业主要财务状况.....	85
一、公司近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况.....	85
二、主要财务数据及指标分析	94
三、有息债务情况	112
四、发行人关联交易情况	114
五、发行人或有事项	117
六、公司受限资产情况	117
七、持有衍生品、重大投资理财产品情况	118
八、海外投资情况	118
九、直接债务融资计划	118
十、其他财务重要事项	119
第七章 企业资信状况	120
一、发行人及其子公司授信情况	120
二、发行人债务违约记录	120
三、发行人已发行债务融资工具偿还情况	120
第八章 债务融资工具信用增进.....	121
第九章 税项	122
一、增值税	122
二、所得税	122
三、印花税	123
四、税项抵销	123
第十章 信息披露安排.....	124
一、发行人信息披露机制	124
二、本期发行相关文件	125
三、定期财务报告披露安排	125
四、本次科技创新债券存续期内重大事项披露安排.....	126
五、本息兑付披露安排	128

六、涉及科技创新债券的专项信息披露	128
第十一章 持有人会议机制.....	130
一、会议目的与效力	130
二、会议权限与议案	130
三、会议召集人与召开情形	131
四、会议召集与召开	133
五、会议表决和决议	135
六、其他	137
第十二章 主动债务管理.....	139
一、置换	139
二、同意征集机制	139
第十三章 违约、风险情形及处置.....	144
一、违约事件	144
二、违约责任	144
三、发行人义务	144
四、发行人应急预案	145
五、风险及违约处置基本原则	145
六、处置措施	145
七、不可抗力	146
八、争议解决机制	147
九、弃权	147
第十四章 投资人保护条款.....	148
第十五章 受托管理人机制.....	149
第十六章 发行有关机构.....	150
一、发行人	150
二、主承销商及簿记管理人	150
三、存续期管理机构	150
四、登记、托管、结算机构	151
五、会计师事务所	151
六、律师事务所	151
七、信用评级机构	152
八、集中簿记建档系统	152
第十七章 备查文件	153



一、备查文件	153
二、查询地址	153
附录一 主要财务指标计算公式.....	155

重要提示

一、发行人主体提示

(一) 核心风险提示

1、经营业绩下滑的风险

报告期内，公司的营业收入分别为 134,817.37 万元、110,873.63 万元、131,134.18 万元和 28,003.21 万元，净利润分别为 24,686.10 万元、12,078.34 万元、12,534.97 万元和 1,255.06 万元，2023 年和 2024 年公司营业收入和净利润有所下滑，主要受半导体行业周期下行、市场需求疲软及竞争加剧等因素影响。2025 年度，随着半导体行业景气度回升，公司实现营业收入 131,134.18 万元，同比增长 18.27%，实现净利润 12,534.97 万元，同比增长 3.78%。2026 年 1-3 月，公司实现净利润 1,255.06 万元，同比下降 34.66%，主要受汇兑损失增加、对参股子公司投资亏损等因素所致。

公司外延片业务的主要应用领域为汽车及工业、通讯及办公，2023 年以来，以通讯及办公领域为代表的部分下游市场行业景气度出现周期性下滑。公司预计上述市场需求低迷总体属于半导体行业发展过程中的短期性波动，长期来看，随着宏观经济逐渐回暖、通讯及办公等下游市场需求逐步复苏，半导体行业将逐步走出下行周期，长期呈增长态势。公司产品需求与宏观经济及半导体行业景气度密切相关，若未来出现宏观经济形势或半导体行业景气度发生较大波动，或者行业竞争加剧，或者汽车及工业、通讯及办公等领域下游市场需求持续减少等不利变化，公司营业收入及净利润将存在下滑的风险。

2、行业竞争加剧的风险

全球半导体硅片行业市场集中度很高，主要被日本、德国、中国台湾、韩国等国家和地区的知名企业占据。国际硅片厂商长期占据较大的市场份额，相较于上述国际硅片厂商，公司规模较小。

基于下游应用市场总体需求和我国对半导体硅片行业的政策扶持，我国半导体硅片行业总体保持稳步发展，公司未来将面临国际先进企业和国内新进入者的双重竞争，目前国内主要企业积极扩产，公司未来可能面临行业产能过剩、同质化竞争的风险，公司未来可能面临市场竞争加剧的风险。

3、客户集中的风险

半导体行业为资本密集型行业，市场集中度较高。报告期各期，公司前五大客户（同一控制下合并计算口径）销售收入占当期营业收入的比例分别为 76.85%、77.99%、73.51%以及 70.88%，客户集中度相对较高。虽然公司与主要客户均建立了稳定的合作伙伴关系，但如果受到地缘政治以及国际贸易影响，或者公司下游主要客户的经营状况或业务结构发生重大变化导致其减少对公司产品的采购，或者未来公司主要客户流失且新客户开拓受阻，则将对公司经营业绩造成不利影响。

（二）情形提示

发行人近一年以来不涉及 MQ.4 表（重大资产重组）、MQ.8 表（股权委托管理）的情形。报告期内，发行人不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施的情形。发行人近一年涉及 MQ.7 表（重要事项）的情形如下：

1、发行人注册资本变动情况

2026 年 3 月 13 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《2020 年和 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的议案》《2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就暨作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。公司董事会同意按照相关规定办理 2020 年和 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权和 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属的相关事宜。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次行权及归属事宜出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA10845 号），审验了公司截至 2026 年 3 月 31 日止的新增注册资本实收情况，本次股票期权行权和限制性股票归属后公司注册资本由人民币 665,458,353 元变更为人民币 669,195,352 元，股本总数由

665,458,353 股变更为 669,195,352 股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记完毕。

二、发行条款提示

本期债务融资工具无特殊发行条款。

三、投资人保护机制相关提示

（一）关于持有人会议相关约定的提示

本募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力。

本募集说明书在“持有人会议机制”章节对持有人会议召开情形进行了分层，本期债务融资工具信用增进安排、增进机构(如有)偿付能力发生重大不利变化；发行人发行的其他债务融资工具或境内外债券的本金或利息未能按照约定按期足额兑付；发行人及合并范围内子公司拟出售、转让、划转资产或放弃其他财产，将导致发行人净资产减少单次超过上年末经审计净资产的 10%；发行人及合并范围内子公司因会计差错更正、会计政策或会计估计的重大自主变更等原因，导致发行人净资产单次减少超过 10%；发行人最近一期净资产较上年末经审计净资产减少超过 10%；发行人及合并范围内子公司发生可能导致发行人丧失其重要子公司实际控制权的情形；发行人及合并范围内子公司拟无偿划转、购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，构成重大资产重组的；发行人进行重大债务重组；发行人拟合并、分立、减资，被暂扣或者吊销许可证件等情形发生时，自事项披露之日起 15 个工作日内无人提议或提议的投资人未满足 10%的比例要求，或前期已就同一事项召开会议且相关事项未发生重大变化的，召集人可以不召集持有人会议。

本募集说明书在“持有人会议机制”章节设置了“会议有效性”的要求，按照本募集说明书约定，参会持有人持有本期债务融资工具总表决权超过 1/2，会

议方可生效。参加会议的持有人才能参与表决，因此持有人在未参会的情况下，无法行使所持份额代表的表决权。

本募集说明书在“持有人会议机制”章节设置了多数表决机制，持有人会议决议应当经参加会议持有人所持表决权超过 1/2 通过；对影响投资者重要权益的特别议案，应当经参加会议持有人所持表决权 2/3 以上，且经本期债务融资工具总表决权超过 1/2 通过。因此，在议案未经全体持有人同意而生效的情况下，部分持有人虽不同意但已受生效议案的约束，变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排；新增、变更本募集说明书中的选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制、投资人保护条款以及争议解决机制；聘请、解聘、变更受托管理人（如有）或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；除合并、分立外，向第三方转移本期债务融资工具清偿义务；变更可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的其他约定等所涉及的重要权益也存在因服从多数人意志受到不利影响的可能性。

（二）主动债务管理

在本期债务融资工具存续期内，发行人可能通过实施置换、同意征集等方式对本期债务融资工具进行主动债务管理。

【置换机制】存续期内，若将本期债务融资工具作为置换标的实施置换后，将减少本期债务融资工具的存续规模，对于未参与置换或未全部置换的持有人，存在受到不利影响的可能性。

【同意征集机制】本募集说明书在“主动债务管理”章节中约定了对投资人实体权利影响较大的同意征集结果生效条件和效力。按照本募集说明书约定，同意征集方案经持有本期债务融资工具总表决权超过 1/2 的持有人同意，本期同意征集方可生效。除法律法规另有规定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力，并产生约束发行人和持有人的效力。因此，在同意征集事项未经全部持有人同意而生效的情况下，个别持有人虽不同意但已受生效同意征集结果的约束，包括收取债务融资工具本息等自身实体权益存在因服从绝大多数人意志可能受到不利影响的可能性。

（三）违约、风险情形及处置

本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章节约定，当发行人发生风险或违约事件后，发行人可以与持有人协商采取以下风险及违约处置措施：

1. 【重组并变更登记要素】发行人和持有人或有合法授权的受托管理人（如有）可协商调整本期债务融资工具的基本偿付条款。选择召开持有人会议的，适用第【十一】章“持有人会议机制”中特别议案的表决比例。生效决议将约束本期债项下所有持有人。如约定同意征集机制的，亦可选择适用第【十二】章“主动债务管理”章节中的“同意征集机制”实施重组。

2. 【重组并以其他方式偿付】发行人和持有人可协商以其他方式偿付本期债务融资工具，需注销本期债项的，可就启动注销流程的决议提交持有人会议表决，该决议应当经参加会议持有人所持表决权【超过 1/2】通过。通过决议后，发行人应当与愿意注销的持有人签订注销协议；不愿意注销的持有人，所持债务融资工具可继续存续。

（四）投资人保护条款

本期债务融资工具未设置投资人保护条款。

四、科技创新债券相关提示

发行人属于半导体/集成电路行业，主营业务为半导体硅外延片的研发、生产和销售，且发行人于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，系上海证券交易所科创板上市公司，股票代码 688584.SH。因此，发行人符合中市协发〔2025〕86 号文件关于对科技型企业发行主体范围规定的情形 3 的相关要求。

根据《关于推出科技创新债券构建债市“科技板”的通知》（中市协发〔2025〕86 号）相关要求，为满足企业核心技术保密等要求，根据企业实际需求，可简化或豁免披露企业经营模式、重要在研项目等敏感信息。出于商业竞争敏感性考虑，以及与客户签订的保密协议约束等因素，发行人未披露供应链上下游企业



名称等涉及企业经营的具体信息,发行人承诺相关内容不会对本期债券注册发行产生不利影响。

请投资人仔细阅读相关内容,知悉相关风险。

第一章 释义

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

一、常用名词释义

发行人/公司/上海合晶	指	上海合晶硅材料股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
非金融企业债务融资工具/债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
本期发行/本次科技创新债券/本期债务融资工具	指	上海合晶硅材料股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券
人民银行	指	中国人民银行
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
北金所	指	北京金融资产交易所有限公司
簿记建档	指	发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理
簿记管理人	指	制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本次科技创新债券簿记管理人由中信证券股份有限公司担任
承销团	指	主承销商为本期发行根据承销团协议组织的，由主承销商和其他承销团成员组成的承销团
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市金杜律师事务所
信用评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
工作日	指	国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特



		别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)
元	指	人民币元
近三年及一期	指	2023 年、2024 年、2025 年和 2026 年 1-3 月

二、专业术语

合晶有限	指	上海合晶硅材料有限公司，发行人前身，曾先后用名“上海晶华电子科技有限公司”、“晶华电子材料有限公司”
STIC	指	Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.(注册于开曼群岛)，发行人控股股东
合晶科技	指	合晶科技股份有限公司(注册于中国台湾地区)，其股票在中国台湾地区证券柜台买卖中心挂牌交易
WWIC	指	Wafer Works Investment Corp.(注册于萨摩亚)，STIC 控股股东
荣冠投资	指	荣冠投资有限公司(注册于中国香港，英文名称为 Fame Crown Investment Limited)，发行人股东
美国绿捷	指	美国绿捷股份有限公司(注册于美国加利福尼亚州，英文名称为 Green Expedition LLC)，发行人股东
兴港融创	指	河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙)，发行人股东
中电中金	指	中电中金(厦门)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)，发行人股东
厦门联和	指	厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)，发行人股东
厦门联和二期	指	厦门联和二期集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)，发行人股东
厦门金创	指	厦门市金创集智创业投资合伙企业(有限合伙)，发行人股东
双百贤才	指	厦门双百贤才创业投资合伙企业(有限合伙)，发行人股东
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司，发行人股东
华虹虹芯	指	上海华虹虹芯私募基金合伙企业(有限合伙)，发行人股东
上海盛雍	指	上海盛雍国企改革新势能私募投资基金合伙企业(有限合伙)，发行人股东
瀚思博投	指	厦门瀚思博投企业管理合伙企业(有限合伙)，发行人股东
深圳众晶	指	深圳众晶投资合伙企业(有限合伙)，发行人股东

盛美上海	指	盛美半导体设备（上海）股份有限公司，发行人股东
创启开盈	指	深圳市创启开盈创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
郑州兴晶旺	指	郑州兴晶旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东
上海聚芯晶	指	上海聚芯晶企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东
上海海铸晶	指	上海海铸晶企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东
扬州芯晶阳	指	扬州市芯晶阳科技咨询服务合伙企业（有限合伙），发行人股东
郑州兴芯旺	指	郑州兴芯旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东
上海安之微	指	上海安之微企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东
上海海崧兴	指	上海海崧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东
上海晶盟	指	上海晶盟硅材料有限公司，发行人子公司
扬州合晶	指	扬州合晶科技有限公司，发行人子公司
郑州合晶	指	郑州合晶硅材料有限公司，发行人子公司
空港合晶	指	郑州空港合晶科技有限公司，发行人曾经的子公司
上海有色硅材料厂	指	上海市有色金属总公司硅材料厂，合晶有限曾经的股东
上海有色总公司	指	上海市有色金属总公司，后经批准改制并更名为上海有色金属（集团）有限公司
香港汉崧	指	汉崧国际有限公司（注册于中国香港，英文名称为 Helitek Company Limited），合晶有限曾经的股东
美国汉崧	指	美国汉崧国际有限公司（注册于美国加利福尼亚州，英文名称为 Helitek Company Ltd.），合晶有限曾经的股东
意法半导体	指	ST Microelectronics N.V.及其下属企业
威世半导体	指	Vishay Intertechnology, Inc.及其下属企业
台积电	指	台湾积体电路制造股份有限公司及其下属企业
华虹宏力	指	华虹半导体有限公司及其下属企业
力积电	指	力晶积成电子制造股份有限公司及其下属企业
华润微	指	华润微电子有限公司及其下属企业
德州仪器	指	Texas Instruments Incorporated 及其下属企业
达尔	指	Diodes Incorporated 及其下属企业
芯联集成	指	芯联集成电路制造股份有限公司
理成集团	指	自然人颜亮实际控制的公司，包括上海化学工业区理成贸易有限公司、NEW ABLE TECHNOLOGY LIMITED、上海兑捷电子科技有限公司以及上海络基科技有限公司

信越化学	指	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
日本胜高	指	Sumco Corporation
环球晶圆	指	环球晶圆股份有限公司
德国世创	指	Siltronic AG
SK Siltron	指	SK Siltron Co., Ltd.
FUJIMI	指	FUJIMI INCORPORATED 及其下属企业
ENTEGRIS	指	ENTEGRIS,INC.及其下属企业
SEMI	指	国际半导体设备与材料协会
WSTS	指	世界半导体贸易统计组织
单晶硅	指	硅的单晶体，是一种良好的半导体材料
多晶硅	指	单质硅的一种形态，可作拉制单晶硅的原料
晶棒	指	硅晶棒，是由一颗晶面取向确定的籽晶在熔融态的硅原料中逐渐生成的圆柱状的单晶硅晶棒
抛光片、衬底片	指	经过抛光工艺形成的半导体硅片，作为外延片的原材料时也被称为衬底片
外延片	指	在抛光片的基础上，经过外延工艺形成的半导体硅片
功率器件	指	用于电力设备的电能变换和控制电路方面的大功率电子器件
模拟芯片	指	对连续性模拟信号进行传输、变换、处理、放大和测量的集成电路芯片
CIS、图像传感器	指	CMOS Image Sensor，即 CMOS 图像传感器，是一种典型的固体成像传感器，可将光像转换为与光像成相应比例关系的电信号
PMIC、电源管理芯片	指	Power Management IC，电源管理集成电路，是在单片芯片内包括了多种电源轨和电源管理功能的集成电路
MOSFET	指	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，金属-氧化物半导体场效应晶体管，是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管
IGBT	指	Insulated Gate Bipolar Translator，绝缘栅双极型晶体管
IDM	指	Integrated Device Manufacture，垂直整合制造，指垂直整合制造商独自完成集成电路设计、晶圆制造、封装测试的全产业链环节
晶圆代工	指	半导体产业的一种营运模式，专门从事半导体晶圆制造生产，接受其他 IC 设计公司委托制造，自身不从事设计
5G	指	第五代移动通信技术，是最新一代蜂窝移动通信技术

mm	指	毫米，0.001 米
SPC	指	Statistical Process Control，是一种借助数理统计方法的过程控制工具
SAP 管理系统	指	Systems Applications and Products in Data Processing，又称企业管理解决方案，借助软件程序为企业定制并创建管理系统
MES 生产管理系统	指	一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统
良率	指	指产线上最终通过测试的良品数量占投入材料理论生产出的数量的比例

第二章 风险提示及说明

投资者购买本次科技创新债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本次科技创新债券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价和认购本次科技创新债券时，应特别认真的考虑下列各种风险因素：

一、与本期债务融资工具相关的风险

（一）利率风险

本期债务融资工具的利率水平是根据当前市场的利率水平和发行人信用评级由集中簿记建档确定。在本期债务融资工具存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资本期债务融资工具的收益造成一定程度的影响。

（二）流动性风险

本期债务融资工具将在银行间债券市场上进行交易流通，在转让时存在一定的交易流动性风险，公司无法保证本期债务融资工具会在银行间债券市场上有活跃的交易。

（三）偿付风险

在本期债务融资工具的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期债务融资工具按期、按时足额支付本息。

二、与发行人相关的风险

（一）财务风险

1、经营业绩下滑的风险

报告期内，公司的营业收入分别为 134,817.37 万元、110,873.63 万元、131,134.18 万元和 28,003.21 万元，净利润分别为 24,686.10 万元、12,078.34 万元、12,534.97 万元和 1,255.06 万元，2023 年和 2024 年公司营业收入和净利润有所下滑，主要受半导体行业周期下行、市场需求疲软及竞争加剧等因素影响。2025 年度，随着半导体行业景气度回升，公司实现营业收入 131,134.18 万元，同比增长 18.27%，实现净利润 12,534.97 万元，同比增长 3.78%。2026 年 1-3 月，公司实现净利润 1,255.06 万元，同比下降 34.66%，主要受汇兑损失增加、对参股子公司投资亏损等因素所致。

公司外延片业务的主要应用领域为汽车及工业、通讯及办公，2023 年以来，以通讯及办公领域为代表的部分下游市场行业景气度出现周期性下滑。公司预计上述市场需求低迷总体属于半导体行业发展过程中的短期性波动，长期来看，随着宏观经济逐渐回暖、通讯及办公等下游市场需求逐步复苏，半导体行业将逐步走出下行周期，长期呈增长态势。公司产品需求与宏观经济及半导体行业景气度密切相关，若未来出现宏观经济形势或半导体行业景气度发生较大波动，或者行业竞争加剧，或者汽车及工业、通讯及办公等领域下游市场需求持续减少等不利变化，公司营业收入及净利润将存在下滑的风险。

2、毛利率波动的风险

报告期内部分下游市场行业景气度出现周期性下滑，国内行业竞争加剧，导致公司毛利率有所波动，报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 37.60%、29.15%、29.23%以及 28.34%。未来，如果半导体行业整体情况发生重大不利变化、汽车及工业、通讯及办公等领域下游客户需求减弱、主要原材料价格大幅上涨、产能扩张导致折旧费用大幅增加，以及其他重大不利情况发生，可能导致公司在未来一定时期内面临毛利率波动的风险。

3、存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值为 34,073.44 万元、31,526.32 万元、34,374.16 万元和 36,514.36 万元，占流动资产比例为 33.76%、17.01%、25.25%和 27.73%。公司存货由原材料、自制半成品、库存商品、在产品、周转材料、

委托加工物资构成。截至 2026 年 3 月 31 日，公司存货跌价准备金额为 2,251.63 万元。若未来半导体硅外延片市场景气度进一步下降、市场价格下跌，则公司可能面临存货跌价的风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

4、汇率波动风险

公司部分半导体硅外延片产品销往境外，同时部分原材料和生产设备从境外采购，上述交易主要使用美元等外币交易，导致因汇率波动产生的汇兑损益。报告期内，公司汇兑损益分别为-680.78 万元、-1,245.85 万元、492.10 万元和 479.39 万元，对公司业绩影响较小。但若未来人民币兑美元等外币汇率波动幅度扩大，可能导致公司产生金额较大的汇兑损益，进而影响公司财务状况。

5、未来资本支出较大及未来项目收益不确定的风险

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-36,477.83 万元、-32,753.02 万元、-120,469.10 万元和-13,064.26 万元，持续为负，主要系公司为提升产品技术及扩充产能持续投资建设厂房及厂务设施、购置研发及生产设备等长期资产，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出的现金规模相对较大。公司所处的行业技术更新迭代快、资金投入大、研发周期长，属于典型的资本密集型行业，固定资产投资的需求较高、研发及生产设备购置成本高。公司面临一定的资本支出压力，且所投建的项目存在未来项目收益不确定的风险，若未来公司融资渠道不畅或不能合理控制成本，可能对公司的盈利能力和偿债能力造成一定的不利影响。

6、资产抵押风险

截至 2025 年末，公司受限资产共计 29,787.28 万元，受限资产合计占总资产的比例为 6.06%，占净资产的比例为 7.21%。截至 2026 年 3 月末，公司已获得 180,000.00 万元额度的银团贷款，已使用额度 48,000.00 万元，为获取该银团贷款已抵押担保受限资产账面价值为 28,592.09 万元。未来在“12 英寸半导体大硅片产业化项目”厂房建成后，郑州合晶将以其依法拥有的全部厂房不动产权和“12 英寸半导体大硅片产业化项目”购置的机器设备为该银团贷款提供抵押担保。上述抵押不会给公司正常经营活动造成重大不利影响，不影响公司的收入和经营性

现金流，但在一定程度上限制公司进一步获取银行授信额度，从而降低其间接融资能力。此外，如果公司不能及时偿还借款，银行将可能采取强制措施对上述资产进行处置，从而可能对公司正常生产经营造成风险。

(二) 经营风险

1、宏观经济及行业景气度波动的风险

公司位于半导体产业链上游，所生产的半导体硅外延片主要用于制备功率器件及模拟芯片等半导体产品，相关产品被广泛应用于汽车、工业、通讯、办公等领域。公司产品需求受到半导体产业链下游行业及终端应用市场的影响，与宏观经济及半导体行业景气度密切相关。若未来宏观经济形势或半导体行业景气度发生较大波动，将对公司产品需求和经营业绩产生不利影响。

2、行业竞争加剧的风险

全球半导体硅片行业市场集中度很高，主要被日本、德国、中国台湾、韩国等国家和地区的知名企业占据。国际硅片厂商长期占据较大的市场份额，相较于上述国际硅片厂商，公司规模较小。

基于下游应用市场总体需求和我国对半导体硅片行业的政策扶持，我国半导体硅片行业总体保持稳步发展，公司未来将面临国际先进企业和国内新进入者的双重竞争，目前国内主要企业积极扩产，公司未来可能面临行业产能过剩、同质化竞争的风险，公司未来可能面临市场竞争加剧的风险。

3、外延片产品主要集中于 8 英寸的风险

公司专注于外延片领域，现有外延片产品覆盖 6 英寸、8 英寸及 12 英寸等不同尺寸。报告期内，公司外延片产品主要集中于 8 英寸，12 英寸次之。公司所处的超越摩尔定律方向包括功率器件、模拟芯片、传感器等细分市场，尽管目前下游客户端主要使用 8 英寸外延片，并且短期内下游市场对于 8 英寸外延片产品的需求相对稳定，但随着国内外先进厂商在制造功率器件等芯片产品时逐步开始使用 12 英寸外延片，同时部分国内外硅片厂商已具备 12 英寸外延片产能，尽

管目前公司已经具备 12 英寸外延片生产能力，但若未来公司未能顺利实现 12 英寸外延片的大规模化生产及销售，将对公司经营业绩产生不利影响。

4、12 英寸硅片项目的风险

由于公司 12 英寸大硅片项目前期投入资金较大，产线建设、产能爬坡和稳定量产需要一定的周期，加之下游客户认证的时间较长，导致公司最近一年及一期 12 英寸外延片产线产能利用率不足 50%，如果未来 12 英寸硅片产品针对下游客户所需新产品研发和量产导入进度不及预期、下游客户需求及订单不及预期等，可能对公司 12 英寸硅片产能消化造成不利影响、导致公司 12 英寸项目不具有经济规模的产能利用率、以及 12 英寸硅片项目出现较大的经营亏损，将对公司的产业布局 and 经营业绩造成不利影响。

5、原材料价格波动及供应风险

公司生产用的主要原材料包括抛光片、多晶硅、石墨备品、气体、粉体、石英坩埚等。若原材料价格出现波动，导致公司原材料采购成本上升，将对公司的业绩产生不利影响。此外，若公司的主要供应商交付能力下降，公司原材料供应的稳定性、及时性和价格均可能发生不利变化，进而对公司的生产经营造成不利影响。

6、客户集中的风险

半导体行业为资本密集型行业，市场集中度较高。报告期各期，公司前五大客户（同一控制下合并计算口径）销售收入占当期营业收入的比例分别为 76.85%、77.99%、73.51%以及 70.88%，客户集中度相对较高。虽然公司与主要客户均建立了稳定的合作伙伴关系，但如果受到地缘政治以及国际贸易影响，或者公司下游主要客户的经营状况或业务结构发生重大变化导致其减少对公司产品的采购，或者未来公司主要客户流失且新客户开拓受阻，则将对公司经营业绩造成不利影响。

7、技术研发风险

半导体硅片行业属于技术密集型行业，具有研发投入高、研发周期长、研发风险大等特点。随着下游半导体芯片技术水平和性能指标的不断升级，对半导体

硅外延片的技术水平和性能要求也不断提升。公司是我国较早实现大尺寸半导体硅外延片技术突破及规模化生产的企业，相关技术达到了国内领先水平，但与国际硅片厂商在工艺制程等方面仍存在一定差距。若公司不能持续保持研发投入，或者未能持续实现关键技术突破，或者新产品开发未能满足下游客户需求，将导致公司与国际硅片厂商差距扩大，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

8、境外收入占比较高的风险

2023 年度至 2025 年度，公司主营业务收入中境外收入的金额分别为 114,159.67 万元、94,690.22 万元和 111,488.91 万元，占比较高。境外客户主要地区包括中国台湾、欧洲、美国等国家和地区。如果未来出现国际贸易环境继续恶化、关税壁垒继续增加、汇率出现大幅度波动等不利情形，上述境外客户可能会减少向公司采购相关产品或服务，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。

9、募集资金投资项目风险

本次募集资金投资项目为 12 英寸半导体大硅片产业化项目。募集资金投资项目是经过公司慎重、充分的可行性研究论证，并基于当前市场环境、技术发展趋势等因素所作出的规划。由于募集资金投资项目从论证、资金到位到项目建设完成的周期较长，并且项目实施与未来整体经济形势、行业竞争情况、市场供求状况、技术进步等因素密切相关。如果未来募集资金投资项目受上述因素影响未能按照计划顺利实施，公司则可能面临无法按既定计划实现预期收益的风险。

另外，本次募集资金拟投资项目投资总额约为 25.75 亿元，规模较大，回款较慢，募投项目实施后公司固定资产规模将大幅增加，并相应导致未来折旧摊销金额增长，预计每年新增折旧摊销 22,685.90 万元。在募集资金投资项目建设完成后，若因研发项目失败、研发项目进度不及预期等因素导致项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，可能导致募集资金投资项目回收周期进一步延长，并且新增固定资产折旧和摊销将加大公司经营风险，进而对公司经营业绩造成不利影响。

10、海外资产及业务经营的风险

2023 年度至 2025 年度,公司境外资产分别为 24.26 万元、168.55 万元和 62.31 万元, 占总资产的比例为 0.01%、0.04%和 0.01%, 资产规模及占比较低。公司部分客户以及原辅材料、设备供应商位于境外地区, 包括中国台湾、欧洲、美国、日本等国家和地区。近年来国际贸易环境有所恶化, 如果未来美国或其他国家(地区)出于贸易保护或地缘政治风险等原因, 与我国贸易摩擦持续升级, 通过贸易政策、关税、进出口限制等方式构建贸易壁垒, 公司可能面临无法和受限的上下游合作伙伴继续合作等风险, 从而对公司海外资产及经营发展产生一定的不利影响。

(三) 管理风险

1、控股股东控制的风险

截至 2026 年 3 月末, 公司控股股东 STIC 持有公司 48.03%的股份, STIC 系一家投资控股平台公司, 由中国台湾地区证券柜台买卖中心上柜公司合晶科技通过全资子公司 WWIC 间接持有其 89.26%的权益。

虽然公司已建立起旨在保护全体股东利益的法人治理结构, 制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、对外投资、对外担保等相关重大事项管理制度, 但如果控股股东利用其控股地位, 通过董事会、股东会对公司的经营、财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响, 可能会给公司及中小股东带来利益受损的风险。

此外, 合晶科技股票自 2002 年起在中国台湾地区证券柜台买卖中心挂牌交易。由于合晶科技股权较为分散, 其控制权可能因被收购等原因而发生变化, 进而可能会对公司业务发展方向和经营管理产生不利影响。

2、有控股股东但无实际控制人的风险

截至 2026 年 3 月末, STIC 直接持有发行人 48.03%的股份, 系发行人的直接控股股东。合晶科技通过 WWIC 持有 STIC 89.26%的权益, 系发行人的间接控股股东。

合晶科技的股权结构较为分散，结合合晶科技的公司章程、董事高管提名及任命情况、最近三年股东会、董事会、审计委员会运行及重大事项表决结果、内部治理结构及日常经营管理决策，合晶科技不存在实际控制人，因此发行人不存在实际控制人。

上述情况可能导致发行人生产经营存在潜在风险，比如在发行人需要迅速做出重大经营和投资决策时，较为分散的股权结构可能影响决策效率，导致发行人贻误发展机遇，进而造成经营业绩波动。此外，合晶科技股权分散也可能增加未来发行人控制权发生变动的潜在风险，可能影响经营决策的稳定性和连续性。

3、关联交易的风险

报告期内，公司与合晶科技及其他关联方之间存在关联交易。关联采购方面，公司主要向关联方采购衬底片等原材料。关联销售方面，公司主要向关联方提供硅材料加工服务。

公司预计未来仍将存在一定的关联交易，若公司未能严格执行相关的内控制度和关联交易管理制度，无法有效控制关联交易规模，或上述关联交易定价不公允或不合理，或者未能履行关联交易决策、审批程序，则存在关联交易损害公司或中小股东利益的风险。

（四）政策风险

1、国际贸易争端加剧风险

公司部分客户以及原辅材料、设备供应商位于境外地区，包括中国台湾、欧洲、美国、日本等国家和地区。近年来国际贸易环境有所恶化，如果未来美国或其他国家（地区）出于贸易保护或地缘政治风险等原因，与我国贸易摩擦持续升级，通过贸易政策、关税、进出口限制等方式构建贸易壁垒，公司可能面临无法和受限的上下游合作伙伴继续合作等风险，从而对公司经营发展产生一定的不利影响。

2、税收优惠风险

公司主要全资子公司享受高新技术企业所得税的税收优惠、研发费用加计扣除和出口退税。若未来国家相关税收优惠政策发生变化，或公司主要子公司无法继续取得高新技术企业资质，或国家出口退税政策发生变化，则可能导致公司无法继续享受高新技术企业所得税的税收优惠政策和出口退税政策，对公司的经营业绩产生不利影响。

第三章 发行条款

一、主要发行条款

债务融资工具名称:	上海合晶硅材料股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券
发行人全称:	上海合晶硅材料股份有限公司
主承销商:	中信证券股份有限公司
簿记管理人:	中信证券股份有限公司
存续期管理机构:	中信证券股份有限公司
发行人待偿还债务融资余额:	截至本募集说明书签署日, 发行人及下属子公司无待偿还债券
《接受注册通知书》文号:	中市协注〔2026〕MTN 380 号
注册金额:	人民币 6 亿元 (RMB 600,000,000.00 元)
本期基础发行金额:	人民币 0 亿元
本期发行金额上限:	人民币 2 亿元 (RMB 200,000,000.00 元)
本期发行期限:	3 年期
计息年度天数:	非闰年 365 天, 闰年 366 天
面值:	人民币壹佰元 (RMB100.00 元)
发行价格:	按面值发行
利率确定方式:	采用固定利率方式, 发行利率通过集中簿记建档方式确定
发行对象:	全国银行间债券市场机构投资者 (国家法律、法规禁止的投资者除外)
发行方式:	通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行
托管形式:	实名记账式
票面利率:	票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况, 协商一致后确定
承销方式:	主承销商以余额包销的方式承销本期科技创新债券
公告日期:	2026 年 8 月 24 日
发行日期:	2026 年 8 月 26 日
起息日期:	2026 年 8 月 27 日
缴款日:	2026 年 8 月 27 日
债权债务登记日:	2026 年 8 月 27 日
上市流通日:	2026 年 8 月 28 日

付息日:	在债务融资工具存续期内,每年的 8 月 27 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间不另计息)
付息兑付方式:	采用单利按年付息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金兑付一起支付
兑付价格:	按面值兑付
兑付日期:	2029 年 8 月 27 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间兑付款项不另计息)
兑付方式:	到期日前 5 个工作日,由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》,并在到期日按面值加利息兑付,由上海清算所代理完成兑付工作
偿付顺序:	本期债务融资工具在破产清算时的清偿顺序等同于发行人的普通债务
担保情况及其他增信措施:	无
信用评级机构及信用评级结果:	上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予发行人的主体信用级别为 AA+, 评级展望为稳定,本期科技创新债券无债项评级。引用自上海新世纪资信评估投资服务有限公司《上海合晶硅材料股份有限公司信用评级报告》,本次引用已经上海新世纪资信评估投资服务有限公司书面确认
登记和托管机构:	银行间市场清算所股份有限公司
集中簿记建档系统技术支持机构:	北京金融资产交易所有限公司
税务提示:	根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期科技创新债券所应缴纳的税款由投资者承担
适用法律:	本期债务融资工具的所有法律条款均适用中华人民共和国法律

二、发行安排

(一) 集中簿记建档安排

1、本期科技创新债券的簿记管理人为中信证券股份有限公司,本期科技创新债券承销团成员须在发行日,通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《上海合晶硅材料股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券申购要约》(以下简称“《申购要约》”),申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。

2、每一承销团成员申购金额的下限为 1,000 万元（含 1,000 万元），申购金额超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。

3、本期科技创新债券的申购期间为 2026 年 8 月 26 日 14:00 至 2026 年 8 月 26 日 18:00。本期科技创新债券簿记建档截止时间不得晚于簿记截止日 18:00。簿记建档时间经披露后，原则上不得调整。如遇不可抗力、技术故障，经发行人与簿记管理人协商一致，可延长一次簿记建档截止时间，延长时长应不低于 30 分钟，延长后的簿记建档截止时间不得晚于 18:30。若发行主体是民营企业，可根据实际情况申请将最晚截标时间延长至当日 20 时。

（二）分销安排

1、认购本期债务融资工具的投资者应为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的从其规定）。

2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。

（三）缴款和结算安排

1、缴款时间：2026 年 8 月 27 日 16:00 前。

2、簿记管理人将在 2026 年 8 月 27 日通过集中簿记建档系统发送《上海合晶硅材料股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。

3、合格的承销商应于缴款日 16:00 前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：

户名：中信证券股份有限公司

账号：7116810187000000121

开户行：中信银行北京瑞城中心支行

人行支付系统号：302100011681

如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。

4、本期科技创新债券发行结束后，科技创新债券认购人可按照有关主管机构的规定进行科技创新债券的转让、质押。

（四）登记托管安排

本期科技创新债券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期科技创新债券的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期科技创新债券进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。

（五）上市流通安排

在科技创新债券债权登记日的次一工作日，本期债务融资工具即可在全国银行间债券市场按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行流通转让。

（六）其他

无。

第四章 募集资金运用

一、募集资金的使用

本次募集资金注册金额为 6.00 亿元，拟用于 12 英寸半导体大硅片产业化项目。具体情况如下：

单位：亿元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投资金额	占比
1	12 英寸半导体大硅片产业化项目	25.75	6.00	100.00%
合计			6.00	100.00%

本期债务融资工具基础发行规模 0 亿元，发行规模上限 2.00 亿元，拟用于 12 英寸半导体大硅片产业化项目。具体情况如下：

单位：亿元

序号	项目名称	项目投资总额	本期债务融资工具募集资金拟投资金额	占比
1	12 英寸半导体大硅片产业化项目	25.75	2.00	100.00%
合计			2.00	100.00%

（一）主要建设内容

12 英寸半导体大硅片产业化项目投资总额为 25.75 亿元，投资建设内容主要包括厂务设施、生产设备（含长晶设备、切片设备、倒角设备、研磨设备、清洗机、背面处理设备、抛光设备、测试设备、外延设备）及其相关配套设施等。

（二）项目合法合规性

截至本募集说明书签署日，12 英寸半导体大硅片产业化项目已完成发改委备案（项目代码：2311-410173-04-01-812151），并已取得环评批复（郑港环审[2024]8 号），上述项目已取得土地使用权证书。

（三）项目实施主体和建设进度

12 英寸半导体大硅片产业化项目实施主体为发行人全资子公司郑州合晶。截至本募集说明书签署日，上述项目已按计划进行厂务设施、生产设备等投资建设。截至 2026 年 3 月末，12 英寸半导体大硅片产业化项目按计划正常建设，自有资本金 78,343.00 万元已到位 32,500.00 万元。

二、募集资金的管理

对于本次科技创新债券的募集资金，发行人将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金。募集资金用途不违反国家相关产业政策和法律规定。对于本次科技创新债券的募集资金，发行人将按照中国银行间市场交易商协会关于科技创新债券募集资金使用有关规定、公司内部的财务制度，对募集资金进行专项管理，确保募集资金的合理有效使用。

本次科技创新债券采取资金监管模式，发行人上海合晶分别于兴业银行股份有限公司上海松江支行、中信银行股份有限公司上海分行处开立账户，并与上述两家银行分别签订资金监管协议；发行人全资子公司郑州合晶分别于中国银行股份有限公司郑州航空港分行、中国建设银行股份有限公司郑州台湾科技园支行处开立账户，并与上述两家银行分别签订资金监管协议，确保募集资金按规定用途使用。

上述监管账户信息如下：

账户名称 1：上海合晶硅材料股份有限公司

开户行 1：兴业银行股份有限公司上海松江支行

账号 1：216310100100325198

大额支付行号 1：309290000279

账户名称 2：上海合晶硅材料股份有限公司

开户行 2：中信银行股份有限公司上海分行营业部

账号 2：8110201012302030245

大额支付行号 2: 302290031106

账户名称 3: 郑州合晶硅材料有限公司

开户行 3: 中国银行股份有限公司郑州新港大道支行

账号 3: 254702270062

大额支付行号 3: 104491068218

账户名称 4: 郑州合晶硅材料有限公司

开户行 4: 中国建设银行股份有限公司郑州台湾科技园支行

账号 4: 41050110247900002760

大额支付行号 4: 105491001898

三、发行人承诺

发行人属于半导体/集成电路行业，主营业务为半导体硅外延片的研发、生产和销售，且发行人于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，系上海证券交易所科创板上市公司，股票代码 688584.SH。因此，发行人符合中市协发〔2025〕86 号文件关于对科技型企业发行主体范围规定的情形 3 的相关要求。

发行人 2024 年度及 2025 年度研发投入金额分别为 9,992.77 万元及 11,421.39 万元，占当期营业收入的比例分别为 9.01%及 8.71%，上述两年平均研发投入强度为 8.86%，符合中市协发〔2026〕40 号文件关于科技型企业研发投入相关要求。

为了充分、有效的维护和保障本次科技创新债券持有人的利益，发行人承诺本次科技创新债券所募集资金用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，不用于房地产开发、土地储备及金融业等相关业务。发行人承诺闲置募集资金不用于购买高收益理财。

发行人承诺本次科技创新债券的募集资金使用应符合国家宏观调控和产业政策要求，不用于对金融机构出资，不直接用于上市公司二级市场股票投资等。

发行人承诺本次科技创新债券的募集资金运用不违反《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106 号）等相关规定，承诺本次科技创新债券募集资金用途符合党中央、国务院关于地方政府性债务管理相关文件要求，不会增加政府债务或政府隐性债务规模。

在本次债务融资工具存续期间，若发生募集资金用途变更，发行人将提前通过上海清算所网站和中国货币网及时披露有关信息。

四、偿债保障措施

为了充分有效地维护本次科技创新债券持有人的利益，发行人为本次科技创新债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保本次科技创新债券安全兑付的保障措施。

（一）设立专门的偿付工作小组

发行人将组成偿付工作小组，负责本息偿付及与之相关的工作。发行人指定偿付工作小组负责协调本次科技创新债券偿付工作，并通过发行人其他相关部门在财务预算中落实科技创新债券本息兑付资金，保证本息如期偿付，保障科技创新债券持有人利益。

（二）严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到科技创新债券投资人的监督，防范偿债风险。

（三）加强本期科技创新债券募集资金使用的监控

发行人将根据内部管理制度及本次科技创新债券的相关条款，加强对本次募集资金的使用管理，提高本次募集资金的使用效率，并定期审查和监督资金的实际使用情况及本次科技创新债券各期利息及本金还款来源的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付本次科技创新债券本息。

（四）本期科技创新债券偿债保障

作为发行人，上海合晶是本期科技创新债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司业务产生的收入和未来现金流。公司将以良好的经营业绩为本期科技创新债券的还本付息创造基础条件，同时采取具体有效的措施来保障本期科技创新债券投资者到期兑付本息的合法权益。根据公司的主营业务收入、综合偿债能力、融资能力等方面的情况，本期科技创新债券本息兑付资金来源安排如下：

1、收入、利润及经营活动现金流入

报告期内，发行人营业收入分别为 134,817.37 万元、110,873.63 万元、131,134.18 万元和 28,003.21 万元，营业收入整体保持较高水平，且 2025 年已实现企稳回升，营业收入同比增长 18.27%。报告期内各期分别实现净利润 24,686.10 万元、12,078.34 万元、12,534.97 万元和 1,255.06 万元，盈利能力较强。此外，公司最近三年及一期经营活动现金流量净额分别为 57,836.63 万元、44,823.20 万元、40,683.72 万元和 7,280.58 万元，报告期内经营活动现金流量净额持续为正且金额较大。整体而言，发行人经营情况总体良好、财务情况较为稳健，较强的盈利能力将为本期科技创新债券本息兑付提供有力保障。

2、较为充足的货币资金及可变现资产

截至 2025 年末，公司流动资产余额为 136,134.73 万元，其中包括 67,148.86 万元的货币资金（非受限部分 65,953.67 万元）。若未来偿债遇到突发性资金周转问题，可变现资产对本期科技创新债券的本息兑付起到一定的支持作用。

3、多渠道融资能力

公司经营状况稳定，盈利能力良好，资信状况优良，具有较强的融资能力。截至 2026 年 3 月 31 日，发行人获得主要银行授信额度合计 27.23 亿元，主要授信银行包括中信银行、建设银行、中国银行、国开行等，其中已使用授信额度为 4.89 亿元，未使用授信额度 22.35 亿元。发行人与多家银行合作关系稳定，间接融资渠道畅通。此外，发行人还可以通过资本市场进行股权融资和债券融资，具有多渠道融资能力。发行人较强的融资能力为本期科技创新债券的本息偿付提供了保障。

五、本次发行符合科技创新债券的情况说明

发行人属于半导体/集成电路行业，主营业务为半导体硅外延片的研发、生产和销售，且发行人于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，系上海证券交易所科创板上市公司，股票代码 688584.SH。因此，发行人符合中市协发〔2025〕86 号文件关于对科技型企业发行主体范围规定的情形 3 的相关要求。

根据《关于推出科技创新债券构建债市“科技板”的通知》（中市协发〔2025〕86 号）相关要求，为满足企业核心技术保密等要求，根据企业实际需求，可简化或豁免披露企业经营模式、重要在研项目等敏感信息。出于商业竞争敏感性考虑，以及与客户签订的保密协议约束等因素，发行人未披露供应链上下游企业名称等涉及企业经营的具体信息，发行人承诺相关内容不会对本期债券注册发行产生不利影响。

第五章 企业基本情况

一、发行人概况

注册名称	上海合晶硅材料股份有限公司
法定代表人	毛瑞源
注册资本	人民币 669,195,352.00 元
实缴资本	人民币 669,195,352.00 元
设立（工商注册）日期	1994 年 12 月 1 日
统一社会信用代码	91310000607286404W
住所（注册地）	上海市松江区石湖荡镇长塔路 558 号
邮政编码	201617
电话	021-57843535
传真	86-21-57843572
经营范围	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；新材料技术研发；国内货物运输代理；企业管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、发行人历史沿革

（一）公司设立情况

公司前身为 1994 年 12 月上海有色硅材料厂与外资企业香港汉崧共同投资设立的中外合作经营企业上海晶华。

1994 年 7 月 22 日，上海有色硅材料厂与香港汉崧签订《合作合同》，双方约定共同投资举办合作企业上海晶华，注册资本为 133.43 万美元，其中：上海有色硅材料厂以厂房、设备、配套设施出资 99.43 万美元，占注册资本的 74.5%；香港汉崧以流动资金出资 34 万美元，占注册资本的 25.5%。同日，上海有色硅材料厂与香港汉崧就成立合作企业上海晶华相关事宜签署《公司章程》。

1994 年 9 月 26 日，上海市国资办下发《关于对上海市有色金属总公司拟投入合作企业部分资产评估价值的确认通知》（沪国资（94）第 322 号），确认收到上海有色总公司提供的沪有色计（94）第 173 号《关于资产评估承诺报告》及所附上海审计师事务所沪审事业（94）312 号评估报告；经上海审计师事务所评估，上海有色总公司拟投入上海晶华的资产，截止评估基准期 1994 年 3 月 31 日，房屋建筑物、机器设备合计价值为 8,658,715.89 元，上海市国资办对上述评估价值予以确认。

1994 年 10 月 22 日，上海市外资委下发《关于上海晶华电子科技有限公司可行性研究报告、合同和章程的批复》（沪外资委批字（94）第 1266 号），原则同意上海有色硅材料厂和香港汉崧合作建办“上海晶华电子科技有限公司”的可行性研究报告、合同和章程；同意上海晶华投资总额 133.43 万美元，注册资本 133.43 万美元，其中上海有色硅材料厂出资 74.5%，以厂房、设备、配套设施出资，香港汉崧出资 25.5%，以美元现汇出资。

1994 年 11 月 14 日，上海市人民政府向上海晶华核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸沪合作字[1994]764 号），企业中文名称为“上海晶华电子科技有限公司”，企业英文名称为“SHANGHAI J.H. ELECTRONICS SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.”，企业地址为上海市松江县贵南路，企业类型为中外合作经营企业，经营期限为 15 年，投资总额 133.43 万美元，注册资本 133.43 万美元，其中上海有色硅材料厂出资 99.43 万美元，持股 74.5%，香港汉崧出资 34 万美元，持股 25.5%，企业经营范围为生产和销售硅材料。

1994 年 12 月 1 日，上海晶华经国家工商局批准成立。同日，上海有色硅材料厂与上海晶华签署《财产交割单》，上海晶华确认收到上海有色硅材料厂投入的房屋建筑物、机器设备合计评估净值为 8,658,715.89 元。

根据华申会计师事务所于 1995 年 5 月 17 日出具的《关于上海晶华电子科技有限公司投入注册资本的验证报告》（华会发（95）第 172 号），截至 1995 年 5 月 17 日，上海有色硅材料厂及香港汉崧合计认缴的 133.43 万美元注册资本均已到位，上海晶华实缴注册资本为 133.43 万美元。

上海晶华成立时的股权结构情况如下：

单位：万美元

序号	股东名称	注册资本	实收资本	出资比例
1	上海有色硅材料厂	99.43	99.43	74.50%
2	香港汉崧	34.00	34.00	25.50%
合计		133.43	133.43	100.00%

（二）主要变动情况

截至目前，发行人历史沿革事件主要如下：

序号	发生时间	事件类型	基本情况
1	1996 年 8 月	第一次股权转让	香港汉崧将所持的 25.5%的股权全部转让给美国汉崧，香港汉崧退出
2	2000 年 5 月	第二次股权转让及第一次增资	上海有色硅材料厂将所持的 74.5%股权全部转让给上海跃龙，美国汉崧将所持的 21.05%股权转让给 Suntek 公司；注册资本从 133.43 万美元增至 763.19 万美元，（1）上海跃龙以实物净资产出资 469.16 万美元；（2）美国汉崧以现金出资 28.06 万美元；（3）Suntek 公司以现金出资 132.54 万美元
3	2002 年 10 月	第三次股权转让	Suntek 公司将所持的 21.05%的股权全部转让给美国汉崧，Suntek 公司退出
4	2003 年 9 月	第四次股权转让	美国汉崧将所持的 25.50%的股权全部转让给 STIC，美国汉崧退出
5	2004 年 6 月	第五次股权转让	上海跃龙将其所持的 49.50%的股权转让给 STIC；上海跃龙将所持的 25.00%的股权转让给上海有色新材料，上海跃龙退出
6	2004 年 8 月	第二次增资	注册资本从 763.19 万元增加至 1,204.82 万元，（1）STIC 以专业技术经评估作价 2,000 万元、折合 240.96 万美元向合晶有限增资，以美元现汇向合晶有限增资 90.26 万美元；（2）上海有色新材料以现金向合晶有限增资 110.41 万美元

7	2006 年 3 月	第三次增资	注册资本从 1,204.82 万元增加至 1,451.72 万元, (1) STIC 出资 185.175 万美元, 以现汇投入; (2) 上海有色新材料以相当于 61.725 万美元的人民币现金出资
8	2007 年 12 月	第六次股权转让及第四次增资	上海有色新材料将所持的 25.00% 股权全部转让给 STIC, 上海有色新材料退出; 注册资本从 1,451.72 万美元增加至 2,145.05 万美元, 均系以合晶有限自 2004 年至 2006 年末分配利润中的人民币 52,000,000.00 元 (按美元对人民币 1:7.5 的汇率折合 693.33 万美元) 用于转增公司注册资本
9	2016 年 11 月	第五次增资	注册资本从 2,145.05 万美元增加至 2,272.205483 万美元, (1) 美国绿捷以其持有的扬州合晶 16.50% 股权作价出资 699,355.16 美元; (2) 荣冠投资以其持有的扬州合晶 13.50% 股权作价出资 572,199.67 美元
10	2016 年 12 月	第六次增资	注册资本从 2,272.205483 万美元增加至 32,981.935232 万元, STIC 以其持有的上海晶盟 100% 股权作价出资 147,635,238.08 美元
11	2017 年 2 月	第七次增资	注册资本从 32,981.935232 万元增至 52,855.665432 万元, 兴港融创以现金出资 19,873.7302 万元
12	2019 年 9 月	第八次增资	注册资本从 52,855.665432 万元增至 56,324.533377 万元, 新增注册资本由中电中金、厦门联和、厦门金创、上海聚芯晶、上海海铸晶、上海安之微、上海海崧兴、扬州芯晶阳、郑州兴晶旺、郑州兴芯旺认缴
13	2019 年 12 月	股份公司设立	整体变更设立股份公司, 股本为 563,245,374 股
14	2021 年 11 月	第九次增资	注册资本增加至 59,585.4316 万元, 新增注册资本由中电中金、厦门联和二期、比亚迪、华虹虹芯、双百贤才、上海盛雍、瀚思博投、深圳众晶、盛美上海、创启开盈认缴
15	2024 年 4 月	上市发行, 变更注册资本	根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 26 日出具的《关于同意上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2253 号), 并经上海证券交易所同意, 发行人首次向社会公开发

			行人民币普通股（A 股）66,206,036 股，发行前公司总股本为 595,854,316 股，发行后公司总股本为 662,060,352 股，注册资本增至 66,206.0352 万元
16	2024 年 6 月	股票期权行权	2024 年 6 月 6 日，公司发布《上海合晶硅材料股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划和 2022 年股票期权激励计划第一个行权期批量行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-020）。本次股票期权激励计划行权股票数量为 3,398,001 股，行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为 2027 年 6 月 4 日（如遇非交易日则顺延）。行权后，公司的股本总额由 662,060,352 股变更为 665,458,353 股。公司注册资本变更为人民币 66,545.8353 万元
17	2026 年 4 月	股票期权行权及限制性股票首次授予归属	2026 年 4 月 21 日，公司披露了《上海合晶硅材料股份有限公司 2020 年和 2022 年股票期权激励计划第三个行权期批量行权结果及 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2026-024），公司于 2026 年 4 月 16 日办理完成 2020 年和 2022 年股票期权激励计划第三个行权期批量行权及 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属的股份登记手续，新增股份 3,736,999 股，公司注册资本由人民币 665,458,353 元变更为人民币 669,195,352 元，股本总数由 665,458,353 股变更为 669,195,352 股

（三）重大资产重组

报告期内，发行人不存在重大资产重组。

三、发行人股权结构及实际控制人

（一）发行人股权结构

发行人是中国上海证券交易所科创板上市公司。截至 2026 年 3 月 31 日，发行人前十大股东股权结构如下：

排名	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1	SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP.	319,624,122.00	48.03
2	河南京港股权投资基金管理有限公司－河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）	192,082,733.00	28.86
3	中电中金（厦门）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,101,200.00	1.22
4	GREEN EXPEDITION LLC	4,958,165.00	0.75
5	厦门市联和股权投资基金管理有限公司－厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,742,810.00	0.71
6	广发证券股份有限公司－国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	4,546,117.00	0.68
7	厦门市联和股权投资基金管理有限公司－厦门联和二期集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,466,179.00	0.67
8	长江证券股份有限公司－华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	3,975,303.00	0.60
9	计平	2,800,000.00	0.42
10	孙东宏	2,486,104.00	0.37
合计		547,782,733.00	82.31

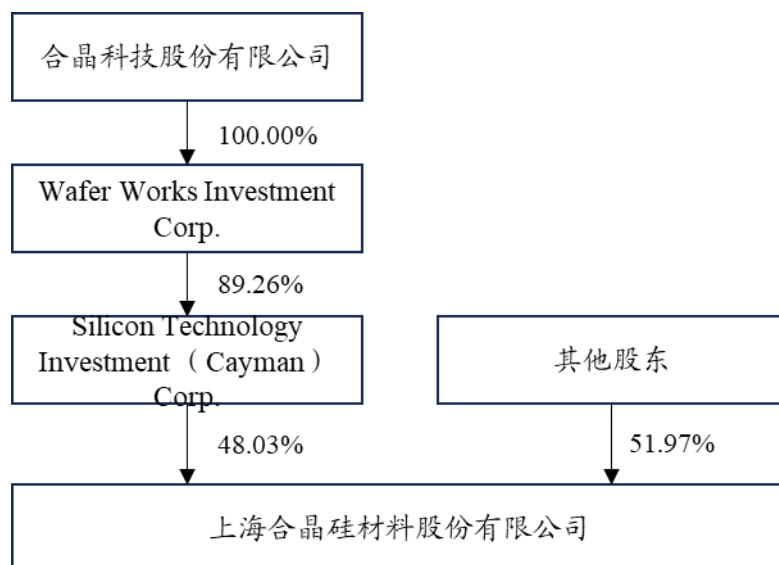
（二）发行人控股股东及实际控制人情况

截至 2026 年 3 月 31 日，Silicon Technology Investment（Cayman）Corp.（以下简称“STIC”）直接持有发行人 48.03% 的股份，系发行人的直接控股股东，系投资控股平台。

合晶科技股份有限公司（以下简称“合晶科技”）通过 Wafer Works Investment Corp.（以下简称“WWIC”）持有 STIC 89.26% 的权益，系发行人的间接控股股东。

合晶科技的股权结构较为分散，结合合晶科技的公司章程、董事高管提名及任命情况、最近三年股东会、董事会、审计委员会运行及重大事项表决结果、内

部治理结构及日常经营管理决策，合晶科技不存在实际控制人，因此发行人不存在实际控制人。相关股权关系如下图所示：



1、控股股东 STIC

截至本募集说明书出具日，发行人控股股东 STIC 基本情况如下：

公司名称	Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.
公司注册编号	CR-76355
董事	焦平海、焦生海、邵中和、刘苏生、毛瑞源
注册资本	73,035,700.01 美元
已发行股份总数	51,490,854 股
注册地	P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands
主营业务	投资控股
成立日期	1997 年 9 月 15 日

控股股东 STIC 最近一年的财务数据如下表所示：

单位：万美元

主要财务指标	2025 年度/末
总资产	27,221.47
净资产	27,220.83
营业收入	-



主要财务指标	2025 年度/末
净利润	1,110.20

2、控股股东 WWIC

截至本募集说明书出具日，发行人控股股东 WWIC 基本情况如下：

公司名称	Wafer Works Investment Corp.
公司注册编号	19104
董事	焦平海
注册资本	70,000,000.00 美元
注册地	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa
主营业务	投资控股
成立日期	2004 年 12 月 1 日

控股股东 WWIC 最近一年的财务数据如下表所示：

单位：万美元

主要财务指标	2025 年度/末
总资产	25,434.62
净资产	25,434.62
营业收入	-
净利润	1,020.18

3、控股股东合晶科技

截至本募集说明书出具日，发行人控股股东合晶科技基本情况如下：

公司名称	合晶科技股份有限公司
股票代码	6182.TWO（中国台湾地区证券柜台买卖中心上柜公司）
董事（或其代表人）	焦平海、刘秀美、刘镇图、邵中和、洪瑞华、林凤仪、周德玮、吴南阳、蔡永松
实收资本	573,638,300.00 新台币
公司地址	新竹科学园区桃园市龙潭区龙园一路 100 号
主营业务	主要从事半导体硅抛光片的研发、生产及销售，除发行人外，合晶科技及其控制的其他企业不涉及外延片生产



成立日期	1997 年 7 月 24 日
------	-----------------

控股股东合晶科技最近一年的合并报表财务数据如下表所示:

单位: 亿新台币

主要财务指标	2025 年度/末
总资产	389.16
净资产	254.95
营业收入	98.17
净利润	4.65

注: 2025 年财务数据已经安永联合会计师事务所审计。

截至募集说明书出具日, 控股股东持有公司股份不存在被质押情况。

四、发行人独立性情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与公司控股股东之间相互独立, 具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力, 具有完整的供应、生产和销售系统。

(一) 资产独立

发行人具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施, 合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权或者使用权, 具有独立的原料采购和产品销售系统。

(二) 人员独立

发行人的总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东 STIC 及 WWIC、合晶科技及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务, 不在控股股东 STIC 及 WWIC、合晶科技及其控制的其他企业领薪; 发行人的财务人员未在控股股东 STIC 及 WWIC、合晶科技及其控制的其他企业中兼职。

(三) 财务独立

发行人已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；发行人未与控股股东 STIC 及 WWIC、合晶科技及其控制的其他企业共用银行账户。

（四）机构独立

发行人已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东 STIC 及 WWIC、合晶科技及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立

发行人的业务独立于控股股东 STIC 及 WWIC、合晶科技及其控制的其他企业，与控股股东 STIC 及 WWIC、合晶科技及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

五、发行人重要权益投资情况

（一）全资及控股子公司情况

截至 2026 年 3 月末，发行人纳入合并范围的全资及控股子公司共计 3 家，其中上海晶盟及郑州合晶为重要子公司，具体情况如下表所示：

1、上海晶盟

截至 2026 年 3 月末，上海晶盟基本情况如下：

名称	上海晶盟硅材料有限公司
成立时间	2005-06-09
注册资本	68804.9511 万元
法定代表人	陈建纲
股东构成及控制情况	发行人持股 100%
住所	上海市青浦区北青公路 8228 号，二区 48 号
主要业务	半导体硅外延片的研发、生产、销售及加工服务
经营范围	研发、设计、制造、加工半导体硅外延片、硅抛光片及相关产品，销售自产产品；道路货物运输，从事货物及技术的进出口业务。



名称	上海晶盟硅材料有限公司
	【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海晶盟最近一年的合并报表财务数据如下表所示：

单位：万元

主要财务指标	2025 年度/末
总资产	144,491.14
净资产	107,741.17
营业收入	121,945.49
净利润	16,724.67

2、郑州合晶

截至 2026 年 3 月末，郑州合晶基本情况如下：

名称	郑州合晶硅材料有限公司
成立时间	2017-02-23
注册资本	212000 万元
法定代表人	钟佑生
股东构成及控制情况	发行人持股 100%
住所	郑州航空港经济综合实验区规划工业四路以南、华夏大道以西
主要业务	硅材料生产、销售及加工服务
经营范围	硅材料、电子材料的生产及销售；道路普通货物运输（以上凭有效许可证经营）；从事货物与技术的进出口业务（法律法规规定应经审批方可经营的项目或国家禁止进出口的货物与技术除外）

郑州合晶最近一年的合并报表财务数据如下表所示：

单位：万元

主要财务指标	2025 年度/末
总资产	288,088.88
净资产	227,729.57
营业收入	56,884.57
净利润	3,454.21

3、扬州合晶



截至 2026 年 3 月末，扬州合晶基本情况如下：

名称	扬州合晶科技有限公司
成立时间	2010-09-26
注册资本	10900.016996 万元
法定代表人	钟佑生
股东构成及控制情况	发行人持股 100%
住所	扬州经济技术开发区马泊河路 6 号
主要业务	研发、生产、销售半导体材料及加工服务
经营范围	研发、生产高纯硅、蓝宝石相关的半导体材料；石墨、石英制品的批发，以及上述同类产品的进出口贸易。（拍卖除外、涉及许可经营的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

扬州合晶最近一年的合并报表财务数据如下表所示：

单位：万元

主要财务指标	2025 年度/末
总资产	9,811.08
净资产	8,843.10
营业收入	5,054.36
净利润	-975.68

（二）参股公司情况

截至 2026 年 3 月末，发行人参股公司共计 2 家，具体情况如下表所示：

1、上海晶沛电子材料有限公司

截至 2026 年 3 月末，上海晶沛电子材料有限公司基本情况如下：

名称	上海晶沛电子材料有限公司
成立时间	2025-06-19
注册资本	5000 万元
法定代表人	陆宁
股东构成及控制情况	Wafer Works Investment Corp.持股 60.00%，发行人持股 40.00%

住所	上海市松江区石湖荡镇长塔路 558 号 1 幢二层
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、深圳市芯威能半导体有限公司

截至 2026 年 3 月末，深圳市芯威能半导体有限公司基本情况如下：

名称	深圳市芯威能半导体有限公司
成立时间	2022-10-20
注册资本	833.3333 万元
法定代表人	欧阳春林
股东构成及控制情况	深圳市恩博半导体科技有限公司持股 45.00% 深圳市威能一号企业管理合伙企业（有限合伙）持股 16.00% 深圳市天锒半导体有限公司持股 15.00% 深圳市海晔飞科技有限公司持股 13.00% 发行人持股 6.00% 深圳市泰元润投资合伙企业（有限合伙）持股 3.00% 深圳市联润东方股权投资基金管理有限公司持股 2.00%
住所	深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心 B 塔 1406
经营范围	集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；半导体分立器件制造；集成电路设计；软件开发；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

六、发行人公司治理和内部控制制度

（一）发行人治理结构及运行情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件要求，结合实际情况，完善以股东会、董事会、经理层为主体，权责清晰、分工明确的法人治理结构，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制，确保公司规范运作。

截至募集说明书出具日，公司治理结构和治理制度情况如下：

1、股东会

股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
- （二）审议批准董事会的工作报告；
- （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
- （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （五）对发行公司债券作出决议；
- （六）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- （七）对修改本章程作出决议；
- （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
- （九）审议批准本章程第四十六条规定的对外担保事项；
- （十）审议批准法律、行政法规、规章、规范性文件和本章程规定应当由股东会审议批准的关联交易事项；
- （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；
- （十二）审议批准变更募集资金用途事项；
- （十三）审议股权激励计划和员工持股计划；

(十四) 审议批准法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程规定的应由股东会决定的其他事项。

(十五) 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

公司经股东会决议，或者经本章程、股东会授权由董事会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

2、董事会

公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 人。董事会行使下列职权：

- (一) 召集股东会，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- (七) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
- (八) 决定公司内部管理机构的设置；
- (九) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；
- (十) 制定公司的基本管理制度；

- (十一) 制订本章程的修改方案;
- (十二) 管理公司信息披露事项;
- (十三) 向股东会提请聘任或更换为公司审计的会计师事务所;
- (十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
- (十五) 拟订股权激励计划和员工持股计划;
- (十六) 法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。

发行人在董事会下设立的 4 个专门委员会,分别履行以下职责:

(1) 审计委员会:负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

(2) 战略决策委员会:对公司中长期发展战略和重大战略投资决策进行研究并提出建议。

(3) 提名委员会:负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

(4) 薪酬与考核委员会:负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。

3、独立董事专门会议

公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。独立董事行使下列特别职权:

- (一) 独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;
- (二) 向董事会提议召开临时股东会;
- (三) 提议召开董事会会议;
- (四) 依法公开向股东征集股东权利;
- (五) 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见;

(六) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。

独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。

4、高级管理人员

公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘。公司设财务总监 1 名，由董事会决定聘任或解聘。公司可以设副总经理，由总经理提名，并由董事会决定聘任或解聘。

总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员，董事会秘书除外；

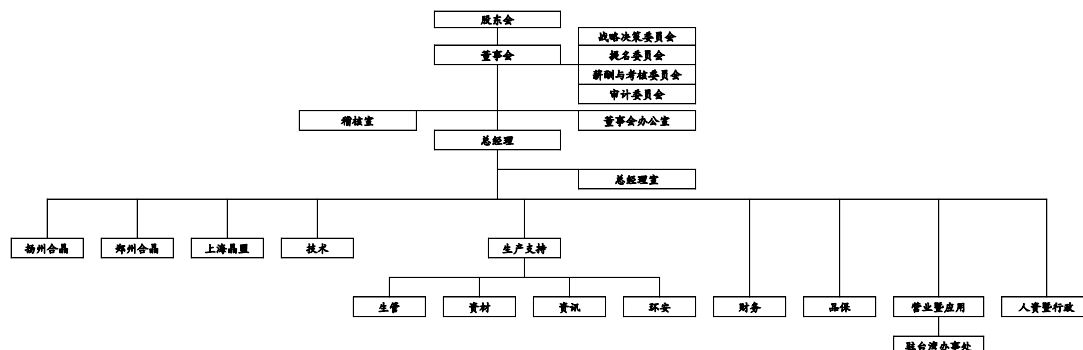
(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

(八) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程规定的或股东会、董事会授予的其他职权。

(二) 发行人内部组织结构

1、发行人组织结构图

公司根据自身经营管理需要，设有生产支持、财务、品保、营业暨应用和人
资暨行政等部门。公司组织结构如下图所示：



2、各部门职能

发行人各职能部门的职责范围情况如下表所示：

序	部门名称	部门职责
1	生产支持	生管：负责工厂生产排程，与制造部门协调达成交期 资材：负责进出后、采购及仓管。核准原料请购采购和物料计划，降低采购成本和新供应商的开发，协调处理物料的紧急供应状况，物料库存控制，ISO 体系内审日常，保税业务管理，进出口优惠政策的运用，降低进出口费用，物料之出入库控制及盘点，维护料账正确性，物料计划及库存合理化，原厂商资源性废弃物之回收，仓库 6S 管理及安全维护 资讯：负责网络资讯系统建设、维护及信息安全，组织管理和维护公司计算机软硬件设施与网络，现状分析与改善，负责公司各信息系统导入、建置与维护管理，推动与督导部门内相关项目进度，负责公司资讯相关政策制定及推动与短中长期目标，协助各单位对信息化需求进行评估、推动及改善 环安：负责公司环保、安全生产，以及员工职业健康管理
2	财务	参与制定总体发展战略和目标，根据集团财务现状，对战略制定提出建议，确保集团总体战略目标切实可行。制定公司财务中长期发展规划及整体框架。并主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。在财务内控方面，制定和完善公司有关预算管理、会计管理、财务管理、资金管理、资产管理、税务管理的制度及相关文件，并监督落实。外部关系包含银行、工商、税务等政府部门的关系维护，

序	部门名称	部门职责
		确保公司利益。资金管理方面，筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向。财务管理方面：建立和完善财务部门，根据集团总部对各事业部各分公司及各部门年度预算的决定，监控各事业部各分公司及各部门的财务收支情况，每月对各事业部各分公司和各部门的财务状况进行分析，及时向总经理提出调整公司财务预算及各种财务决策的建议
3	品保	保证产品质量，确保客户满意，产品可靠度实验管理，CAR 管理，客诉管理，实验室管理，统计质量管理，Benchmark 分析，PCRB 管理，FMEA 管理
4	营业暨应用	负责达成公司年度目标及年度计划控制，销售通路的管理组织及开发，客户满意度的提升与市场产品定价；并规划市场策略及产品次策略制定，创造并增加公司营业金额、营业利润及营业项目，同时规划并执行未来发展之策略
5	人资暨行政	人资： 负责人员招募及人才储备、任用、薪酬福利、员工激励、教育培训及生涯规划等管理；落实年度薪酬预算及作业、办理薪资发放、“五险一金”缴纳、个税申报以及员工落户、人才奖励政策申报等相关作业 行政： 负责企业文化，外部关系；落实年度行政管理费用预算及费用管控；办公设施维护及项目、办公用品及固定资产管理；负责工作餐、员工旅游及各项活动；公司绿化、保安及保洁等服务与管理
6	技术	负责新产品、新制程、新供应商样品的管理，以及研发项目管理、工程项目管理、工程实验管理；每月负责研发费用统计核算；每年负责研发项目申报、企业项目申报、各项专利申请；制程能力定期更新

（三）公司内部控制制度

为提高发行人的内部控制与经营管理水平，建立现代公司制度，保障公司发展规划和经营战略目标的实现，发行人根据有关法律、行政法规等，制定了相关内部控制制度，制度主要涵盖公司治理相关制度、内部管理相关制度、安全生产及环境保护等方面。

发行人的主要内部管理制度体系如下所示：

1、公司治理相关制度体系

截至募集说明书出具日,发行人已制定了股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、董事会秘书工作制度、总经理工作制度、独立董事工作制度、董事会提名委员会议事规则、董事会薪酬与考核委员会议事规则、董事会审计委员会议事规则、董事会战略决策委员会议事规则等公司治理相关制度。

2、内部管理相关制度体系

截至募集说明书出具日,发行人已制定了以下公司内部管理相关规则制度:

(1) 关联交易管理制度

为了规范关联交易行为,保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性,充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海合晶硅材料股份有限公司章程》等有关规定,制定本制度。

公司进行关联交易应当签订书面协议,明确关联交易的定价政策。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,协议内容应明确、具体。公司关联交易定价应当公允,参照下列原则执行:

- ① 交易事项实行政府定价的,可以直接适用该价格;
- ② 交易事项实行政府指导价的,可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格;
- ③ 除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;
- ④ 关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;
- ⑤ 既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

公司与关联人发生的重大关联交易达到以下标准之一的,除应当及时披露外,还应当提交董事会或股东会审议:

①公司与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上的关联交易（公司提供担保除外）的，由公司董事会作出决议；

②公司拟与关联人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值 0.1% 以上的交易，且超过 300 万元的（公司提供担保除外），由公司董事会作出决议；

③公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值 1% 以上的交易，且超过 3000 万元，应当按照《上市规则》的规定提供评估报告或审计报告，由股东会作出决议，但与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估；

④公司为关联人提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后及时披露，并提交股东会审议。公司为关联股东提供担保的，关联股东应当在股东会上回避表决。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。公司股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权。公司为持股 5% 以下的股东提供担保的，参照前款规定执行，有关股东应当在股东会上回避表决。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

公司拟进行须提交股东会审议的关联交易，应当在提交董事会审议前，取得独立董事事前认可意见。独立董事作出判断前，可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。独立董事事前认可意见应当取得全体独立董事的半数以上同意，并在关联交易公告中披露。

公司审计委员会应当同时对该关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。审计委员会可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。

（2）募集资金管理制度

为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的有关规定制定《募集资金管理制度》。对募集资金（包括公司境内首次公开发行股票，上市后境内外配股、增发新股、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金）存储、管理、使用等内容进行明确规定。

（3）对外担保管理制度

为规范公司对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海合晶硅材料股份有限公司章程》等规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。

（4）对外投资管理制度

为了规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》等的相关规定，制定本制度。

（5）子公司管理制度

为加强公司对子公司的管理，维护公司总体形象和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定以及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

（6）其他相关制度体系

发行人作为科创板上市公司，已按照上市公司信息披露要求制定了相关信息披露规则和投资者关系管理制度：重大信息内部报告制度、信息披露暂缓与豁免

业务管理制度、内幕信息知情人登记制度、投资者关系管理制度、董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度。

同时发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》《上海合晶硅材料股份有限公司章程》等有关规定，制定了《信用类债券信息披露管理制度》，对信息披露事务的程序和相关事项的监督检查与考核进行规范，确保信息披露的及时性、准确性和完整性。该制度明确了信息披露的内容及披露标准，并对信息披露的责任人、各责任人的职责、权属企业信披事务管理、信披文件的存档、信披责任的追究与处罚等内容作出规定。

七、企业人员基本情况

发行人的董事及高管人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（一）发行人的董事及高级管理人员名单

截至本募集说明书出具日，发行人董事及高级管理人员基本情况如下：

董事会				
姓名	职务	性别	任职起始日	任职到期日
毛瑞源	董事长	男	2022-06-28	2028-04-28
焦平海	董事	男	2022-06-28	2028-04-28
廖琼	董事	女	2022-06-28	2028-04-28
邵中和	董事	男	2022-06-28	2028-04-28
李光奎	董事	男	2024-10-21	2028-04-28
陈建纲	职工代表董事、总经理、核心技术人员	男	2021-08-06	2028-04-28
洪茂益	独立董事	男	2025-04-29	2028-04-28
夏定国	独立董事	男	2025-04-29	2028-04-28
谢长融	独立董事	男	2025-04-29	2028-04-28
高管				

董事会				
姓名	职务	性别	任职日期	任职到期日
陈建纲	总经理	男	2021-08-06	2028-04-28
庄子祊	董事会秘书	男	2021-08-06	2028-04-28
方时彬	财务总监	男	2025-04-29	2028-04-28

(二) 公司董事及高级管理人员的简历

1、董事会成员

毛瑞源：1972 年 4 月出生，本科学历，中国台湾籍。1995 年至 1999 年任安永联合会计师事务所组长；1999 年至 2007 年任合晶科技财务经理；2007 年至 2008 年任上海晶技电子材料有限公司财务处长；2008 年至 2014 年任合晶光电股份有限公司财务长；2014 年至 2020 年任合晶科技财务副总经理；2020 年至 2021 年任公司财务总监；2021 年至今，任公司中国台湾办事处诉讼及非诉讼代理人；2022 年至今，任郑州合晶董事；2022 年 4 月至今，任公司董事；2024 年 8 月至 2025 年 4 月，任公司副董事长；2025 年 4 月至 2026 年 6 月，任公司职工董事、董事长；2026 年 6 月至今，任公司董事长。

焦平海：1951 年 1 月出生，硕士研究生学历，中国台湾籍，美国国籍。焦平海先生 1976 年至 1988 年任 SILTEC CORP.制程研发部经理；1988 年至 1991 年任 EG&G RETICON CORP.产品开发部经理；1991 年至 1993 年任敦南科技股份有限公司制程开发部经理；1994 年至今，任美国汉崧执行长；2001 年至今，任合晶科技董事长、执行长；2008 年至 2011 年任阳光能源控股有限公司董事会主席；2005 年至今，任上海晶盟董事；1994 年 12 月至今，任公司董事。

廖琼：1985 年 4 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。廖琼女士 2007 年至 2010 年任毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理；2010 年至 2013 年任三一集团有限公司海外监察经理；2014 年至 2016 年任河南航空港投资集团有限公司审计部高级经理、风险控制部高级经理；2016 年至 2017 年任郑州航空港兴晟信资本管理有限公司风险控制部总监；2016 年至 2018 年任郑州航空港兴港供应链管理有限公司风险控制部部门负责人；2018 年至 2021 年任郑州航空港兴晟信资本管理有限公司总经理助理；2021 年至 2024 年，任郑州航空

港兴晟信资本管理有限公司董事、副总经理；2024 年至今任河南港投资本管理集团有限公司董事、总经理；2018 年至今，任郑州合晶董事；2018 年 7 月至今，任公司董事。

邵中和：1950 年 5 月出生，硕士研究生学历，中国台湾籍。邵中和先生 1976 年至 1993 年任宏碁电脑股份有限公司共同创办人；2004 年至今，任北京世纪互联宽带数据中心有限公司董事；2011 年至今，任合晶科技董事；2013 年至今，任大橡股份有限公司董事长、董事；2016 年至今，任华硕电脑股份有限公司独立董事；2018 年至 2023 年，任光电科技工业协进会董事长；2019 年 12 月至今，任公司董事。

李光奎：1992 年 11 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。李光奎先生 2017 年至 2018 年于郑州航空港兴晟信资本管理有限公司工作；2018 年至今于河南京港股权投资基金管理有限公司工作，历任河南京港股权投资基金管理有限公司专员、经理、高级经理、部门主任，现任河南京港股权投资基金管理有限公司投资业务部主任；2024 年 10 月 21 日至今，任公司董事。

陈建纲：1975 年 11 月出生，工商管理硕士，中国国籍。陈建纲先生 1998 年至 2007 年任合晶有限副厂长、厂长；2008 年至今，历任上海晶盟副总经理、总经理、董事；2022 年至今，任扬州合晶董事；2025 年至今，任郑州合晶董事；2021 年至今，任公司总经理；2025 年 4 月至 2026 年 6 月，任公司董事；2026 年 6 月至今，任公司职工董事；2025 年 5 月至今任上海晶盟董事长。陈建纲先生是上海市有色金属行业协会专家委员会副主任委员。陈建纲先生作为发明人协助公司取得 11 项专利，曾参与“超重掺磷外延片的研发”、“外延晶片无缺陷层深度量测能力的研发”、“埋层外延产品开发”课题研究。

洪茂益：1962 年 7 月出生，硕士研究生学历，中国台湾籍，具有中国台湾注册会计师资格。洪茂益先生于 1988 年 9 月担任安永联合会计师事务所审计组员；于 1989 年 7 月、1993 年 7 月及 1995 年 7 月分别担任安永联合会计师事务所审计组长、副理、经理职务；1997 年 6 月筹设安永联合会计师事务所桃园分所；1998 年 1 月至 2023 年 6 月任职安永联合会计师事务所合伙会计师及桃园分

所所长；于 2006 年 6 月担任中国台湾省会计师公会纪律委员；2023 年 7 月至今任职开曼商丰祥控股股份有限公司顾问。洪茂益先生著作成就：2011 年于台湾大学管理学院发表《国际会计处理准则对建设公司财务报表及经营绩效的影响》。2025 年 4 月至今，任公司独立董事。

夏定国：1964 年 02 月出生，博士学历，中国籍，北京大学材料科学与工程学院教授。夏定国先生从事材料学的教学及科学研究工作，先后主讲了本科生、硕士生、博士生课程等 10 门。承担或完成了包括国家重大研究计划、国家自然科学基金重点课题及北京市自然科学基金重点课题；在锂离子电池材料、燃料电池催化剂及材料制备等领域完成国家与省部级课题 10 余项；获国家发明专利 20 多项；获得国家与省部级科学技术奖励 3 项。在国内外学术期刊发表“SCI”收录论文 150 余篇；出版学术专著 2 部；于 2009 年，获得国家科技进步二等奖一项，北京市科学技术一等奖一项（基础类）。专业研究低铂及非铂催化剂、锂插入化合物、材料模拟计算等领域。2025 年 4 月至今，任公司独立董事。

谢长融：1960 年 12 月出生，硕士研究生学历，中国台湾籍。谢长融先生于 1985 年 7 月至 1986 年 3 月任职味全食品工业股份有限公司企业管理部门；于 1986 年 3 月至 1987 年 7 月任职 IBM 中国台湾分公司用户服务部门；1989 年 8 月至 1992 年 7 月任职法国百利银行台北分行经理；1992 年 7 月至 1997 年 1 月任职美国银行台北分行经理；1997 年 2 月至 2002 年 4 月任职大通银行台北分行副总经理；2002 年 6 月至 2006 年 7 月任职东元电机股份有限公司财务处处长；2006 年 8 月至 2012 年 2 月任职台新银行高级副总裁；2012 年 3 月至 2015 年 7 月任职大众银行资深副总；2015 年 7 月至 2022 年 9 月任职中国台湾新光银行历任总经理、董事；2022 年 10 月至 2023 年 5 月任职冠德建设股份有限公司总经理，2023 年 6 月至今任职董事。2025 年 11 月至今任滤能股份有限公司总经理。谢长融先生经历丰富，从业国际金融界以及 IT 产业界累积资历 40 余年。2025 年 4 月至今，任公司独立董事。

2、高管成员

陈建纲：详见本部分之“（二）公司董事及高级管理人员的简历”。

庄子昉: 1971 年 1 月出生, 硕士研究生学历, 中国台湾籍。庄子昉先生 1998 年至 2001 年任职中天新闻电视台; 2001 年至 2004 年任上海元祖梦果子股份有限公司协理; 2004 年至 2010 年任上海镁塔数码科技有限公司总经理, 2011 年至 2018 年历任上海元祖梦果子股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事; 2018 年至 2019 年任职于合肥新汇成微电子股份有限公司; 2019 年至 2020 年任依珀商贸(上海)有限公司总监; 2021 年至 2022 年任高维迪(上海)商务咨询有限公司执行董事。2021 年至今, 任公司董事会秘书; 2024 年 11 月至 2025 年 4 月, 任公司代理财务总监。

方时彬: 1981 年出生, 本科学历, 中国台湾籍。方时彬先生 2005 年至 2012 年任远东集团太平洋崇光百货股份有限公司财务部襄理; 2012 年至 2014 年任永丰余投资控股股份有限公司财务中心副理; 2014 年至 2017 年任美吾华股份有限公司总经理特助、管理部经理; 2017 年至 2023 年任南侨集团上海侨好贸易有限公司会计经理; 2024 年 11 月至 2025 年 4 月, 任公司总经理特助。2025 年 4 月至今, 任公司财务总监。

(三) 发行人员工构成情况

截至 2025 年末, 发行人母公司在职工数量为 29 人, 子公司在职工数量为 1,002 人, 合计 1,031 人。详细情况如图所示:

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	780
销售人员	14
技术人员	112
财务人员	26
行政人员	99
合计	1,031
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	4

专业构成	
硕士	57
本科	352
专科	302
高中及以下	316
合计	1,031

八、发行人主营业务情况

（一）主营业务情况概述

上海合晶是行业领先的半导体电子材料供应商,是中国少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导体硅外延片一体化制造商,主营业务聚焦于半导体硅外延片及其他高端半导体电子材料的研发、生产与销售。发行人致力于研发并应用行业领先工艺,为客户提供高平整度、高均匀性、低缺陷度的优质半导体硅外延片及其他高端半导体电子材料。发行人的外延片产品主要用于制备功率器件和模拟芯片等,被广泛应用于汽车、工业、通讯、办公等领域。

半导体硅片是半导体产业链的基础,也是中国半导体产业与国际先进水平差距较大的环节之一,我国大硅片技术水平及自主供应能力较弱,依赖进口程度较高,是半导体产业链中的短板,因此半导体硅片国产化符合国家重大需求,具有重大战略意义。近年来受国际贸易摩擦等因素的影响,国内半导体产业对于供应链自主可控的需求较为强烈。发行人积极响应国家战略需求,紧跟国际前沿技术,突破了外延片的关键核心技术,有利于提升我国半导体关键材料生产技术的自主研发水平。

发行人客户遍布中国、北美、欧洲、亚洲其他国家或地区,拥有良好的市场知名度和影响力。发行人已经为全球前十大晶圆代工厂中的 8 家公司、全球主要功率器件 IDM 厂供货,主要客户包括华虹宏力、芯联集成、华润微、台积电、力积电、威世半导体、达尔、德州仪器、意法半导体、安森美等行业领先企业,

并多次荣获华虹宏力、台积电、达尔等客户颁发的最佳或杰出供应商荣誉，是我国少数受到国际客户广泛认可的外延片制造商。

（二）主营业务收入、成本及利润分析

报告期内，公司主营业务以外延片为核心，主营业务收入按产品分类如下：

单位：万元

收入	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
外延片	123,409.36	94.76%	106,815.14	96.98%	132,175.35	98.11%
硅材料	6,827.22	5.24%	3,330.10	3.02%	2,552.27	1.89%
合计	130,236.57	100.00%	110,145.23	100.00%	134,727.61	100.00%

公司主营业务成本按产品分类如下：

单位：万元

成本	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
外延片	86,221.61	93.54%	74,895.81	95.97%	82,011.26	97.55%
硅材料	5,953.19	6.46%	3,146.37	4.03%	2,060.57	2.45%
合计	92,174.81	100.00%	78,042.18	100.00%	84,071.82	100.00%

公司毛利及毛利率按产品分类如下：

单位：万元

毛利/毛利率	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
外延片	37,187.75	30.13%	31,919.33	29.88%	50,164.09	37.95%
硅材料	874.03	12.80%	183.73	5.52%	491.70	19.27%
合计	38,061.77	29.23%	32,103.06	29.15%	50,655.79	37.60%

2023 年至 2025 年，发行人主营业务收入分别为 134,727.61 万元、110,145.23 万元和 130,236.57 万元，主要受外延片产品影响。2023 年-2024 年发行人主营业务收入有所下降，主要受半导体行业周期下行、市场需求疲软及竞争加剧等因素影响，2025 年随着行业景气度企稳回升，主营业务收入实现增长。

2023 年至 2025 年,公司业务板块毛利率分别为 37.60%、29.15%和 29.23%,主要受外延片产品毛利率影响。上述期间外延片板块毛利率分别为 37.95%、29.88%和 30.13%,其中 2023 年至 2024 年发行人外延片毛利率持续下降,主要受半导体行业周期下行、市场需求疲软及竞争加剧等因素影响,导致销售单价有所下降,同时由于销货数量下降,导致单位产品分摊成本上升,综合导致毛利率有所下降,2025 年随着行业景气度企稳回升,毛利率总体较为稳定。

(三) 主要板块经营情况

1、发行人的经营模式

(1) 采购模式

公司主要采取以产定购的采购模式。公司根据客户订单、生产计划、物料清单、物料安全库存及实际库存量,制定物料采购计划,并根据物料采购计划相应进行采购。

公司建立了完整的供应商认证管理制度。对于供应商管理,公司主要通过书面评估、现场稽核、样品认证、定期考核等手段,确保供应商有能力长期稳定供应产品,并保证产品质量。公司目前已与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。

公司采取了规范的采购控制程序。公司秉承公平公正原则进行采购控制,对于新供应商或初次使用的物料,公司需对供应商资质及其提供的样品进行严格的认证程序,在认证通过后将相关供应商及产品纳入合格清单;对于公司的重要物料,公司需在合格清单范围内选取多家供应商进行询价、比价及议价;对于公司的常用物料,公司需定期议价。

(2) 生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式,主要产品根据客户的差异化需求进行工艺设计及生产制造。生产部门根据销售计划来制定生产计划,同时将相关数据传送至采购部门,以确保原材料的供应。品保部门负责对产品关键质量参数进行审查及确认,环安部门确保公司在符合安全与环保规范的前提下合规运营。

长期的技术研发与生产运营,使得公司在技术水平和生产管理方面有着深厚积淀。公司先后通过 ISO45001、ISO14001、IATF16949 等体系认证。目前,公司能够分别按国际 SEMI 标准、中国国家标准、销售目的地国家标准及客户特定要求进行产品生产。同时采用 SAP 管理系统、MES 生产管理系统和 SPC 过程控制工具,在产品开发、原材料采购、产品生产、出入库检验、销售服务等过程中严格实施标准化管理和控制,使产品质量的稳定性及一致性达到较高水平。

(3) 销售模式

公司采取直销和经销两种模式进行销售。在直销模式下,公司主要采取与客户直接沟通或谈判的方式获取订单,并负责为客户提供销售、技术及后续其他服务。公司与经销商的合作模式是公司向经销商买断式销售产品,再由经销商将产品销售给终端客户。

(4) 盈利模式

公司主要从事半导体硅外延片的研发、生产和销售,通过向国内外 Foundry、IDM 等芯片生产制造企业销售硅外延片实现收入和利润。

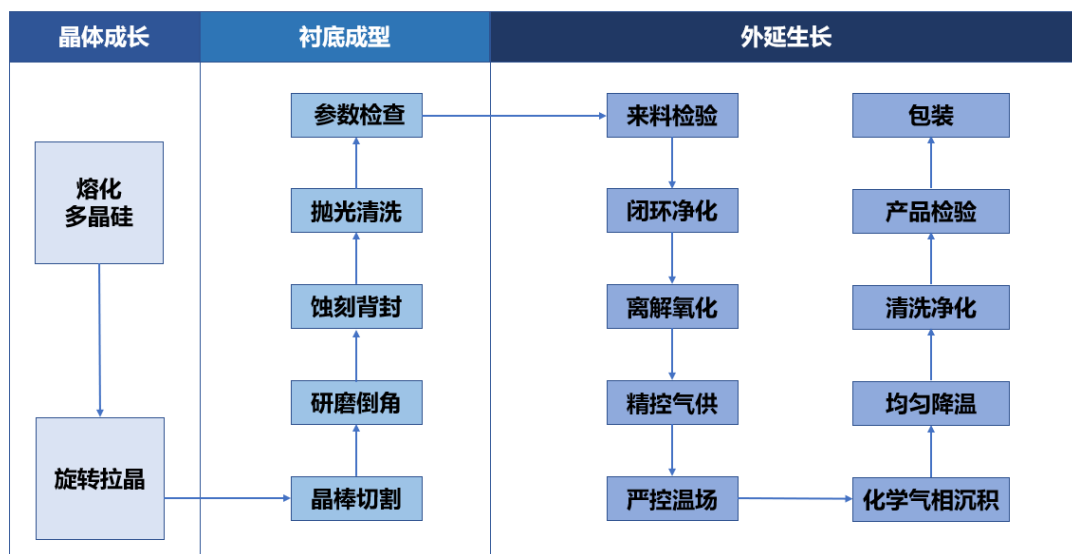
2、发行人上下游产业链情况

外延片企业的下游客户是芯片制造企业,包括大型综合晶圆代工企业及专注于功率器件制造、模拟芯片制造与传感器制造等领域的 IDM 厂商。外延片的终端应用领域涵盖智能手机、平板电脑、便携式设备、物联网、汽车电子、人工智能、工业电子、军事、航空航天等众多行业。随着科学技术的不断发展,新兴终端市场还将不断涌现。

上游 硅片制造厂商	中游 晶圆加工厂商		下游 行业应用	
信越化学	晶圆代工厂	产品	手机与平板电脑	
日本胜高	台积电 联电 中芯国际 华虹宏力	功率器件 模拟芯片 传感器 分立器件 射频芯片	物联网	
德国世创			汽车电子	
环球晶圆	IDM 厂商		人工智能	
SK Siltron	英飞凌 德州仪器 达尔 意法半导体 华润微 威世半导体		工业电子	
上海合晶			军事太空	
.....				

3、发行人主要产品的工艺流程

半导体硅外延片的生产工艺流程较长、工艺技术复杂，主要生产环节包括晶



体成长、衬底成型、外延生长等。发行人产品的主要工艺流程具体如下：

4、发行人生产销售情况

(1) 主要产品的产量和销量情况

单位：折合 8 英寸/万片

产品	报告期	生产量	销售量	库存量
半导体硅外延片	2023 年	262.87	259.84	16.89



产品	报告期	生产量	销售量	库存量
	2024 年	232.24	233.54	13.96
	2025 年	292.32	287.15	18.12

(2) 主要产品的销售区域

单位：万元

报告期	境内	境外
2023 年	20,567.94	114,159.67
2024 年	15,455.01	94,690.22
2025 年	18,747.66	111,488.91

(3) 主要销售客户与供应商情况

① 发行人主要销售客户情况

近三年，公司前五大客户合计销售金额分别为 103,600.32 万元、86,475.19 万元和 96,406.51 万元，前五大客户合计销售金额占年度销售总额比例为 76.85%、77.99%和 73.51%。发行人近三年前五大客户构成情况如下：

期间	客户名称	销售额（万元）	占年度销售总额比例（%）	是否与上市公司存在关联关系
2025 年度	客户一	36,298.62	27.68	否
	客户二	19,431.09	14.82	否
	客户三	16,542.36	12.61	否
	客户四	12,784.99	9.75	否
	客户五	11,349.44	8.65	否
	合计	96,406.50	73.51	/
2024 年度	客户一	31,383.87	28.31	否
	客户二	18,470.87	16.66	否
	客户三	13,454.99	12.14	否
	客户四	12,360.67	11.15	否
	客户五	10,804.78	9.75	否
	合计	86,475.19	77.99	/
2023 年度	客户一	34,442.83	25.55	否

期间	客户名称	销售额（万元）	占年度销售总额比例（%）	是否与上市公司存在关联关系
	客户二	31,819.87	23.60	否
	客户三	14,204.71	10.54	否
	客户四	11,621.78	8.62	否
	客户五	11,511.13	8.54	否
	合计	103,600.32	76.85	/

注：同一控制下合并口径披露。

②发行人主要供应商情况

近三年，公司前五大供应商合计采购金额分别为 15,594.01 万元、10,607.74 万元和 18,449.66 万元，前五大供应商合计采购金额占年度采购总额比例为 53.11%、45.81%和 44.82%。发行人近三年前五大供应商构成情况如下：

单位：万元

期间	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）	是否与上市公司存在关联关系
2025 年度	供应商一	8,690.73	21.11	是
	供应商二	3,660.50	8.89	否
	供应商三	2,374.12	5.77	否
	供应商四	2,133.24	5.18	否
	供应商五	1,591.07	3.87	否
	合计	18,449.66	44.82	/
2024 年度	供应商一	5,154.21	22.26	是
	供应商二	1,933.40	8.35	否
	供应商三	1,558.37	6.73	否
	供应商四	1,029.70	4.45	否
	供应商五	932.04	4.03	否
	合计	10,607.74	45.81	/
2023 年度	供应商一	8,998.93	30.65	是
	供应商二	2,853.93	9.72	否
	供应商三	1,531.12	5.21	否
	供应商四	1,242.51	4.23	否

期间	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
	供应商五	967.52	3.30	否
	合计	15,594.01	53.11	/

注：同一控制下合并口径披露。

九、发行人主要在建工程及拟建工程

（一）在建项目

截至 2026 年 3 月末，发行人重要在建工程情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资金额	已投资金额	合规性
低阻单晶成长及优质外延研发项目	77,500.00	56,838.00	已取得项目备案证书、环评批复及
12 英寸半导体大硅片产业化项目	257,454.00	73,493.00	土地使用权证书等合规性文件

注：已投资金额截至 2026 年 3 月末。

低阻单晶成长及优质外延研发项目系发行人 IPO 募投项目之一，本项目投资总额 77,500.00 万元，计划建设周期为 36 个月，建设内容主要包括厂房及厂务配套设施、购置 12 英寸外延生长及晶体成长相关研发设备及检测设备等。截至 2026 年 3 月末，本项目按计划正常建设，预计于 2026 年 11 月建设完毕，自有资金 77,500.00 万元已全部到位。本项目已取得项目备案证书（2204-410173-04-02-452968）、环评批复（郑港环审【2022】5 号）以及不动产权证书（豫【2018】郑港区不动产权第 0003015 号）等合规性文件。

12 英寸半导体大硅片产业化项目投资总额 257,454.00 万元，计划建设周期为 36 个月，建设内容主要包括厂务设施、生产设备（含长晶设备、切片设备、倒角设备、研磨设备、清洗机、背面处理设备、抛光设备、测试设备、外延设备）及其相关配套设施等。截至 2026 年 3 月末，本项目按计划正常建设，自有资金 78,343.00 万元已到位 32,500.00 万元。本项目已取得项目备案证书

(2311-410173-04-01-812151)、环评批复(郑港环审【2024】8号)以及不动产权证书(豫【2018】郑港区不动产权第 0003015 号)等合规性文件。

该等在建工程已取得与建设项目进展相匹配的批复文件,建设手续合法合规。

(二) 拟建项目

发行人无重大拟建项目。

十、发行人发展战略

半导体硅片作为芯片制造的关键原材料,技术门槛较高。目前,海外硅片企业在 12 英寸硅片制造领域的技术已较为成熟,形成了以信越化学、日本胜高、德国世创、SK Siltron、环球晶圆等国际硅片厂商主导的国际行业格局。国内半导体硅片企业的研发与产品应用时间相对较短,在技术和市场方面正处于奋力追赶的进程之中。

当前国内半导体硅片企业的 12 英寸硅片产销规模占全球市场的比重较低,亟需加强技术研发投入,扩大产能供应能力。公司通过募投项目的建设实施,将进一步增强公司在 12 英寸半导体硅外延领域的技术能力及核心竞争力。

半导体硅外延片是生产 MOSFET、IGBT 等功率器件和 PMIC、CMOS 等模拟器件的关键材料,下游需求持续增长,市场空间广阔。与此同时,半导体硅片行业是半导体产业链基础性的一环,也是我国半导体产业链与国际先进水平差距较大的环节,中国半导体硅外延片,尤其是 12 英寸半导体硅外延片,依赖进口程度较高,严重制约了中国半导体产业的发展。

公司作为国内较早开展半导体硅外延片产业化的公司,也是我国少数具备一体化半导体硅外延片制造能力的公司,坚持以成为世界领先的半导体电子材料供应商为发展战略。公司将继续加大对晶体成长、衬底成型及外延生长工艺的研发投入并持续扩充产能,进一步巩固在大尺寸半导体硅外延片领域的领先优势,本着功率器件 8 英寸外延片要成为标杆、12 英寸要尽快做强做大、差异化竞争、全面落实降本增效的战略方向,切实提升我国半导体硅外延片的自给程度以及行

业技术水平，增强我国半导体行业发展所需原材料的自主可控水平，促进我国半导体行业的发展。

一体化外延战略实施方面，为更好发挥公司技术优势、满足下游市场日益增长的需求，公司实施 12 英寸长晶、切片、研磨、抛光、外延技术提升及产能扩建项目，持续扩充外延片生产能力。与此同时，公司通过投资建设衬底片相关产线，实现自主供应外延衬底片，使得公司外延一体化程度逐年提升。

技术研发方面，公司持续加大技术研发投入，围绕晶体成长、衬底成型及外延生长等环节进行产品及技术创新，取得了多项关键核心技术及专利知识产权，同时带动报告期内公司研发投入占营业收入比例逐年提升。

客户市场方面，公司凭借自身行业领先的核心技术、优异的产品性能和可靠的产品质量，主要产品覆盖全球知名晶圆代工厂及功率器件 IDM 厂，包括华虹宏力、芯联集成、华润微、台积电、力积电、威世半导体、达尔、德州仪器、意法半导体、安森美等行业领先企业。

未来，公司将继续聚焦于发展半导体硅外延片业务，同时战略布局 SOI 等高端半导体电子材料领域，积极开展技术研发，秉承“功率器件 8 英寸外延片要成为标杆、12 英寸要尽快做强做大”的经营战略，不断推出适应客户需求的产品，扩充半导体硅外延片产能，提升公司市场地位和竞争优势。

（一）持续加大产品开发，扩充半导体硅外延片产能

公司将持续以市场需求为导向，密切追踪所在行业及细分领域最新的技术及发展趋势，结合下游应用领域的行业演变情况，根据客户定制化的需求，持续加大开发不同规格、不同参数的半导体硅外延片产品，精准满足客户需求。

此外，公司将持续扩充 12 英寸一体化半导体硅外延片产能，进一步提升公司业绩规模、丰富半导体硅外延片产品布局、增强公司产品品质，从而有效提升公司的行业地位及核心竞争力。

（二）持续加大研发投入，提升核心技术能力

技术水平是公司核心竞争力与市场领先地位的重要依托，公司将继续加大 8 英寸和 12 英寸长晶、衬底成型及外延技术的研发投入，购置研发设备，扩大研发团队，紧跟市场需求，不断提升半导体硅外延片生产技术水平。通过持续的研发投入，公司将不断提升外延片研发、生产全流程的技术水平，进一步巩固公司在半导体硅外延片领域的行业领先地位，提高产品竞争力。

（三）持续加强市场拓展

公司将继续深耕重点客户，巩固与重点客户长期稳定的良好合作关系，并进一步完善客户沟通渠道，加强为重点客户提供定制化产品及解决方案的服务能力，持续提升公司在半导体硅外延片领域的市场地位及品牌度。此外，公司将积极开拓国内外主要晶圆代工厂、功率器件 IDM 厂等客户资源，进一步提升公司营销服务能力。

（四）持续引入和培养高端人才，打造一流团队

半导体硅片行业属于技术密集型行业，优秀人才是持续保持公司的创新能力和竞争实力的核心要素。半导体硅外延片的研发、生产及销售对于公司员工的技术积累、研发能力、生产经验及业务能力均有较高要求。

为增强公司的竞争优势，进一步巩固公司的行业领先地位，公司将积极引进生产、管理及销售等方面的人才，大力引入具备丰富半导体硅外延片研发经验的高端科研人才，进一步壮大公司的研发人员队伍，加强对现有员工的培训，完善公司员工考核激励机制，为公司的长期发展打下坚实基础。

十一、行业状况

（一）行业现状及行业前景

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）所处行业及行业政策

公司主要从事半导体硅外延片的研发、生产及销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为第 39 大类“计算机、通信和其他电子设备制造业”之第 398 中类“电子元件及电子专用材料制造”。

根据国家发展改革委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版）》，6 英寸/8 英寸/12 英寸集成电路硅片列入战略性新兴产业重点产品目录。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，硅外延片属于国家重点支持的新材料行业。

半导体硅片行业为国家重点鼓励、扶持的战略性新兴产业，符合产业政策和国家经济发展战略，公司所处行业细分领域为半导体材料环节的半导体硅外延片。

发行人所处行业是我国重点鼓励发展的产业，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性和基础性产业。各相关部委相继出台了多项政策支持行业的发展，相关文件的主要内容如下：

序号	政策名称	发布时间	发布部门	相关内容
1	《关于做好 2025 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知》	2025 年	国家发展改革委、工信部、财政部、海关总署、税务总局	涉及集成电路产业的关键原材料、零配件（靶材、光刻胶、掩模版、封装基板、抛光垫、抛光液、8 英寸及以上硅单晶、8 英寸及以上硅片）生产企业享受税收优惠的政策条件
2	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	2023 年	国家发展改革委	鼓励类第二十八条第 4 款“集成电路”中包含“线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电路生产（含掩模版、8 英寸及以上硅片生产）”

序号	政策名称	发布时间	发布部门	相关内容
3	《电子信息制造业 2023-2024 年稳增长行动方案》	2023 年	工信部	面向个人计算、新型显示、VR/AR、5G 通信、智能网联汽车等重点领域，推动电子材料、电子专用设备和电子测量仪器技术攻关；面向数字经济等发展需求，优化集成电路、新型显示等产业布局并提升高端供给水平，增强材料、设备及零配件等配套能力
4	《关于做好 2022 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》	2022 年	国家发展改革委、工信部、财政部、海关总署、税务总局	提及集成电路产业的关键原材料、零配件（靶材、光刻胶、掩模版、封装基板、抛光垫、抛光液、8 英寸及以上硅单晶、8 英寸及以上硅片）生产企业享受税收优惠的政策条件
5	《“十四五”数字经济发展规划》	2022 年	国务院	提出着力提升关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。完善 5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系
6	《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 年版）》	2021 年	工信部	8-12 英寸硅单晶抛光片、8-12 英寸硅单晶外延片属于先进半导体材料列入指导目录并列为先进半导体材料

序号	政策名称	发布时间	发布部门	相关内容
7	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	2021 年	第十三届全国人大四次会议	聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域，加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用
8	《财政部海关总署税务总局关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》	2021 年	财政部、海关总署、税务总局	集成电路产业的关键原材料、零配件（含 8 英寸及以上硅单晶、8 英寸及以上硅片）生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的原材料、消耗品免征进口关税；集成电路用 8 英寸及以上硅片生产企业，进口国内不能生产或性能不能满足需求的净化室专用建筑材料、配套系统和生产设备（包括进口设备和国产设备）零配件免征进口关税。

（2）行业发展阶段

目前全球 95%以上的半导体器件采用硅片作为衬底，在硅片衬底的基础上，通过光刻、刻蚀、薄膜沉积、离子注入等多道工序完成各类半导体器件制作，因此硅片是芯片制造的地基。根据 SEMI 统计，九大类晶圆制造材料中硅片占比约 30%，是晶圆制造耗用最大的材料。半导体硅片市场景气度与下游半导体和终端应用市场高度相关。受益于智能手机、个人电脑、物联网、汽车电子、人工智能和高性能计算等终端需求持续涌现，根据 WSTS 统计，全球半导体市场规模从 2017 年的 4,122 亿美元提升至 2024 年的 6,269 亿美元，年均复合增长率为 6.17%。与此同时，根据 SEMI 统计，全球半导体级硅片（不含 SOI 硅片）销售规模从 2017 年 87 亿美元增长到 2024 年的 115 亿美元，年均复合增长率为 4.07%。

2022 年四季度开始，随着宏观经济波动和消费电子产品需求放缓，全球主要晶圆厂 2023 年产能利用率不足，导致 2023 年全球半导体级硅片市场规模同比行业景气峰值的 2022 年下滑至 124 亿美元。2024 年下半年随着下游复苏，半导体行业开始回暖，但半导体级硅片属于半导体产业链最上游，前期库存仍需一定时间消化，导致半导体级硅片市场回暖存在滞后性，2024 年全球半导体级硅片市场规模进一步降至 115 亿美元，但下降幅度同比 2023 年收窄，且 12 英寸硅片出货面积同比 2023 年已有所回升。在宏观政治环境维持稳定的情况下，2025 年半导体级硅片市场规模同比回升。

长期来看，智能化是全球经济发展的必然趋势，而半导体是人工智能时代的核心基础设施。随着全球贸易格局变化，各国已将半导体产业，尤其是半导体产业链的制造产能视为战略资源，美国、日本、韩国、欧盟与我国等纷纷推动半导体产业振兴相关政策，战略扶持本土半导体产业链以及先进半导体技术的研发。根据 SEMI 预计，2030 年全球半导体市场规模有望达到万亿美元，假设保持现有增速，全球半导体硅片市场规模届时有望翻倍，预计超过 200 亿美元。

（3）行业基本特点

半导体硅外延片的市场需求进一步扩大。近年来，受益于下游功率器件、模拟芯片市场规模的增长，外延片的市场需求也持续扩张。未来，随着越来越多智能终端及可穿戴设备的推出，新能源汽车、5G 通信、物联网等新应用的普及，IGBT、MOSFET 等功率器件及 CIS、PMIC 等模拟芯片产品的使用需求和应用范围均将进一步扩大。

国产化趋势显著。在国家高度重视、大力扶持半导体硅行业发展的大背景下，我国半导体产业快速发展，产业链各环节的产能和技术水平都取得了长足的进步，但相对而言，以硅片为代表的半导体材料仍是我国半导体产业较为薄弱的环节，对于进口的依赖程度依然较高，国产化替代空间广阔。

8 英寸产品目前占据主流，12 英寸成为未来发展趋势。超越摩尔定律方向包括功率器件、模拟芯片、传感器等细分市场，侧重于功能的多样化，是由应用需求驱动的，其核心是在一个芯片上拥有更多的功能，目前 8 英寸硅片在这个领域

占据主要地位。另一方面，安森美、华虹宏力、芯联集成等国内外知名大厂在制造功率器件时已开始使用 12 英寸外延片，12 英寸产品的优势越来越明显，所需的技术要求和数量规模也相应大幅提高。

（4）行业主要技术门槛

半导体硅片行业普遍存在技术壁垒，认证壁垒，设备壁垒及资金壁垒四大门槛，特别是半导体硅片的研发和生产过程繁多复杂，涉及固体物理、热力学、化学等多学科领域交叉，是典型的人才密集型，技术密集型行业。随着产业链下游的集成芯片制造工艺技术节点的推进及各个晶圆代工厂的硅片规格完全不同，各个终端产品的用途不同也会导致硅片的要求规格完全不同。

半导体硅片制造其核心工艺包括但不仅限于单晶生长工艺、衬底切片、研磨、蚀刻、抛光和外延生长技术。其中单晶工艺是最为核心的技术，其控制工艺能力决定了硅片尺寸、电阻率、纯度、氧含量、位错、晶体缺陷等关键技术指标。随着集成电路制造技术的飞速发展，硅片直径不断增大，特征线宽不断减小，对硅片芯片原生缺陷及杂质控制水平，表面颗粒缺陷，表面金属含量，表面平坦度及芯片边缘的平整度、硅片表面的纳米形貌等参数的要求规格越来越严格，这也就对硅片衬底的切片、研磨、蚀刻、抛光、清洗等整个生产关键节点的工艺能力提出了更为严格的要求，也对市场新进者形成了较高的技术壁垒。

2、公司所处的行业地位及面临的主要竞争状况

半导体硅片行业具有技术难度高、研发周期长、资本投入大、客户认证周期长等特点，因此全球半导体硅片行业集中度较高。国际硅片厂商长期占据较大的市场份额，排名前五的厂商分别为日本信越化学（Shin-Etsu）、日本胜高（Sumco）、环球晶圆（Global Wafers）、德国世创（Siltronic）、韩国 SK Siltron。

公司是中国少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导体硅外延片一体化制造商，实现了外延片的国产化，满足了国内半导体产业的需求。公司客户遍布北美、欧洲、中国、亚洲其他国家或地区，拥有良好的市场知名度和影响力。发行人已经为全球前十大晶圆代工厂中的 8 家公司、全球主要功率器件 IDM 厂供货，主要客户包括华虹宏力、芯联集成、华润微、台积电、

力积电、威世半导体、达尔、德州仪器、意法半导体、安森美等行业领先企业，并多次荣获华虹宏力、台积电、达尔等客户颁发的最佳或杰出供应商荣誉，是我国少数受到国际客户广泛认可的外延片制造商。

3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

半导体行业的发展主要分为两个方向：一类是以支撑线宽不断缩小为特征的深度摩尔定律方向，另一类是以应用功能多样化特征的超越摩尔定律方向。超越摩尔定律方向包括功率器件、模拟芯片、传感器等细分市场，侧重于功能的多样化，是由应用需求驱动的，其核心是在一个芯片上拥有更多的功能，满足互联网、物联网、生物医药、新能源等新兴领域的发展应用需求。超越摩尔定律方向是硅外延产品应用的主要领域，产品直径也从 8 英寸逐渐转到 12 英寸。

公司是一体化外延片的专业生产制造商，外延片是以抛光片为衬底材料进行外延生长形成的半导体硅片，主要用于制作 MOSFET、IGBT 等功率器件和 PMIC、CIS 等模拟芯片，符合超越摩尔定律的技术发展路线。

公司除现有模拟器件、功率半导体、传感器等硅外延产品外，还聚焦以下重点产品的挖掘和研发：

（1）CIS（CMOS 图像传感器）用外延产品方向。公司针对目标客户的高性能产品进行技术研发，开发具有高信噪比、高感亮度、高速全局快门捕捉、超宽动态范围、超高近红外感度、低功耗等特点的图像传感，将应用于特定领域及新兴需求。

（2）PMIC（电源管理芯片）用外延片方向。PMIC 主要用于电子设备系统中对电能进行管理和控制，主要功能包括电压转换、电流控制、电源轨管理、电源监控等。PMIC 使用的外延片具备耐高压、低导通电阻等特性，广泛应用于汽车、通信、电力、工业级消费电子等领域。

（3）车规级 SJ（超级结结构）、IGBT（绝缘栅双极型晶体管）用外延片产品方向。随着新能源车企趋向于大量采用国产芯片，减少对进口芯片的依赖，将进一步推动中国国内半导体产业的发展与进步，尤其是长续航能力电池组件及快充充电桩模块外延产品将迎来新一轮的爆发。

(4) AI 赋能产业焕新方向。目前国家大力推动算力基础设施高质量发展,而推动算力需要极大的储能及电力系统支持,这些方面皆需要外延片在逻辑产品、功率器件及影像辨识上持续发展,对公司而言,是挑战也是机遇。

(二) 公司核心竞争力

1、公司掌握外延片全流程生产的核心技术,产品多项关键技术指标处于国际先进水平

公司掌握晶体成长、衬底成型、外延生长等外延片全流程生产技术,具有相关研发技术专利并掌握核心工艺和使用知识。凭借在各个制程环节的丰富生产经验及在生产全流程的精细化质量控制能力,公司的外延片在电阻率片内均匀性、外延层厚度片内均匀性、表面颗粒等关键技术指标均处于国际先进水平。公司还掌握了高难度的定制化外延工艺,工艺水平已达到国际一线半导体芯片制造商的要求,受到了客户的高度认可。

经过多年的技术创新与积累,截至 2025 年 12 月 31 日,公司拥有境内外发明专利 34 项、实用新型专利 221 项、软件著作权 5 项。公司先后参与制定多个国家及地方标准,被评为国家级专精特新“小巨人”企业、“上海市科技小巨人企业”、上海市及郑州市认定的“专精特新”中小企业、中国电子材料行业协会半导体材料分会副理事长单位,300mm 外延片入选上海工业博物馆首批藏品,产品曾荣获中国国际工业博览会“优秀产品奖”、上海市战略关键领域技术攻关产业基础再造(工业强基)项目。

2、公司是我国少数具备外延片全流程生产能力的制造厂商,能够发挥一体化优势,提升产品品质并满足客户需求

外延片的生产主要可分为晶体成长、衬底成型及外延生长三个工艺环节,任一环节的技术和工艺水平均对外延片的质量有着至关重要的影响。公司是中国少数具备晶体成长、衬底成型及外延生长的外延片一体化生产能力的企业。

公司的一体化生产能力具有众多优势。首先,外延片是在衬底片上进行外延生长得到,因此衬底片的质量对外延片的质量有着重要的影响。通过采取一体化生产模式,公司对衬底片的质量具有更强的把控能力,从而增强外延片整体质量

稳定性。其次，下游客户对定制化外延片的需求日益增长，而定制化外延片的研发与生产需从晶体成长和衬底成型阶段即开始对工艺细节进行精准控制。通过采取一体化生产模式，公司可更好完成定制化产品的生产，满足客户的定制化需求。因此，凭借一体化生产模式，公司能够大幅提升产品品质并满足客户需求，有效提高公司竞争力。

3、公司凭借严格的生产管理体系，拥有稳定的产品质量控制能力

公司拥有一套集智能制造、精准控制、实时监测为一体的生产管理体系，能在较好地满足自动化生产、信息互联、定制服务等需求的同时，拥有突出的规模制造能力。

（1）智能制造：公司引入了 SAP 系统针对物料进行系统化管理，通过符合自身产品设计的 MES 生产管理系统实现智能生产和智能排产。一方面，智能生产确保工艺流程稳定，大幅提高了各环节的生产效率，保证了产线的高效运行；另一方面，智能排产在保证产品高质量的情况下，能够灵活为客户提供定制化产品服务，能够快速响应各类客户订单需求。

（2）精准控制：公司能够精准控制各关键工序，能够收集单个产品的全质量参数，从而实现产品制造过程的精准质量监测与全生命周期的质量追溯。公司已通过 ISO9001、IATF16949 质量管理体系认证，在生产中严格按照质量管理体系进行质量控制和管理，从进料收货、产品制造、成品入库至出货检测，均实施了完善的管控计划，并应用 SPC 进行品质管控，以力争达到产品零缺陷的目标。

（3）实时监测：公司自主开发了 FDC 系统（实时故障检测与分类系统），对于产品的品质由事后检验变为事中控制，能够自动推送实时制造状态信息，及时反馈生产不良率情况。公司通过对生产过程、产品参数施行全流程严格监控，确保了交付给客户产品的一致性、稳定性和可靠性。同时公司与主要客户实现了生产数据即时共享，可以将产品生产时间、出货时间等信息及时传递给客户。

4、公司产品通过众多国内外一线半导体厂商认证，已实现长期批量供货并取得客户广泛认可

半导体器件制造企业对外延片的质量有严苛的要求,对供应商的选择也非常慎重。下游芯片制造企业等客户在引入新的外延片供应商时,通常会进行严格的供应商认证。公司的产品已被众多国际级半导体大厂认证通过,并已与客户建立长期、稳固的合作关系。

十二、发行人其他经营重要事项

除本募集说明书已披露事项外,发行人未发生其他需要披露的重大或重要事项。

第六章 企业主要财务状况

一、公司近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况

（一）近三年及一期财务报告的编制基础

上海合晶财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

（二）近三年公司财务报告审计情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2023-2025 年度财务报告进行了审计，并分别出具了报告号为“信会师报字[2024]第 ZA11167 号”、“信会师报字[2025]第 ZA10189 号”和“信会师报字[2026]第 ZA10278 号”的标准无保留意见的审计报告。发行人 2026 年一季度财务报告未经审计。

（三）近三年及一期财务报告重大会计政策变更

1、2023 年会计政策变更

执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》财会(2022)31 号，以下简称“解释第 16 号”，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务

而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易)，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、2024 年会计政策变更

发行人 2024 年度无重大会计政策变更。

3、2025 年会计政策变更

发行人 2025 年度无重大会计政策变更。

4、2026 年一季度会计政策变更

发行人 2026 年一季度无重大会计政策变更。

（四）公司报告期内合并财务报表范围变动情况

1、2023 年度合并范围的变更

发行人 2023 年度无合并范围的变更。

2、2024 年度合并范围的变更

发行人 2024 年度无合并范围的变更。

3、2025 年度合并范围的变更

发行人 2025 年度无合并范围的变更。

4、2026 年一季度合并范围的变更

发行人 2026 年一季度无合并范围的变更。

(五) 发行人近三年及一期合并财务报表

发行人近三年及一期末合并资产负债表

单位：万元

项目	2026 年 3 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
流动资产：				
货币资金	61,582.50	67,148.86	130,435.51	44,286.89
应收票据	247.60	22.83	58.18	12.00
应收账款	22,612.37	24,860.74	20,626.15	19,843.34
应收款项融资	1.34	68.54	89.60	-
预付款项	1,200.71	1,544.45	1,293.41	1,152.14
其他应收款	19.04	13.62	12.04	8.19
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	36,514.36	34,374.16	31,526.32	34,073.44
其他流动资产	9,503.99	8,101.52	1,326.81	1,538.24
流动资产合计	131,681.91	136,134.73	185,368.04	100,914.23
非流动资产：				
其他债权投资	1,027.44	1,021.81	-	-
长期股权投资	1,762.32	2,088.63	-	-
固定资产	212,412.49	218,349.01	220,851.44	226,997.39
在建工程	117,719.81	107,815.23	15,193.70	15,287.52
使用权资产	2,087.44	2,342.60	3,497.97	4,473.00
无形资产	11,379.44	11,455.14	11,887.35	12,302.25
商誉	2.52	2.52	2.52	2.52
长期待摊费用	70.50	78.38	122.40	126.65
递延所得税资产	2,757.49	2,837.97	4,930.89	2,185.39
其他非流动资产	13,051.45	9,198.64	15,275.24	5,055.23
非流动资产合计	362,270.90	355,189.94	271,761.51	266,429.94
资产总计	493,952.81	491,324.67	457,129.54	367,344.18

项目	2026 年 3 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
流动负债:				
短期借款	-	-	1,000.76	12,022.90
衍生金融负债	12.17	-	-	-
应付账款	14,047.26	13,324.00	7,476.36	6,301.80
合同负债	4,795.10	4,858.52	7,411.09	8,379.37
应付职工薪酬	1,476.08	2,613.42	2,340.29	2,320.27
应交税费	319.37	735.75	555.13	807.96
其他应付款	1,281.93	1,277.57	962.70	1,208.46
其中: 应付利息	-	-	-	243.92
一年内到期的非流动负债	1,439.15	1,468.99	13,522.46	34,855.39
其他流动负债	192.50	18.69	19.54	12.00
流动负债合计	23,563.56	24,296.95	33,288.34	65,908.16
非流动负债:				
长期借款	48,550.00	48,550.00	2,200.00	14,510.69
租赁负债	1,026.64	1,418.43	2,513.62	3,638.34
递延收益	4,336.44	3,735.41	4,593.97	3,932.06
递延所得税负债	356.27	368.94	422.04	473.15
非流动负债合计	54,269.35	54,072.78	9,729.63	22,554.24
负债合计	77,832.92	78,369.72	43,017.97	88,462.39
所有者权益 (或股东权益):				
实收资本 (或股本)	66,919.54	66,545.84	66,545.84	59,585.43
资本公积	266,354.63	264,818.44	265,200.87	129,147.88
盈余公积	6,466.11	6,466.11	5,858.17	3,683.36
未分配利润	76,379.62	75,124.56	76,506.70	86,465.11
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	416,119.89	412,954.95	414,111.57	278,881.78
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益 (或股东权益) 合计	416,119.89	412,954.95	414,111.57	278,881.78
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	493,952.81	491,324.67	457,129.54	367,344.18

发行人近三年及一期合并利润表

单位: 万元



上海合晶硅材料股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业总收入	28,003.21	131,134.18	110,873.63	134,817.37
营业收入	28,003.21	131,134.18	110,873.63	134,817.37
营业总成本	25,826.06	116,984.81	97,313.29	109,799.78
营业成本	20,124.06	92,948.97	78,672.80	84,091.01
税金及附加	212.8	909.68	930.46	921.25
销售费用	185.07	1,005.78	918.57	921.97
管理费用	2,517.47	11,561.86	8,081.00	9,261.05
研发费用	2,387.86	11,421.39	9,992.77	11,664.31
财务费用	398.81	-862.87	-1,282.31	2,940.19
其中：利息费用	30.22	254.9	2,099.40	4,190.87
利息收入	118.06	1,638.55	2,208.35	621.77
加：其他收益	382.94	1,682.12	1,499.57	1,816.19
投资收益	-331.52	-189.7	5.47	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-326.31	-211.37	-	-
公允价值变动收益	24.6	4.08	15.74	-
信用减值损失	3.2	49.01	-10.52	24.15
资产减值损失	-673.57	-1,102.83	-1,415.90	-1,428.28
资产处置收益	12.71	187.77	-15.01	-20.43
营业利润	1,595.51	14,779.83	13,639.70	25,409.21
加：营业外收入	1.55	147.63	72.36	2,177.41
减：营业外支出	1.05	364.85	133.13	93.08
利润总额	1,596.00	14,562.62	13,578.93	27,493.54
减：所得税费用	340.95	2,027.65	1,500.60	2,807.44
净利润	1,255.06	12,534.97	12,078.34	24,686.10
持续经营净利润	1,255.06	12,534.97	12,078.34	24,686.10
减：少数股东损益	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	1,255.06	12,534.97	12,078.34	24,686.10
加：其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	1,255.06	12,534.97	12,078.34	24,686.10
减：归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
归属于母公司普通股股东综合收	1,255.06	12,534.97	12,078.34	24,686.10



上海合晶硅材料股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
益总额				

发行人近三年及一期合并现金流量表

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	30,306.83	123,583.33	109,514.28	143,646.46
收到的税费返还	570.07	7,476.64	4,959.41	5,116.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,754.22	6,246.48	4,499.98	6,083.25
经营活动现金流入小计	32,631.12	137,306.45	118,973.68	154,845.79
购买商品、接受劳务支付的现金	15,424.67	67,001.42	46,668.79	68,170.87
支付给职工及为职工支付的现金	5,320.94	21,104.25	18,843.97	18,512.28
支付的各项税费	1,098.47	2,875.29	2,398.31	4,134.88
支付其他与经营活动有关的现金	3,506.46	5,641.77	6,239.41	6,191.13
经营活动现金流出小计	25,350.55	96,622.73	74,150.47	97,009.16
经营活动产生的现金流量净额	7,280.58	40,683.72	44,823.20	57,836.63
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	4,000.00	-
取得投资收益收到的现金	0.30	3.95	21.22	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.60	1,681.62	55.40	774.78
投资活动现金流入小计	0.90	1,685.57	4,076.62	774.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,065.16	118,854.67	32,829.64	37,252.60
投资支付的现金	-	1,000.00	4,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	2,300.00	-	-
投资活动现金流出小计	13,065.16	122,154.67	36,829.64	37,252.60
投资活动产生的现金流量净额	-13,064.26	-120,469.10	-32,753.02	-36,477.83
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	142,068.90	-
取得借款收到的现金	-	49,000.00	1,000.00	20,609.76
收到其他与筹资活动有关的现金	2,061.62	-	-	-
筹资活动现金流入小计	2,061.62	49,000.00	143,068.90	20,609.76



项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
偿还债务支付的现金	-	15,679.09	45,786.35	34,534.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	378.24	14,004.39	21,952.82	9,928.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	196.76	1,923.04	2,889.22	1,884.87
筹资活动现金流出小计	574.99	31,606.52	70,628.39	46,347.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,486.63	17,393.48	72,440.51	-25,737.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-348.36	2,329.78	1,028.36	1,315.50
现金及现金等价物净增加额	-4,645.42	-60,062.11	85,539.04	-3,063.06
加：期初现金及现金等价物余额	65,953.67	126,015.78	40,476.74	43,539.80
期末现金及现金等价物余额	61,308.25	65,953.67	126,015.78	40,476.74

(六) 发行人近三年及一期母公司财务报表

发行人近三年及一期母公司资产负债表

单位：万元

项目	2026 年 3 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
流动资产：				
货币资金	23,062.26	19,319.40	12,286.79	15,727.65
应收账款	2,488.30	2,405.92	717.14	2,274.59
预付款项	499.17	428.90	389.22	113.15
其他应收款	9,461.36	182.14	373.71	247.91
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	11,790.00	27,560.00	12,360.00
存货	-	-	1,791.62	2,918.91
其他流动资产	-	-	992.73	381.72
流动资产合计	35,511.09	34,126.36	44,111.23	34,023.93
非流动资产：				
长期股权投资	269,660.20	269,986.51	137,897.88	137,897.88
固定资产	26,644.45	27,187.05	33,042.95	34,798.76
在建工程	-	-	-	394.99
使用权资产	52.10	56.75	237.15	273.53



上海合晶硅材料股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券

无形资产	5,422.64	5,473.49	5,880.31	6,085.33
长期待摊费用	70.50	78.38	126.65	153.83
递延所得税资产	1,948.23	1,895.12	1,323.96	796.65
其他非流动资产	1,089.70	455.64	9.03	17.48
非流动资产合计	304,887.84	305,132.94	178,517.93	180,418.46
资产总计	340,398.93	339,259.30	222,629.16	214,442.39
流动负债:				
应付账款	121.70	158.89	1,079.91	2,108.33
应付职工薪酬	75.49	169.36	222.11	278.04
应交税费	84.95	76.87	76.45	486.47
其他应付款	208.47	72.27	392.08	641.16
其中: 应付利息	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	21.33	19,089.43	4,805.23
流动负债合计	490.60	498.72	20,859.98	8,319.23
非流动负债:				
长期借款	-	-	-	19,041.56
租赁负债	40.13	39.11	183.58	231.45
递延收益	238.72	269.22	420.67	252.67
非流动负债合计	278.84	308.33	604.24	19,525.68
负债合计	769.44	807.04	21,464.23	27,844.91
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	66,919.54	66,545.84	59,585.43	59,585.43
资本公积	253,035.54	251,499.35	115,828.79	113,925.30
盈余公积	6,466.11	6,466.11	3,683.36	1,821.11
未分配利润	13,208.31	13,940.97	22,067.35	11,265.64
所有者权益(或股东权益)合计	339,629.49	338,452.26	201,164.93	186,597.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	340,398.93	339,259.30	222,629.16	214,442.39

发行人近三年及一期母公司利润表

单位: 万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	1,300.11	4,497.60	7,670.84	6,323.19
营业成本	1,295.02	6,617.64	8,647.89	8,456.28



上海合晶硅材料股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
税金及附加	60.49	240.57	309.83	302.72
销售费用	-9.66	27.38	146.89	381.44
管理费用	450.40	3,984.01	640.08	1,937.69
研发费用	-	304.70	443.42	531.75
财务费用	-8.59	-1,092.32	-929.94	1,035.69
其中：利息费用	0.47	27.75	605.45	1,176.33
减：利息收入	9.21	1,118.86	1,514.87	158.80
加：其他收益	30.50	374.35	216.79	504.06
投资净收益	-326.31	11,578.63	23,760.00	24,090.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-326.31	-211.37	-	-
公允价值变动净收益	-	-	-	-
信用减值损失	-2.91	-17.76	-0.15	0.64
资产减值损失	-	-	-303.16	-154.27
资产处置收益	-	183.21	46.95	1.48
营业利润	-786.26	6,534.06	22,133.10	18,119.52
加：营业外收入	0.60	0.37	60.40	0.00
减：营业外支出	0.11	262.07	97.42	24.33
利润总额	-785.77	6,272.36	22,096.08	18,095.20
减：所得税	-53.11	192.95	348.02	-527.30
净利润	-732.66	6,079.41	21,748.06	18,622.50
持续经营净利润	-732.66	6,079.41	21,748.06	18,622.50
加：其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-732.66	6,079.41	21,748.06	18,622.50

发行人近三年及一期母公司现金流量表

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	892.92	1,115.50	7,647.01	7,790.82
收到的税费返还	-	86.69	1,002.81	325.36
收到其他与经营活动有关的现金	9.31	7,759.78	4,367.05	3,450.00
经营活动现金流入小计	902.23	8,961.97	13,016.88	11,566.19

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
购买商品、接受劳务支付的现金	103.22	4,215.80	6,134.37	5,792.46
支付给职工及为职工支付的现金	334.26	2,839.65	2,973.35	2,956.39
支付的各项税费	136.18	382.62	284.05	712.64
支付其他与经营活动有关的现金	561.00	1,394.85	2,087.71	1,608.02
经营活动现金流出小计	1,134.66	8,832.92	11,479.48	11,069.51
经营活动产生的现金流量净额	-232.44	129.05	1,537.39	496.68
投资活动产生的现金流量:			-	-
取得投资收益收到的现金	2,947.50	23,760.00	27,560.00	8,890.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,652.78	110.86	208.10
投资活动现金流入小计	2,947.50	25,412.78	27,670.86	9,098.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	710.00	394.16	1,105.81	279.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	78,975.54	53,324.46	-
投资活动现金流出小计	710.00	79,369.70	54,430.26	279.06
投资活动产生的现金流量净额	2,237.50	-53,956.93	-26,759.40	8,819.04
筹资活动产生的现金流量:			-	-
吸收投资收到的现金	-	-	142,068.90	-
筹资活动现金流入小计	1,745.78	-	142,068.90	-
偿还债务支付的现金	-	6,329.09	12,712.47	4,760.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	13,375.19	20,568.05	7,127.53
支付其他与筹资活动有关的现金	5.62	716.45	1,679.50	680.01
筹资活动现金流出小计	5.62	20,420.73	34,960.01	12,567.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,740.16	-20,420.73	107,108.88	-12,567.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17.68	2,159.67	62.32	30.97
现金及现金等价物净增加额	3,727.55	-72,088.94	81,949.20	-3,221.24
加: 期初现金及现金等价物余额	19,334.72	91,090.82	9,141.62	12,362.86
期末现金及现金等价物余额	23,062.26	19,001.88	91,090.82	9,141.62

二、主要财务数据及指标分析

(一) 资产结构分析

最近三年及一期末，发行人资产结构情况如下：

单位：万元

科目	2026 年 3 月末		2025 年末		2024 年末		2023 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	61,582.50	12.47%	67,148.86	13.67%	130,435.51	28.53%	44,286.89	12.06%
应收票据	247.60	0.05%	22.83	0.00%	58.18	0.01%	12.00	0.00%
应收账款	22,612.37	4.58%	24,860.74	5.06%	20,626.15	4.51%	19,843.34	5.40%
应收款项融资	1.34	0.00%	68.54	0.01%	89.60	0.02%	-	-
预付款项	1,200.71	0.24%	1,544.45	0.31%	1,293.41	0.28%	1,152.14	0.31%
其他应收款	19.04	0.00%	13.62	0.00%	12.04	0.00%	8.19	0.00%
存货	36,514.36	7.39%	34,374.16	7.00%	31,526.32	6.90%	34,073.44	9.28%
其他流动资产	9,503.99	1.92%	8,101.52	1.65%	1,326.81	0.29%	1,538.24	0.42%
流动资产合计	131,681.91	26.66%	136,134.73	27.71%	185,368.04	40.55%	100,914.23	27.47%
其他债权投资	1,027.44	0.21%	1,021.81	0.21%	-	-	-	-
长期股权投资	1,762.32	0.36%	2,088.63	0.43%	-	-	-	-
固定资产	212,412.49	43.00%	218,349.01	44.44%	220,851.44	48.31%	226,997.39	61.79%
在建工程	117,719.81	23.83%	107,815.23	21.94%	15,193.70	3.32%	15,287.52	4.16%
使用权资产	2,087.44	0.42%	2,342.60	0.48%	3,497.97	0.77%	4,473.00	1.22%
无形资产	11,379.44	2.30%	11,455.14	2.33%	11,887.35	2.60%	12,302.25	3.35%
商誉	2.52	0.00%	2.52	0.00%	2.52	0.00%	2.52	0.00%
长期待摊费用	70.50	0.01%	78.38	0.02%	122.40	0.03%	126.65	0.03%
递延所得税资产	2,757.49	0.56%	2,837.97	0.58%	4,930.89	1.08%	2,185.39	0.59%
其他非流动资产	13,051.45	2.64%	9,198.64	1.87%	15,275.24	3.34%	5,055.23	1.38%
非流动资产合计	362,270.90	73.34%	355,189.94	72.29%	271,761.51	59.45%	266,429.94	72.53%
资产总计	493,952.81	100.00%	491,324.67	100.00%	457,129.54	100.00%	367,344.18	100.00%

最近三年及一期末，发行人总资产分别为 367,344.18 万元、457,129.54 万元、491,324.67 万元及 493,952.81 万元。总体保持增长。其中，2024 年末发行人总资产较 2023 年末增加 89,785.37 万元，增幅 24.44%，主要系 2024 年 2 月公司上市成功，取得募集资金净额约 13.9 亿元人民币，货币资金相应增加所致。

1、流动资产分析

报告期内，发行人流动资产主要为货币资金、应收账款及存货。最近三年及一期末，上述三个科目合计占发行人流动资产的比例分别为 97.31%、98.50%、92.84%和 91.67%。

(1) 货币资金

最近三年及一期末，发行人的货币资金金额分别为 44,286.89 万元、130,435.51 万元、67,148.86 万元和 61,582.50 万元，占流动资产的比例分别为 43.89%、70.37%、49.33%和 46.77%。发行人的货币资金明细如下：

单位：万元

项目	2026 年 3 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
库存现金	0.03	1.72	0.31	2.77
银行存款	61,308.22	66,269.47	129,851.75	43,619.14
其他货币资金	274.25	877.67	583.44	664.98
合计	61,582.50	67,148.86	130,435.51	44,286.89

2024 年末发行人货币资金余额增幅较大，主要系 2024 年 2 月公司上市成功，取得募集资金净额约 13.9 亿元人民币；随着募投项目的投资建设等因素，2025 年末和 2026 年 3 月末货币资金余额相较于 2024 年末有所下降。

(2) 应收票据及应收款项融资

最近三年及一期末，发行人的应收票据金额分别为 12.00 万元、58.18 万元、22.83 万元和 247.60 万元，占流动资产的比例分别为 0.01%、0.03%、0.02%和 0.19%，占比较小，均为银行承兑汇票。2026 年 3 月末，应收票据增长 984.54%，主要系本期内子公司扬州合晶收到客户的银行承兑汇票，导致应收票据规模大幅度增加，具备商业实质且存在合理性。

公司对于信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票，在其背书、贴现时终止确认，认定为兼有收取合同现金流量及出售目的的业务模式，列示为应收款项融资。2025 年末及 2026 年 3 月末，发行人的应收款项融资金额分别为 68.54 万元和 1.34 万元，占流动资产的比例分别为 0.05%和 0.00%，主要系客户用以支付货款所开具的银行承兑汇票。2026 年 3 月末，应收款项融资金额减少 98.04%，主要系期初持有的银行承兑汇票在本期陆续背书转让所致。

(3) 应收账款

最近三年及一期末，发行人的应收账款账面价值分别为 19,843.34 万元、20,626.15 万元、24,860.74 万元和 22,612.37 万元，占流动资产的比例分别为 19.66%、11.13%、18.26%和 17.17%。

报告期内，公司主要客户均为国内外知名半导体厂商，公司给予客户的信用期主要在 60 天以内，应收账款的账龄较短，回款状况良好，应收账款不能回收的风险较低。

报告期内应收账款账龄情况

单位：万元

账龄	2026 年 3 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
1 年以内（含 1 年）	22,670.62	24,922.40	20,667.81	19,942.12
1 至 2 年	-	-	68.93	-
小计	22,670.62	24,922.40	20,736.74	19,942.12
减：坏账准备	58.25	61.67	110.58	98.77
合计	22,612.37	24,860.74	20,626.15	19,843.34

截至 2026 年 3 月末，发行人应收账款账龄均为 1 年以内，均按照信用风险特征组合计提坏账准备。截至 2026 年 3 月末，发行人应收账款前五大客户应收账款金额合计占比 72.72%，具体详情如下：

单位：万元

2026 年 3 月末			
客户名称	应收账款金额	坏账准备	应收账款净额
客户 1	4,242.37	5.03	4,237.34
客户 2	4,040.31	4.04	4,036.27
客户 3	3,686.07	24.96	3,661.11
客户 4	2,620.09	6.13	2,613.96
客户 5	1,897.97	1.90	1,896.08
合计	16,486.81	42.05	16,444.76

注：同一控制下合并口径披露。

(4) 预付款项

最近三年及一期末，发行人的预付款项金额分别为 1,152.14 万元、1,293.41 万元、1,544.45 万元和 1,200.71 万元，占流动资产的比例分别为 1.14%、0.70%、1.13%和 0.91%，主要为租赁费、水电费和待摊费用等。

2025 年，发行人预付款项较 2024 年末增加 19.41%，主要原因系发行人向供应商采购原材料石英坩埚和向供应商采购 SAP 系统使用权费用的预付款项增长幅度较大所致；2026 年 3 月末，发行人预付款项较 2025 年末减少 22.26%，主要系发行人向供应商采购原材料石英坩埚和供应商采购 SAP 系统使用权费用的预付款项减少所致。

2026 年 3 月末，发行人预付款项前五名占预付款项的比例为 46.36%，具体情况如下表所示：

单位：万元

客户名称	预付款项金额
公司 1	195.42
公司 2	171.46
公司 3	68.05
公司 4	67.64
公司 5	53.99
合计	556.56

（5）其他应收款

最近三年及一期末，发行人的其他应收款金额分别为 8.19 万元、12.04 万元、13.62 万元和 19.04 万元，占流动资产的比例分别为 0.01%、0.01%、0.01%和 0.01%，金额较小，主要为备用金及暂支款、押金等。

（6）存货

最近三年及一期末，发行人的存货账面价值分别为 34,073.44 万元、31,526.32 万元、34,374.16 万元和 36,514.36 万元，金额总体保持稳定，占流动资产的比例分别为 33.76%、17.01%、25.25%和 27.73%。

发行人 2026 年 3 月 31 日存货构成列示

项目	2026 年 3 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	11,056.57	635.15	10,421.42
在产品	2,146.87	-	2,146.87
自制半成品	14,517.37	556.01	13,961.35
库存商品	4,812.58	114.94	4,697.63
周转材料	5,958.78	945.53	5,013.25
委托加工物资	273.82	-	273.82
合计	38,765.99	2,251.63	36,514.36

公司存货主要由原材料、自制半成品、库存商品、在产品、周转材料构成，其中原材料主要为外购的衬底片、多晶硅等；自制半成品主要为自制的晶棒、衬底片等；库存商品主要为外延片等产成品；周转材料主要为石墨基座、石英罩等零配件。

2024 年末，发行人存货余额较 2023 年末减少 2,547.12 万元，降幅为 7.48%，主要原因系 2024 年度受半导体景气度下行及市场需求疲软影响，公司销售备货需求相应减少所致。2025 年，发行人存货较 2024 年末增加 2,847.84 万元，增幅为 9.03%，主要系行业景气度企稳回升，发行人为满足产品订单需求增加了原材料和自制半成品备货所致。2026 年 3 月末，发行人存货余额较 2025 年末增加 2,140.20 万元，增幅为 6.23%，主要系子公司郑州合晶扩产过程中自制半成品增长所致。

（7）其他流动资产

最近三年及一期末，发行人的其他流动资产金额分别为 1,538.24 万元、1,326.81 万元、8,101.52 万元和 9,503.99 万元，占流动资产的比例分别为 1.52%、0.72%、5.95%和 7.22%，主要为待抵扣及未认证进项税额。2025 年末和 2026 年 3 月末，发行人其他流动资产较上一期末分别增长 510.60%和 17.31%，主要系子公司郑州合晶相关建设项目增值税留抵税额增加所致。

2、非流动资产分析

报告期内，发行人非流动资产主要为固定资产、在建工程、无形资产及其他非流动资产。最近三年及一期末，上述科目合计占发行人非流动资产的比例分别为 97.45%、96.85%、97.64%和 97.69%。

（1）其他债权投资

最近三年及一期末，发行人其他债权投资金额为 0 万元、0 万元、1,021.81 万元和 1,027.44 万元，主要为子公司上海晶盟购买的可转让大额存单。

（2）长期股权投资

最近三年及一期末，发行人长期股权投资金额为 0 万元、0 万元、2,088.63 万元和 1,762.32 万元，为发行人 2025 年 6 月与关联方 WICC 合资设立上海晶沛电子材料有限公司 40%股权和发行人 2025 年 10 月投资的深圳市芯威能半导体有限公司 6%股权。2026 年 3 月末，发行人长期股权投资较 2025 年末下降 15.62%，主要系上海晶沛电子材料有限公司设立后亏损，导致根据权益法列示上海晶沛电子材料有限公司的长期股权投资减少。

（3）固定资产

最近三年及一期末，发行人固定资产分别为 226,997.39 万元、220,851.44 万元、218,349.01 万元和 212,412.49 万元，主要为房屋及建筑物和机械设备，金额总体保持稳定，占非流动资产的比例分别为 85.20%、81.27%、61.47%和 58.63%。

发行人 2026 年 3 月末固定资产构成列示

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日			
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	67,798.48	16,510.17	-	51,288.31
固定资产装修	660.76	660.76	-	-
机械设备	328,182.01	168,327.38	135.13	159,719.50
运输设备	758.72	501.34	-	257.37
办公设备	1,667.16	1,267.48	-	399.69
其他设备	2,966.33	2,218.67	0.04	747.62

项目	2026 年 3 月 31 日			
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
合计	402,033.46	189,485.80	135.17	212,412.49

发行人固定资产主要由房屋建筑物和机械设备构成，其中房屋及建筑物主要为公司位于上海、郑州等地的厂房，机械设备主要为衬底片及外延片产线相关设备。

2024 年末、2025 年末及 2026 年 3 月末，发行人固定资产较上期末分别减少 6,145.95 万元、2,502.43 万元和 5,936.52 万元，降幅分别为 2.71%、1.13%和 2.72%，主要原因系固定资产折旧影响。

(4) 在建工程

最近三年及一期末，发行人在建工程分别为 15,287.52 万元、15,193.70 万元、107,815.23 万元和 117,719.81 万元，占非流动资产的比例分别为 5.74%、5.59%、30.35%和 32.50%。

发行人 2026 年 3 月末在建工程构成列示

单位：万元

项目	账面价值
郑州合晶硅材料有限公司 12 英寸半导体大硅片产业化项目	62,862.25
郑州合晶硅材料有限公司低阻单晶成长及优质外延研发项目	50,531.56
郑州合晶设备安装及改造项目	2,442.73
优质外延片研发及产业化项目	1,156.60
上海晶盟设备安装及改造项目	419.90
扬州厂设备安装及其他	200.92
12 英寸 P 型外延工艺研发及特色功率器件外延产品产能提升项目	35.82
郑州合晶高性能材料研发试验项目	70.04
合计	117,719.81

截至 2026 年 3 月末，公司在建工程主要为本次发行募投项目“郑州合晶硅材料有限公司 12 英寸半导体大硅片产业化项目”和 IPO 募投项目之“郑州合晶硅材料有限公司低阻单晶成长及优质外延研发项目”。

2025 年末及 2026 年 3 月末，公司在建工程余额增幅较大，主要原因系本次发行募投项目和 IPO 募投项目投入金额较大所致。

（5）无形资产

最近三年及一期末，发行人无形资产账面价值分别为 12,302.25 万元、11,887.35 万元、11,455.14 万元和 11,379.44 万元，占非流动资产的比例分别为 4.62%、4.37%、3.23%和 3.14%。发行人无形资产主要以土地使用权为主，主要系公司拥有的生产经营用地。

（6）递延所得税资产

最近三年及一期末，发行人递延所得税资产分别为 2,185.39 万元、4,930.89 万元、2,837.97 万元和 2,757.49 万元，占非流动资产的比例分别为 0.82%、1.81%、0.80%和 0.76%。2024 年末，发行人递延所得税资产较 2023 年末增长 125.63%，主要原因系股权激励产生之所得税暂时性差异所致。2025 年末，发行人递延所得税资产较 2024 年末减少 42.44%，主要原因系股权激励产生的所得税暂时性差异所致。

（7）其他非流动资产

最近三年及一期末，发行人其他非流动资产主要为构建长期资产的预付款项，金额分别为 5,055.23 万元、15,275.24 万元、9,198.64 万元和 13,051.45 万元，占非流动资产的比例分别为 1.90%、5.62%、2.59%和 3.60%。

2024 年 2 月上市后，公司按计划实施募投项目建设，使得募投项目相关长期资产预付款金额快速增长，导致自 2024 年起至 2026 年 3 月末，公司其他非流动资产余额总体处于较高水平。

（二）负债结构分析

最近三年及一期末，发行人负债结构情况如下：

单位：万元

科目	2026 年 3 月末		2025 年末		2024 年末		2023 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比

短期借款	-	-	-	-	1,000.76	2.33%	12,022.90	13.59%
衍生金融负债	12.17	0.02%	-	-	-	-	-	-
应付账款	14,047.26	18.05%	13,324.00	17.00%	7,476.36	17.38%	6,301.80	7.12%
合同负债	4,795.10	6.16%	4,858.52	6.20%	7,411.09	17.23%	8,379.37	9.47%
应付职工薪酬	1,476.08	1.90%	2,613.42	3.33%	2,340.29	5.44%	2,320.27	2.62%
应交税费	319.37	0.41%	735.75	0.94%	555.13	1.29%	807.96	0.91%
其他应付款	1,281.93	1.65%	1,277.57	1.63%	962.70	2.24%	1,208.46	1.37%
一年内到期的非流动负债	1,439.15	1.85%	1,468.99	1.87%	13,522.46	31.43%	34,855.39	39.40%
其他流动负债	192.50	0.25%	18.69	0.02%	19.54	0.05%	12.00	0.01%
流动负债合计	23,563.56	30.27%	24,296.95	31.00%	33,288.34	77.38%	65,908.16	74.50%
长期借款	48,550.00	62.38%	48,550.00	61.95%	2,200.00	5.11%	14,510.69	16.40%
租赁负债	1,026.64	1.32%	1,418.43	1.81%	2,513.62	5.84%	3,638.34	4.11%
递延收益	4,336.44	5.57%	3,735.41	4.77%	4,593.97	10.68%	3,932.06	4.44%
递延所得税负债	356.27	0.46%	368.94	0.47%	422.04	0.98%	473.15	0.53%
非流动负债合计	54,269.35	69.73%	54,072.78	69.00%	9,729.63	22.62%	22,554.24	25.50%
负债合计	77,832.92	100.00%	78,369.72	100.00%	43,017.97	100.00%	88,462.39	100.00%

最近三年及一期末,发行人负债合计分别为 88,462.39 万元、43,017.97 万元、78,369.72 万元及 77,832.92 万元, 2024 年末发行人负债规模下降幅度较大主要系发行人于 2024 年 2 月 IPO 发行上市后, 资金较为充裕, 陆续偿还有息负债, 使得短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款下降规模较大; 2025 年末及 2026 年 3 月末发行人负债规模有所提升, 主要系发行人 12 英寸硅片相关项目投资建设涉及的长期借款大幅增长所致。

1、流动负债分析

报告期内, 公司的流动负债主要包括短期借款、应付账款、合同负债、应付职工薪酬和一年内到期的非流动负债, 上述五个科目占流动负债的比例分别为 96.92%、95.38%、91.64%和 92.33%。

(1) 短期借款

最近三年及一期末，发行人短期借款分别为 12,022.90 万元、1,000.76 万元、0.00 万元和 0.00 万元，占流动负债比例分别为 18.24%、3.01%、0.00%和 0.00%。

2024 年与 2025 年，发行人短期借款规模及占比快速下降，主要原因系发行人 2024 年 2 月取得上市募集资金后陆续偿还短期借款所致。

（2）应付账款

最近三年及一期末，发行人应付账款分别为 6,301.80 万元、7,476.36 万元、13,324.00 万元和 14,047.26 万元，占流动负债比例分别为 9.56%、22.46%、54.84%和 59.61%。

公司的应付账款主要为原材料的采购以及设备、工程资产购置等所产生的应付款项。2025 年末及 2026 年 3 月末应付账款余额增幅较大，主要系发行人 12 英寸硅片相关项目投资建设涉及的采购增加所致。

公司近三年及一期末应付账款明细情况

单位：万元

项目	2026 年 3 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
应付设备	5,696.25	4,302.16	1,687.65	1,609.30
应付材料	6,837.03	7,993.48	5,033.41	4,009.86
应付费用	1,513.98	1,028.36	755.30	682.64
合计	14,047.26	13,324.00	7,476.36	6,301.80

2026 年 3 月末公司应付账款前五大明细情况

单位：万元、%

对手方名称	主要销售产品类别	金额	占当期末应付账款比例
公司 1	设备	2,180.90	15.53%
公司 2	设备	1,037.91	7.39%
公司 3	材料	1,001.43	7.13%
公司 4	设备、材料	769.30	5.48%
公司 5	材料	672.87	4.79%
合计	-	5,662.41	40.31%

2026 年 3 月末公司应付账款构成列示

项目	金额
1 年以内	13,615.93
1 至 2 年	268.10
2 至 3 年	93.49
3 年以上	69.74
合计	14,047.26

(3) 合同负债

最近三年及一期末，发行人合同负债分别为 8,379.37 万元、7,411.09 万元、4,858.52 万元和 4,795.10 万元，主要为预收货款，占流动负债比例分别为 12.71%、22.26%、20.00%和 20.35%。

报告期内，发行人合同负债规模逐年下降，主要系发行人依照过去与客户签订的长期供货协议并随发货情况逐渐减少预收的货款金额所致。

(4) 应付职工薪酬

最近三年及一期末，发行人应付职工薪酬分别为 2,320.27 万元、2,340.29 万元、2,613.42 万元和 1,476.08 万元，占流动负债比例分别为 3.52%、7.03%、10.76%和 6.26%。2026 年 3 月末发行人应付职工薪酬与 2025 年末相比下降 43.52%，主要系报告期内支付上年度年终奖所致。

(5) 一年内到期的非流动负债

最近三年及一期末，发行人一年内到期的非流动负债分别为 34,855.39 万元、13,522.46 万元、1,468.99 万元和 1,439.15 万元，占流动负债比例分别为 52.88%、40.62%、6.05%和 6.11%。

2024 年末及 2025 年末发行人一年内到期的非流动负债降幅较大，主要系发行人 2024 年 2 月取得上市募集资金后陆续偿还相关银行借款所致。

2、非流动负债分析

报告期内，公司的非流动负债主要包括长期借款、租赁负债和递延收益，上述三个科目占非流动负债的比例分别为 97.90%、95.66%、99.32%和 99.34%。公司非流动负债的具体情况如下：

（1）长期借款

最近三年及一期末，发行人长期借款分别为 14,510.69 万元、2,200.00 万元、48,550.00 万元和 48,550.00 万元，占非流动负债比例分别为 64.34%、22.61%、89.79%和 89.46%，具体情况如下表所示：

公司报告期内长期借款明细情况

单位：万元

项目	2026 年 3 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
抵押借款	48,000.00	48,000.00	2,200.00	14,510.69
信用借款	550.00	550.00	-	-
合计	48,550.00	48,550.00	2,200.00	14,510.69

2024 年末，发行人长期借款规模及占比快速下降，主要系 2024 年末发行人将于一年内到期的长期借款转列到一年内到期的非流动负债科目项下，同时长期借款整体金额随贷款条件逐期摊还而减少所致。2025 年末及 2026 年 3 月末，随着公司 12 英寸半导体大硅片产业化项目投资建设，发行人为了满足项目资金需求，与银行签署银团借款协议，使得长期借款余额大幅增长。

（2）租赁负债

最近三年及一期末，发行人租赁负债分别为 3,638.34 万元、2,513.62 万元、1,418.43 万元和 1,026.64 万元，占非流动负债比例分别为 16.13%、25.83%、2.62%和 1.89%。报告期内发行人租赁负债呈下降趋势，主要原因系发行人使用权资产摊销计提所致。

（3）递延收益

最近三年及一期末，发行人递延收益分别为 3,932.06 万元、4,593.97 万元、3,735.41 万元和 4,336.44 万元，报告期内金额总体保持稳定，占非流动负债比例分别为 17.43%、47.22%、6.91%和 5.57%。

(三) 盈利情况分析

表：发行人报告期内主要盈利指标

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	28,003.21	131,134.18	110,873.63	134,817.37
营业成本	20,124.06	92,948.97	78,672.80	84,091.01
销售费用	185.07	1,005.78	918.57	921.97
管理费用	2,517.47	11,561.86	8,081.00	9,261.05
研发费用	2,387.86	11,421.39	9,992.77	11,664.31
财务费用	398.81	-862.87	-1,282.31	2,940.19
营业利润	1,595.51	14,779.83	13,639.70	25,409.21
利润总额	1,596.00	14,562.62	13,578.93	27,493.54
净利润	1,255.06	12,534.97	12,078.34	24,686.10
归属于母公司所有者的净利润	1,255.06	12,534.97	12,078.34	24,686.10

1、营业收入

最近三年及一期,发行人营业收入分别为 134,817.37 万元、110,873.63 万元、131,134.18 万元和 28,003.21 万元, 主要受外延片产品影响。

2022 年-2024 年发行人营业收入有所下降, 主要受半导体行业周期下行、市场需求疲软及竞争加剧等因素影响, 2025 年随着行业景气度企稳回升, 营业收入同比增长 18.27%。2026 年 1-3 月, 发行人营业收入与去年同期基本一致。

2、期间费用分析

表：发行人近三年及一期期间费用明细

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占营收比例	金额	占营收比例	金额	占营收比例	金额	占营收比例
销售费用	185.07	0.66%	1,005.78	0.77%	918.57	0.83%	921.97	0.68%

项目	2026 年 1-3 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占营收比例	金额	占营收比例	金额	占营收比例	金额	占营收比例
管理费用	2,517.47	8.99%	11,561.86	8.82%	8,081.00	7.29%	9,261.05	6.87%
研发费用	2,387.86	8.53%	11,421.39	8.71%	9,992.77	9.01%	11,664.31	8.65%
财务费用	398.81	1.42%	-862.87	-0.66%	-1,282.31	-1.16%	2,940.19	2.18%
合计	5,489.21	19.60%	23,126.16	17.64%	17,710.03	15.97%	24,787.52	18.39%

最近三年及一期，发行人期间费用合计分别为 24,787.52 万元、17,710.03 万元、23,126.16 万元和 5,489.21 万元，占同期营业收入的比例分别为 18.39%、15.97%、17.64%和 19.60%，占比较为稳定。

（1）销售费用

发行人销售费用主要包括职工薪酬、样品及消耗品、办公及差旅费用和销售佣金等。最近三年及一期，发行人销售费用分别为 921.97 万元、918.57 万元、1,005.78 万元和 185.07 万元，总体金额相对较小且较为稳定。

（2）管理费用

发行人管理费用主要包括职工及董事薪酬、股份支付、折旧及摊销费用、行政费用等。最近三年及一期，发行人管理费用分别为 9,261.05 万元、8,081.00 万元、11,561.86 万元和 2,517.47 万元。

2024 年度，发行人管理费用较上年同期减少 12.74%，主要系股份支付费用回冲所致；2025 年度，发行人管理费用较上年同期增加 43.07%，主要系确认股份支付费用所致。

（3）研发费用

发行人研发费用主要包括折旧及摊销费用、人员费用、材料费、能源费用等。最近三年及一期，发行人研发费用分别为 11,664.31 万元、9,992.77 万元、11,421.39 万元和 2,387.86 万元。2024 年，发行人研发费用较上年有所下降，主要由于受半导体行业周期下行影响，下游市场需求较为疲软，发行人针对新产品研发投入

有所减少。2025 年，研发费用较上年同期增加 14.30%，主要由于 2025 年半导体行业景气度企稳回升，发行人为满足下游市场需求，相应增加当期研发投入。。

(4) 财务费用

发行人财务费用主要包括利息收入与支出、汇兑损益、结算手续费等。最近三年及一期，发行人财务费用分别为 2,940.19 万元、-1,282.31 万元、-862.87 万元和 398.81 万元。

2024 年度和 2025 年，发行人财务费用大幅减少，分别为-1,282.31 万元和 -862.87 万元，主要系 2024 年取得首发上市募集资金后，发行人将部分尚未投入募投项目的资金进行现金管理，相应产生的利息收入较多，以及陆续偿还长短期银行借款，利息费用降低所致。2026 年 1-3 月，发行人财务费用由负转正，主要系利息收入下降，及汇兑损失上升所致。

3、其他收益

发行人最近三年及一期其他收益金额分别为 1,816.19 万元、1,499.57 万元、1,682.12 万元和 382.94 万元，主要为取得的与日常经营活动相关的政府补助。

发行人 2025 年其他收益情况

单位：万元

项目	2025 年
政府补助	1,521.94
进项税加计抵减	148.43
代扣个人所得税手续费	11.75
合计	1,682.12

4、资产减值损失

发行人最近三年及一期资产减值损失分别为-1,428.28 万元、-1,415.90 万元、-1,102.83 万元和-673.57 万元，主要为存货跌价损失和固定资产减值损失，总体金额较小。

5、净利润

2023 年度至 2025 年度，公司净利润分别为 24,686.10 万元、12,078.34 万元以及 12,534.97 万元，其中 2023 年至 2024 年发行人净利润有所下滑，主要受半导体行业周期下行、市场需求疲软及竞争加剧等因素影响。一方面，受到全球宏观经济波动及半导体行业景气度下行影响，部分细分领域终端需求疲软、库存调整速度放缓，另一方面，国内半导体硅片市场竞争加剧，使得发行人销货数量与单价降低，同时导致单位产品分摊生产成本上升、毛利率及营业利润持续减少，综合导致净利润出现下滑。2025 年度起，随着半导体行业景气度企稳回升，发行人净利润同比实现增长。

（四）现金流量分析

公司近三年及一期现金流量表主要科目情况表

单位：万元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动现金流入小计	32,631.12	137,306.45	118,973.68	154,845.79
经营活动现金流出小计	25,350.55	96,622.73	74,150.47	97,009.16
经营活动产生的现金流量净额	7,280.58	40,683.72	44,823.20	57,836.63
投资活动现金流入小计	0.90	1,685.57	4,076.62	774.78
投资活动现金流出小计	13,065.16	122,154.67	36,829.64	37,252.60
投资活动产生的现金流量净额	-13,064.26	-120,469.10	-32,753.02	-36,477.83
筹资活动现金流入小计	2,061.62	49,000.00	143,068.90	20,609.76
筹资活动现金流出小计	574.99	31,606.52	70,628.39	46,347.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,486.63	17,393.48	72,440.51	-25,737.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-348.36	2,329.78	1,028.36	1,315.50
现金及现金等价物净增加额	-4,645.42	-60,062.11	85,539.04	-3,063.06

1、经营活动现金流量净额分析

近三年及一期，发行人经营活动现金流量净额分别为 57,836.63 万元、44,823.20 万元、40,683.72 万元和 7,280.58 万元，整体呈下降趋势。

2024 年发行人经营活动现金流量净额较 2023 年有所减少，主要受销货收入减少所致，另外 2023 年有政策性的大额退税，而 2024 年则无此情况。2025 年

发行人经营活动现金流量净额较 2024 年有所减少，主要系随着行业景气度回升，2025 年购买商品支付的现金增加所致。

2、投资活动现金流量净额分析

近三年及一期，发行人投资活动现金流量净额分别为-36,477.83 万元、-32,753.02 万元、-120,469.10 万元和-13,064.26 万元，发行人投资活动现金流出主要受购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及对外投资支出规模影响。

近三年及一期，发行人投资活动产生的现金流量持续为负，主要原因系发行人为提升外延片产品技术水平及产能扩充，持续购建一体化外延相关固定资产且相关资本支出金额较大所致。近三年及一期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额分别为 37,252.60 万元、32,829.64 万元、118,854.67 万元和 13,065.16 万元，其中 2025 年金额增幅较大，主要系发行人实施 IPO 和本次发行相关募投项目建设所致。

3、筹资活动现金流量净额分析

近三年及一期，发行人筹资活动现金流量净额分别为-25,737.37 万元、72,440.51 万元、17,393.48 万元和 1,486.63 万元。2023 年，发行人筹资活动现金流量为负，主要系发行人借款金额较大。2024 年发行人筹资活动净现金流量净额大幅上升，及 2025 年发行人筹资活动净现金流量净额大幅下降，主要系 2024 年取得上市首发募集资金约 13.9 亿元人民币所致。

（五）偿债能力分析

公司近三年及一期末主要偿债能力指标情况

项目	2026 年 1-3 月/ 月末	2025 年度/末	2024 年度/末	2023 年度/末
流动比率	5.59	5.60	5.57	1.53
速动比率	3.58	3.79	4.54	0.97
资产负债率	15.76%	15.95%	9.41%	24.08%
EBITDA（万元）	9,310.81	43,823.37	43,353.18	57,007.66

项目	2026 年 1-3 月/ 月末	2025 年度/末	2024 年度/末	2023 年度/末
EBITDA 利息保障倍数	308.07	171.92	20.65	13.60

注：2026 年 1-3 月 EBITDA 未年化

1、短期偿债能力分析

近三年及一期末，发行人流动比率分别为 1.53、5.57、5.60 和 5.59，速动比率分别为 0.97、4.54、3.79 和 3.58，发行人流动比率和速动比率总体保持上升趋势，主要系发行人借款持续减少，流动负债持续下降所致。

2、长期偿债能力分析

近三年及一期末，发行人资产负债率分别为 24.08%、9.41%、15.95%和 15.76%，整体呈下降趋势。近三年及一期，发行人 EBITDA 分别为 57,007.66 万元、43,353.18 万元、43,823.37 万元和 9,310.81 万元，EBITDA 利息保障倍数为 13.60、20.65、171.92 和 308.07，发行人 2024 年 IPO 募资后，借款大幅减少，导致 2025 年 EBITDA 利息保障倍数增长较大。

（六）运营效率分析

公司近三年及一期主要运营效率指标情况

项目	2026 年 1-3 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率（次/年）	4.72	5.77	5.48	5.23
存货周转率（次/年）	2.28	2.82	2.40	2.45
总资产周转率（次/年）	0.23	0.28	0.27	0.36

注：2026 年 1-3 月数据为年化后数据。

报告期内，发行人应收账款周转率及存货周转率均呈上升趋势，发行人资产运营情况持续改善。报告期内发行人总资产受生产运营发展以及 IPO 募集资金到账等因素影响持续上升，导致发行总资产周转率呈下降趋势。

三、有息债务情况

（一）发行人有息负债期限结构

近三年末，发行人各业务板块的有息负债结构如下：

发行人近三年有息负债情况

单位：万元

项目	2025 年末	2024 年末	2023 年末
短期借款	-	1,000.76	12,022.90
一年内到期的非流动负债	1,468.99	13,522.46	34,855.39
长期借款	48,550.00	2,200.00	14,510.69
合计	50,018.99	16,723.22	61,388.98

截至 2025 年末发行人各板块有息负债期限结构情况

单位：万元

到期时间	合计到期规模
1 年以内	1,468.99
1-2 年	48,550.00
合计	50,018.99

（二）发行人有息负债担保结构

公司的贷款担保方式以抵押借款为主。具体情况如下：

单位：万元

项目	合计
信用	550.00
抵押	48,000.00
合计	48,550.00

（三）发行人主要借款情况

截至 2025 年末发行人境内主要借款情况

单位：万元

借款主体	开始日	到期日	金额	借款利率	借款银行
郑州合晶	2025/3/28-2025/12/15	2035/3/24	48,000.00	3.20%	国开行、中行、建行
郑州合晶	2025/5/28	2028/5/28	550.00	2.40%	中行
合计			48,550.00	-	-

截至 2025 年末,发行人的有息负债金额为 5.00 亿元,主要以银行借款为主。有息负债中银行借款共 4.86 亿元,其余为租赁负债,占有息负债总额比例分别为 97.06%和 2.94%。

(四) 发行人债务融资工具发行情况

发行人尚无发行债务融资工具的情形。

四、发行人关联交易情况

(一) 关联方情况

1、发行人母公司

序号	关联方名称	关联关系
1	STIC	发行人直接控股股东、持有发行人 5%以上股份的股东

发行人最终控制方是合晶科技。

2、发行人子公司

发行人子公司有关信息详见“五、发行人重要权益投资情况”之“(一)全资及控股子公司”披露的相关信息。

3、合营及联营企业

发行人合营企业、联营企业有关信息详见“五、发行人重要权益投资情况”之“(二)参股公司情况”披露的相关信息。

4、公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
合晶科技股份有限公司	母公司控股股东
HELITEK COMPANY LTD.	受同一最终控制方合晶科技控制
盛美上海	公司董事的近亲属曾担任董事的企业
Cleanchip Technologies Limited	盛美上海子公司，基于实质重于形式原则认定为关联方

(二) 最近一年发行人与关联方的主要交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年度发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度
合晶科技	采购商品	8,890.32	18,000.00	否
盛美上海	采购商品	30.25	4,000.00	否

注：1、合晶科技包括：合晶科技股份有限公司、上海骅芯科技有限公司、HELITEK COMPANY LTD.，下同；2、盛美上海包括：盛美半导体设备(上海)股份有限公司、Cleanchip Technologies Limited，下同。

2、出售商品/提供劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年度发生额
合晶科技	销售商品	6,800.53

3、关联方资金拆借

截至 2025 年末，发行人不存在关联方资金拆借。

4、关联方租赁

发行人作为出租方：

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	2025 年度发生额
合晶科技	房屋及建筑物	32.92
合晶科技	机械设备等	308.63

5、关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年度发生额
合晶科技	出售固定资产	1,425.48
盛美上海	购买固定资产	2,289.41

6、关键管理人员薪酬

2025 年度，发行人关键管理人员薪酬为 407.82 万元。

7、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：万元

项目名称	关联方	2025 年末	
		账面余额	坏账准备
应收账款	合晶科技	3,566.83	19.73

(2) 应付项目

单位：万元

项目名称	关联方	2025 年末账面余额
应付账款	合晶科技	1,540.56

8、关联交易的定价及结算情况

公司基于业务发展的需要向关联人提供硅材料加工及销售服务，接受关联人提供的衬底片等产品，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款合理，关联交易的价格依据市场定价原则确定。关联交易的结算方式与非关联交易不存在重大差异。

经公司董事会和股东会审议通过后，公司将与关联方就交易的具体内容，根据业务的开展情况，签署具体的日常关联交易合同或订单。

9、关联交易的产生原因及影响

公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的业务往来活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司

和全部股东特别是中小股东的利益，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理制度》的规定。公司与上述关联人之间保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。

10、关联资金占用情况

报告期内，发行人不存在非经营性关联资金占用情况。

五、发行人或有事项

（一）对外担保

截至 2025 年末，发行人无对合并报表范围外企业提供担保的事项。

（二）重大未决诉讼、仲裁事项

截至 2025 年末，发行人无重大的未决诉讼、仲裁事项。

（三）重大承诺及其他或有事项

截至本募集说明书签署日，发行人无重大承诺及其他或有事项。

六、公司受限资产情况

截至 2025 年末，公司受限资产共计 29,787.28 万元，受限资产合计占总资产的比例为 6.06%，占净资产的比例为 7.16%，为货币资金、固定资产和无形资产。

截至 2025 年末，发行人受限资产情况如下：

单位：万元

资产名称	账面价值	受限类型	受限情况	抵押/质权人	受限期限
货币资金	697.67	保证金及 贷款专用 还款账户 等	进口设备保证 金或信用证以 及贷款条件要 求存款等	-	2026 年 2 月
	100.00				2027 年 6 月
	80.00				2027 年 12 月
	317.52				2026 年 1 月

资产名称	账面价值	受限类型	受限情况	抵押/质权人	受限期限
固定资产	24,615.28	抵押	银行贷款抵押担保	中国银行、建设银行、国开行	2035 年 3 月
无形资产	3,976.81	抵押	银行贷款抵押担保	中国银行、建设银行、国开行	2035 年 3 月
合计	29,787.28	-	-	-	-

截至 2026 年 3 月末，发行人已获得 180,000.00 万元额度的银团贷款，已使用额度 48,000.00 万元，为获取该银团贷款已抵押担保受限资产账面价值为 28,592.09 万元，抵押权人为国开行、建设银行、中国银行，受限期限至 2035 年 3 月。未来在“12 英寸半导体大硅片产业化项目”厂房建成后，郑州合晶将以其依法拥有的全部厂房不动产权和“12 英寸半导体大硅片产业化项目”购置的机器设备为该银团贷款提供抵押担保，抵押权人为国开行、建设银行、中国银行，受限期限至 2035 年 3 月。

七、持有衍生品、重大投资理财产品情况

（一）金融衍生品

截至 2025 年末，公司不存在重大衍生品投资的情形。

（二）重大投资理财产品

截至 2025 年末，公司不存在重大投资理财产品。

八、海外投资情况

截至 2025 年末，发行人主要投资经营实体均位于境内。截至 2025 年末，发行人境外资产为 62.31 万元，主要为境外采购及销售相关的货币资金，占总资产的比例为 0.01%，占比较小。

九、直接债务融资计划



截至本募集说明书签署日，除本次债券外，发行人不存在其他直接债务融资计划。

十、其他财务重要事项

无。

第七章 企业资信状况

一、发行人及其子公司授信情况

发行人及其子公司的债务性筹资渠道主要包括银行借款。截至本募集说明书签署日，发行人均能按时或提前归还各项债务本金并足额支付利息，无不良信用记录。截至 2026 年 3 月 31 日，发行人获得主要银行授信额度合计 27.23 亿元，主要授信银行包括中信银行、建设银行、中国银行、国开行等，其中已使用授信额度为 4.89 亿元，未使用授信额度 22.35 亿元，具体情况如下：

单位：万元

授信银行名称	授信额度	已使用额度	未使用额度
中信银行	40,000.00	-	40,000.00
国泰世华	4,846.00	-	4,846.00
建设银行	25,000.00	-	25,000.00
工商银行	5,000.00	-	5,000.00
富邦华一	4,500.00	-	4,500.00
交通银行	5,000.00	-	5,000.00
中国银行	8,000.00	850.00	7,150.00
银团（国开行、中行、建行）	180,000.00	48,000.00	132,000.00
合计	272,346.00	48,850.00	223,496.00

二、发行人债务违约记录

发行人与各银行之间建立了良好的银企合作关系，在金融机构中的信誉较好，与金融机构关系融洽，还本付息正常。经查人民银行征信系统信用报告，近三年发行人本部无银行借款违约记录。

三、发行人已发行债务融资工具偿还情况

截至本募集说明书签署日，发行人无已发行债务融资工具偿还的情况。

第八章 债务融资工具信用增进

本期债务融资工具无信用增进措施。

第九章 税项

根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期科技创新债券所应缴纳的税款由投资者承担。本期科技创新债券的投资人应遵守我国有关税务方面的法律、法规。本部分是依据我国现行的税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件的规定做出的。如果相关的法律、法规发生变更，本部分中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。

下列说明不构成对投资者的纳税建议和投资者纳税依据，也不涉及投资本期科技创新债券可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本期科技创新债券，并且投资者又属于按照法律规定需要遵守特别税务规定的投资者，公司建议投资者应向其专业顾问咨询有关的税务责任，公司不承担由此产生的任何责任。

一、增值税

根据 2016 年 5 月 1 日实施的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，金融商品转让（是指转让外汇、有价证券、非货物期货和其他金融商品所有权的业务活动），按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额，缴纳增值税。2024 年 12 月 25 日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过《中华人民共和国增值税法》，将自 2026 年 1 月 1 日起施行。根据《中华人民共和国增值税法》规定，销售金融商品的（金融商品在境内发行，或者销售方为境内单位和个人的）以及单位和个人无偿转让金融商品的，应当依照法律规定缴纳增值税。

二、所得税

根据 2008 年 1 月 1 日起执行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及其他相关的法律、法规，一般企业投资者来源于债券的利息所得应缴纳企业所得税。企业应将当期应收取的债券利息计入当期收入，核算当期损益后缴纳企业所得税。

三、印花税

根据 2022 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国印花税法》，在中国境内书立应税凭证、进行证券交易的个人或单位为印花税的纳税人，应当缴纳印花税。前述证券交易，是指转让在依法设立的证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的股票和以股票为基础的存托凭证。对债券在交易所市场或银行间市场进行的交易，我国目前还没有具体规定。发行人目前无法预测国家是否或将会于何时决定对有关债券交易征收印花税，也无法预测将会适用的税率水平。

四、税项抵销

本期科技创新债券投资者所应缴纳的税项与债务融资工具的各项支付不构成抵销。监管机关及自律组织另有规定的按规定执行。

第十章 信息披露安排

在本次科技创新债券发行过程及存续期间，公司将根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等文件对于信息披露管理制度的相关规定，通过全国银行间同业拆借中心、登记托管机构和北京金融资产交易所等信息披露服务平台向全国银行间债券市场披露下列有关信息，披露时间不晚于企业在证券交易所、指定媒体或其他场合向市场公开披露的时间。

一、发行人信息披露机制

（一）信息披露内部管理制度

公司按照中国银行间市场交易商协会的信息披露要求，已制定《上海合晶硅材料股份有限公司信用类债券信息披露管理制度》，并由董事会办公室具体负责和协调债务融资工具存续期间各类财务报表及与公司经营相关的所有重大信息的披露事项。

在本期债务融资工具发行过程及存续期间，发行人将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等文件的相关规定，通过中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)向全国银行间债券市场披露下列有关信息，并且披露时间不晚于企业按照境内外监管机构、市场自律组织、证券交易场所要求，或者将有关信息刊登在其他指定信息披露渠道上的时间。信息披露内容不低于《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》要求。

（二）信息披露管理机制

董事会办公室是公司信息披露事务管理工作的专门机构，在董事会秘书的领导下，统一负责公司的信息披露事务。

（三）信息披露负责部门

发行人信息披露负责人为董事会秘书，信息披露事务负责人信息如下：

披露信息事务负责人姓名：庄子祯

职位：董事会秘书

联系地址：上海市松江区石湖荡镇长塔路 558 号

电话：021-57843535

传真：86-21-57843572

电子邮箱：ir@wwxs.waferworks.com

二、本期发行相关文件

公司将在本次科技创新债券发行日 2 个工作日前，披露如下文件：

- 1、上海合晶硅材料股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券募集说明书；
- 2、上海合晶硅材料股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券法律意见书；
- 3、上海合晶硅材料股份有限公司 2023-2025 年度经审计的合并及母公司财务报告、2026 年第一季度未经审计的合并及母公司财务报表；
- 4、上海合晶硅材料股份有限公司信用类债券信息披露管理制度；
- 5、上海合晶硅材料股份有限公司信用评级报告；
- 6、中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件。

三、定期财务报告披露安排

发行人将在本次科技创新债券存续期间，按以下要求定期披露财务信息：

- 1、在每个会计年度结束之日起四个月内披露上一年年度报告。年度报告应当包含报告期内企业主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；

2、在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告；

3、定期报告的财务报表部分应当至少包含资产负债表、利润表和现金流量表。编制合并财务报表的公司，除提供合并财务报表外，还应当披露母公司财务报表；

4、针对债务融资工具，除上述要求外，在每个会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月內，分别披露本年度第一季度和第三季度的资产负债表、利润表和现金流量表，第一季度财务报表的披露时间不得早于上一年年度报告的披露时间。

上述信息的披露时间应不晚于企业按照境内外监管机构、市场自律组织、证券交易场所要求，或者将有关信息刊登在其他指定信息披露渠道上的时间。债务融资工具同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境外披露的信息，应当在境内同时披露。

四、本次科技创新债券存续期内重大事项披露安排

存续期内，发行人发生可能影响债务融资工具偿债能力或投资者权益的重大事项时，将及时披露，并说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。所称重大事项包括但不限于：

1、公司名称变更；

2、公司生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要业务陷入停顿、生产经营外部条件发生重大变化等；

3、公司变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管理人（如有）、信用评级机构；

4、公司 1/3 以上董事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；

5、公司法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；

6、公司控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变化；

7、公司提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%；

8、公司发生可能影响其偿债能力的资产出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为、重大资产重组；

9、公司发生超过上年末净资产 10%的重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的 10%；

10、公司股权、经营权涉及被委托管理；

11、公司丧失对重要子公司的实际控制权；

12、债务融资工具信用增进安排发生变更；

13、公司转移债务融资工具清偿义务；

14、公司一次承担他人债务超过上年末净资产 10%，或者新增借款超过上年末净资产的 20%；

15、公司未能清偿到期债务或企业进行债务重组；

16、公司涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织做出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；

17、公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；

18、公司涉及重大诉讼、仲裁事项；

19、公司发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；

20、公司拟分配股利，或发生减资、合并、分立、解散及申请破产的情形；

21、公司涉及需要说明的市场传闻；

22、债务融资工具信用评级发生变化；

23、公司订立其他可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重
大合同；

24、发行文件中约定或企业承诺的其他应当披露事项；

25、其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。

发行人在出现以下情形之日后 2 个工作日内，将履行上述重大事项的信息披露义务：

- （一）董事会或者其他有权决策机构就该重大事项形成决议时；
- （二）有关各方就该重大事项签署意向书或者协议时；
- （三）董事、高级管理人员或者具有同等职责的人员知悉该重大事项发生时；
- （四）收到相关主管部门关于重大事项的决定或通知时；

重大事项出现泄露或市场传闻的，发行人将在出现该情形之日后 2 个工作日内履行重大事项的信息披露义务。

已披露的重大事项出现重大进展或变化的，发行人将在进展或变化发生之日后 2 个工作日内披露进展或者变化情况及可能产生的影响。

五、本息兑付披露安排

发行人将至少于债务融资工具利息支付日或本金兑付日前 5 个工作日披露付息或兑付安排情况的公告；

对于债务融资工具偿付存在较大不确定性的，发行人将及时披露付息或兑付存在较大不确定性的风险提示公告；

对于债务融资工具未按照约定按期足额支付利息或兑付本金的，发行人将在当日披露未按期足额付息或兑付的公告；存续期管理机构将在不晚于次 1 个工作日披露未按期足额付息或兑付的公告；

债务融资工具违约处置期间，发行人及存续期管理机构将披露违约处置进展，发行人披露处置方案主要内容。发行人在处置期间支付利息或兑付本金的，将在 1 个工作日内进行披露。

六、涉及科技创新债券的专项信息披露

债务融资工具存续期间，如发行人因不再是科创板上市公司等原因不再符合科技创新债券认定标准的，应进行专项披露，专项披露文件应就原因、具体情况及可能影响进行说明。

企业擅自或违规发行科技创新债券的应在存续期进行更正披露，就原因、具体情况及可能影响进行说明。

第十一章 持有人会议机制

一、会议目的与效力

(一)【会议目的】持有人会议由本期债务融资工具持有人或其授权代表参加，以维护债务融资工具持有人的共同利益，表达债务融资工具持有人的集体意志为目的。

(二)【决议效力】除法律法规另有规定外，持有人会议所作出的决议对本期债务融资工具持有人，包括所有参加会议或未参加会议，同意议案、反对议案或放弃投票权，有表决权或无表决权的持有人，以及在相关决议作出后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。

持有人会议决议根据法律法规或当事人之间的约定对发行人产生效力。

二、会议权限与议案

(一)【会议权限】持有人会议有权围绕本募集说明书、受托管理协议（如有）及相关补充协议项下权利义务实现的有关事项进行审议与表决。

(二)【会议议案】持有人会议议案应有明确的待决议事项，遵守法律法规和银行间市场自律规则，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益及他人合法权益。

下列事项为特别议案：

- 1.变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排；
- 2.新增、变更本募集说明书中的选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制、投资人保护条款以及争议解决机制；
- 3.聘请、解聘、变更受托管理人（如有）或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；

4.除合并、分立外，向第三方转移本期债务融资工具清偿义务；

5.变更可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的其他约定。

三、会议召集人与召开情形

(一)【召集人及职责】存续期管理机构为本期债务融资工具持有人会议的召集人。召集人联系方式：

机构名称：中信证券股份有限公司

联络人姓名：谢雯、张俊晖、黄应桥、田浩楠、范森荣、赵炜

联系方式：021-20262238

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

邮箱：project_shhj2025@citics.com

召集人负责组织召开持有人会议，征求与收集债务融资工具持有人对会议审议事项的意见，履行信息披露、文件制作、档案保存等职责。

召集人知悉持有人会议召开情形发生的，应当在实际可行的最短期限内或在本募集说明书约定期限内召集持有人会议；未触发召开情形但召集人认为有必要召集持有人会议的，也可以主动召集。

召集人召集召开持有人会议应当保障持有人提出议案、参加会议、参与表决等自律规则规定或本募集说明书约定的程序权利。

(二)【代位召集】召集人不能履行或者不履行召集职责的，以下主体可以自行召集持有人会议，履行召集人的职责：

1.发行人；

2.增进机构（如有）；

3.受托管理人（如有）；

4.出现本节第（三）（四）所约定情形的，单独或合计持有 10%以上本期债务融资工具余额的持有人；

5.出现本节第（五）所约定情形的，单独或合计持有 30%以上本期债务融资工具余额的持有人。

（三）【强制召开情形】在债务融资工具存续期间，出现以下情形之一的，召集人应当召集持有人会议：

- 1.发行人未按照约定按期足额兑付本期债务融资工具本金或利息；
- 2.发行人拟解散、申请破产、被责令停产停业、暂扣或者吊销营业执照；
- 3.发行人、增进机构（如有）或受托管理人（如有）书面提议召开持有人会议对特别议案进行表决；
- 4.单独或合计持有 30%以上本期债务融资工具余额的持有人书面提议召开；
- 5.法律、法规及相关自律规则规定的其他应当召开持有人会议的情形。

（四）【提议召开情形】存续期内出现以下情形之一，且有单独或合计持有 10%以上本期债务融资工具余额的持有人、受托管理人（如有）、发行人或增进机构（如有）书面提议的，召集人应当召集持有人会议：

- 1.本期债务融资工具信用增进安排、增进机构（如有）偿付能力发生重大不利变化；
- 2.发行人发行的其他债务融资工具或境内外债券的本金或利息未能按照约定按期足额兑付；
- 3.发行人及合并范围内子公司拟出售、转让、划转资产或放弃其他财产，将导致发行人净资产减少单次超过上年末经审计净资产的 10%；
- 4.发行人及合并范围内子公司因会计差错更正、会计政策或会计估计的重大自主变更等原因，导致发行人净资产单次减少超过 10%；
- 5.发行人最近一期净资产较上年末经审计净资产减少超过 10%；
- 6.发行人及合并范围内子公司发生可能导致发行人丧失其重要子公司实际控制权的情形；

7. 发行人及合并范围内子公司拟无偿划转、购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，构成重大资产重组的；

8. 发行人进行重大债务重组；

9. 发行人拟合并、分立、减资，被暂扣或者吊销许可证件；

发行人披露上述事项的，披露之日起 15 个工作日内无人提议或提议的投资人未满足 10% 的比例要求，或前期已就同一事项召开会议且相关事项未发生重大变化的，召集人可以不召集持有人会议。

发行人未披露上述事项的，提议人有证据证明相关事项发生的，召集人应当根据提议情况及时召集持有人会议。

（五）【其他召开情形】存续期内虽未出现本节（三）（四）所列举的强制、提议召开情形，单独或合计持有 10% 以上本期债务融资工具余额的持有人、受托管理人（如有）、发行人或增进机构（如有）认为有需要召开持有人会议的，可以向召集人书面提议。

召集人应当自收到书面提议起 5 个工作日内向提议人书面回复是否同意召集持有人会议。

（六）【提议渠道】持有人、受托管理人（如有）、发行人或增进机构（如有）认为有需要召开持有人会议的，应当将书面提议发送至 project_shhj2025@citics.com 或通过“NAFMII 综合业务和信息服务平台存续期服务系统”（以下简称“系统”）发送给召集人。

（七）【配合义务】发行人或者增进机构（如有）发生本节（三）（四）所约定召开情形的，应当及时披露或告知召集人。

四、会议召集与召开

（一）【召开公告】召集人应当至少于持有人会议召开日前 10 个工作日披露持有人会议召开公告（以下简称“召开公告”）。召开公告应当包括本期债务融资

工具基本信息、会议召开背景、会议要素、议事程序、参会表决程序、会务联系方式等内容。

（二）【议案的拟定】召集人应当与发行人、持有人或增进机构（如有）等相关方沟通，并拟定议案。提议召开持有人会议的机构应当在书面提议中明确拟审议事项。

召集人应当至少于持有人会议召开日前 7 个工作日将议案披露或发送持有人。议案内容与发行人、增进机构（如有）、受托管理人（如有）等机构有关的，应当同时发送至相关机构。持有人及相关机构未查询到或收到议案的，可以向召集人获取。

（三）【补充议案】发行人、增进机构（如有）、受托管理人（如有）、单独或合计持有 10%以上本期债务融资工具余额的持有人可以于会议召开日前 5 个工作日以书面形式向召集人提出补充议案。

召集人拟适当延长补充议案提交期限的，应当披露公告，但公告和补充议案的时间均不得晚于最终议案概要披露时点。

（四）【议案整理与合并】召集人可以提出补充议案，或在不影响提案人真实意思表示的前提下对议案进行整理合并，形成最终议案，并提交持有人会议审议。

（五）【最终议案发送及披露】最终议案较初始议案有增补或修改的，召集人应当在不晚于会议召开前 3 个工作日将最终议案发送至持有人及相关机构。

召集人应当在不晚于会议召开前 3 个工作日披露最终议案概要，说明议案标题与主要内容等信息。召集人已披露完整议案的，视为已披露最终议案概要。

（六）【参会权的确认与核实】持有人会议债权登记日为持有人会议召开日的前 1 个工作日。

除法律、法规及相关自律规则另有规定外，在债权登记日确认债权的债务融资工具持有人有权参加会议。债务融资工具持有人应当于会议召开前提供债权登记日的债券账务资料以证明参会资格。召集人应当对债务融资工具持有人或其授

权代表的参会资格进行确认，并登记其名称以及持有份额。债务融资工具持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参加會議和参与表决。

持有人可以通过提交参会回执或出席持有人会议的方式参加会议。

(七)【列席机构】发行人、债务融资工具清偿义务承继方(以下简称“承继方”)、增进机构(如有)等相关方应当配合召集人召集持有人会议，并按照召集人的要求列席持有人会议。

受托管理人(如有)不是召集人的，应当列席持有人会议，及时了解持有人会议召开情况。

信用评级机构、存续期管理机构、为持有人会议的合法合规性出具法律意见的律师可应召集人邀请列席会议。

(八)【召集程序的缩短】发行人出现公司信用类债券违约以及其他严重影响持有人权益突发情形的，召集人可以在不损害持有人程序参与权的前提下，合理缩短持有人会议召集、召开与表决程序。

若发行人未发生上述情形，但召集人拟缩短持有人会议召集程序的，需向本次持有人会议提请审议缩短召集程序的议案，与本次持有人会议的其他议案一同表决。缩短召集程序议案应当经参加会议持有人所持表决权 2/3 以上，且经本期债务融资工具总表决权超过 1/2 通过。

会议程序缩短的，召集人应当提供线上参会的渠道及方式，并且在持有人会议召开前将议案发送至持有人及相关机构、披露最终议案概要。

(九)【会议的取消】召开公告发布后，持有人会议不得随意延期、变更。

出现相关债务融资工具债权债务关系终止，召开事由消除或不可抗力等情形，召集人可以取消本次持有人会议。召集人取消持有人会议的，应当发布会议取消公告，说明取消原因。

五、会议表决和决议

(一)【表决权】债务融资工具持有人及其授权代表行使表决权，所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。未参会的持有人不参与表决，其所持有的表决权计入总表决权。

(二)【关联方回避】发行人及其重要关联方持有债务融资工具的，应当主动以书面形式向召集人表明关联关系，除债务融资工具由发行人及其重要关联方全额合规持有的情况外，发行人及其重要关联方不享有表决权。重要关联方包括：

1. 发行人或承继方控股股东、实际控制人；
2. 发行人或承继方合并范围内子公司；
3. 本期债务融资工具承继方、增进机构（如有）；
4. 其他可能影响表决公正性的关联方。

(三)【会议有效性】参加会议持有人持有本期债务融资工具总表决权超过 1/2，会议方可生效。

(四)【表决要求】持有人会议对列入议程的各项议案分别审议、逐项表决，不得对公告、议案中未列明的事项进行审议和表决。持有人会议的全部议案应当不晚于会议召开首日后的 3 个工作日内表决结束。

(五)【表决统计】召集人应当根据登记托管机构提供的本期债务融资工具表决截止日持有人名册，核对相关债项持有人当日债券账务信息。表决截止日终无对应债务融资工具面额的表决票视为无效票，无效票不计入议案表决的统计中。

持有人未做表决、投票不规范或投弃权票、未参会的，视为该持有人放弃投票权，其所持有的债务融资工具面额计入议案表决的统计中。

(六)【表决比例】除法律法规另有规定或本募集说明书另有约定外，持有人会议决议应当经参加会议持有人所持表决权超过 1/2 通过；针对特别议案的决议，应当经参加会议持有人所持表决权 2/3 以上，且经本期债务融资工具总表决权超过 1/2 通过。

(七)【决议披露】召集人应当在不晚于持有人会议表决截止日后的 2 个工作日内披露会议决议公告。会议决议公告应当包括参会持有人所持表决权情况、会议有效性、会议审议情况等内容。

(八)【律师意见】本期债务融资工具持有人会议特别议案的表决，应当由律师就会议的召集、召开、表决程序、参加会议人员资格、表决权有效性、议案类型、会议有效性、决议情况等事项的合法合规性出具法律意见，召集人应当在表决截止日后的 2 个工作日内披露相应法律意见书。

法律意见应当由 2 名以上律师公正、审慎作出。律师事务所应当在法律意见书中声明自愿接受交易商协会自律管理，遵守交易商协会的相关自律规则。

(九)【决议答复与披露】发行人应当对持有人会议决议进行答复，相关决议涉及增进机构（如有）、受托管理人（如有）或其他相关机构的，上述机构应当进行答复。

召集人应当在会议表决截止日后的 2 个工作日内将会议决议提交至发行人及相关机构，并代表债务融资工具持有人及时就有关决议内容与相关机构进行沟通。发行人、相关机构应当自收到会议决议之日后的 5 个工作日内对持有人会议决议情况进行答复。

召集人应当不晚于收到相关机构答复的次一工作日内协助相关机构披露。

六、其他

(一)【承继方义务】承继方按照本章约定履行发行人相应义务。

(二)【保密义务】召集人、参会机构、其他列席会议的机构对涉及单个债务融资工具持有人的持券情况、投票结果等信息承担保密义务，不得利用参加会议获取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违规活动，损害他人合法权益。

(三)【会议记录】召集人应当对持有人会议进行书面记录并留存备查。持有人会议记录由参加会议的召集人代表签名。

(四)【档案保管】召集人应当妥善保管持有人会议的会议公告、会议议案、参会机构与人员名册、表决机构与人员名册、参会证明材料、会议记录、表决文件、会议决议公告、持有人会议决议答复(如有)、法律意见书(如有)、召集人获取的债权登记日日终和会议表决截止日日终债务融资工具持有人名单等会议文件和资料,并至少保管至本期债务融资工具债权债务关系终止之日起 5 年。

(五)【存续期服务系统】本期债务融资工具持有人会议可以通过系统召集召开。

召集人可以通过系统发送议案、核实参会资格、统计表决结果、召开会议、保管本节第(四)条约定的档案材料等,债务融资工具持有人可以通过系统进行书面提议、参会与表决等,发行人、增进机构(如有)、受托管理人(如有)等相关机构可以通过系统提出补充议案。

(六)【释义】本章所称“以上”,包括本数,“超过”不包含本数;所称“净资产”,指企业合并范围内净资产;所称“披露”,是指在《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》中规定的信息披露渠道进行披露。

(七)【其他情况】本章关于持有人会议的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》要求不符的,或本章内对持有人会议机制约定不明的,按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》要求执行。

(八)【科技创新债券】企业擅自或违规发行科技创新债券的,应提请召开持有人会议向投资人进行解释说明,保护投资人的合法权益。

第十二章 主动债务管理

在本期债务融资工具存续期内，发行人可能根据市场情况，依据法律法规、规范性文件和协会相关自律管理规定及要求，在充分尊重投资人意愿和保护投资人合法权益的前提下，遵循平等自愿、公平清偿、诚实守信的原则，对本期债务融资工具进行主动债务管理。发行人可能采取的主动债务管理方式包括但不限于置换、同意征集等。

一、置换

置换是指非金融企业发行债务融资工具用于以非现金方式交换其他存续债务融资工具（以下统称置换标的）的行为。

企业若将本期债务融资工具作为置换标的实施置换，将向本期债务融资工具的全体持有人发出置换要约，持有人可以其持有的全部或部分置换标的份额参与置换。

参与置换的企业、投资人、主承销商等机构应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具置换业务指引（试行）》以及交易商协会相关规定实施置换。

二、同意征集机制

同意征集是指债务融资工具发行人针对可能影响持有人权利的重要事项，主动征集持有人意见，持有人以递交同意回执的方式形成集体意思表示，表达是否同意发行人提出的同意征集事项的机制。

（一）同意征集事项

在本期债务融资工具存续期内，对于需要取得本期债务融资工具持有人同意后方能实施的以下事项，发行人可以实施同意征集：

1. 变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排；

2.新增、变更发行文件中的选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制、投资人保护条款以及争议解决机制；

3.聘请、解聘、变更受托管理人（如有）或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；

4.除合并、分立外，发行人拟向第三方转移本期债务融资工具清偿义务；

5.变更可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的其他约定。

6.其他按照交易商协会自律管理规定可以实施同意征集的事项。

（二）同意征集程序

1.同意征集公告

发行人实施同意征集，将通过交易商协会认可的渠道披露同意征集公告。同意征集公告内容包括但不限于下列事项：

（1）本期债务融资工具基本信息；

（2）同意征集的实施背景及事项概要；

（3）同意征集的实施程序：包括征集方案的发送日、发送方式，同意征集开放期、截止日（开放期最后一日），同意回执递交方式和其他相关事宜；

（4）征集方案概要：包括方案标题、主要内容等；

（5）发行人指定的同意征集工作人员的姓名及联系方式；

（6）相关中介机构及联系方式（如有）；

（7）一定时间内是否有主动债务管理计划等。

2.同意征集方案

发行人将拟定同意征集方案。同意征集方案应有明确的同意征集事项，遵守法律法规和银行间市场自律规则，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益及他人合法权益。

发行人存在多个同意征集事项的，将分别制定征集方案。

3.同意征集方案发送

发行人披露同意征集公告后,可以向登记托管机构申请查询债务融资工具持有人名册。持有人名册查询日与征集方案发送日间隔应当不超过 3 个工作日。

发行人将于征集方案发送日向持有人发送征集方案。

征集方案内容与增进机构(如有)、受托管理人(如有)等机构有关的,方案应同时发送至相关机构。持有人及相关机构如未收到方案,可向发行人获取。

4.同意征集开放期

同意征集方案发送日(含当日)至持有人递交同意回执截止日(含当日)的期间为同意征集开放期。本期债务融资工具的同意征集开放期最长不超过 10 个工作日。

5.同意回执递交

持有人以递交同意回执的方式表达是否同意发行人提出的同意征集事项。持有人应当在同意征集截止日前(含当日)将同意征集回执递交发行人。发行人存在多个同意征集事项的,持有人应当分别递交同意回执。

6.同意征集终结

在同意征集截止日前,单独或合计持有超过 1/3 本期债务融资工具余额的持有人,书面反对发行人采用同意征集机制就本次事项征集持有人意见的,本次同意征集终结,发行人应披露相关情况。征集事项触发持有人会议召开情形的,持有人会议召集人应根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本募集说明书的约定,另行召集持有人会议。

(三) 同意征集事项的表决

1.持有人所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。未提交同意回执的持有人不参与表决,其所持有的表决权计入总表决权。

2.发行人及其重要关联方除非全额合规持有本期债务融资工具,否则不享有表决权。利用、隐瞒关联关系侵害其他人合法利益的,相关方应承担相应法律责任。

3. 发行人根据登记托管机构提供的同意征集截止日持有人名册，核对相关债项持有人当日债券账务信息。

同意征集截止日终无对应债务融资工具面额的同意回执视为无效回执，无效回执不计入同意征集表决权统计范围。

持有人未在截止日日终前递交同意回执、同意回执不规范或表明弃权的，视为该持有人弃权，其所持有的债务融资工具面额计入同意征集表决权统计范围。

4. 除法律法规另有规定外，同意征集方案经持有本期债务融资工具总表决权超过 1/2 的持有人同意，本次同意征集方可生效。

（四）同意征集结果的披露与见证

1. 发行人将在同意征集截止日后的 5 个工作日内在交易商协会认可的渠道披露同意征集结果公告。

同意征集结果公告应包括但不限于以下内容：参与同意征集的本期债务融资工具持有人所持表决权情况；征集方案概要、同意征集结果及生效情况；同意征集结果的实施安排。

2. 发行人将聘请至少 2 名律师对同意征集的合法合规性进行全程见证，并对征集事项范围、实施程序、参与同意征集的人员资格、征集方案合法合规性、同意回执有效性、同意征集生效情况等事项出具法律意见书。法律意见书应当与同意征集结果公告一同披露。

（五）同意征集的效力

1. 除法律法规另有规定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具持有人，包括所有参与征集或未参与征集，同意、反对征集方案或者弃权，有表决权或者无表决权的持有人，以及在相关同意征集结果生效后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。

2. 除法律法规另有规定或本募集说明书另有约定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具的发行人和持有人具有约束力。

3.满足生效条件的同意征集结果，对增进机构（如有）、受托管理人（如有）等第三方机构，根据法律法规规定或当事人之间的约定产生效力。

（六）同意征集机制与持有人会议机制的衔接

1.征集事项触发持有人会议召开情形的，发行人主动实施同意征集后，持有人会议召集人可以暂缓召集持有人会议。

2.发行人实施同意征集形成征集结果后，包括发行人与持有人形成一致意见或未形成一致意见，持有人会议召集人针对相同事项可以不再召集持有人会议。

（七）其他

本募集说明书关于同意征集机制的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具同意征集操作指引》要求不符的，或本募集说明书关于同意征集机制未作约定或约定不明的，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具同意征集操作指引》要求执行。

第十三章 违约、风险情形及处置

一、违约事件

以下事件构成本期债务融资工具项下的违约事件：

1. 在本募集说明书约定的本金到期日、付息日、回售行权日等本息应付日，发行人未能足额偿付约定本金或利息；
2. 因发行人触发本募集说明书中“投资人保护条款”及其他条款的约定（如有）或经法院裁判、仲裁机构仲裁导致本期债务融资工具提前到期，或发行人与持有人另行合法有效约定的本息应付日届满，而发行人未能按期足额偿付本金或利息；
3. 在本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，法院受理关于发行人的破产申请；
4. 本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，发行人为解散而成立清算组或法院受理清算申请并指定清算组，或因其他原因导致法人主体资格不存在。

二、违约责任

（一）【持有人有权启动追索】如果发行人发生前款所述违约事件的，发行人应当依法承担违约责任；持有人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金，或者按照受托管理协议约定授权受托管理人（如有）代为追索。

（二）【违约金】发行人发生上述违约事件，除继续支付利息之外（按照前一计息期利率，至实际给付之日止），还须向债务融资工具持有人支付违约金，法律另有规定除外。违约金自违约之日起（约定了宽限期的，自宽限期届满之日起）到实际给付之日止，按照应付未付本息乘以日利率 0.21‰ 计算。

三、发行人义务

发行人应按照募集说明书等协议约定以及协会自律管理规定进行信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；按照约定和承诺落实投资人保护措施、持有人会议决议等；配合中介机构开展持有人会议召集召开、跟踪监测等违约及风险处置工作。发行人应按照约定及时筹备偿付资金，并划付至登记托管机构指定账户。

四、发行人应急预案

发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急预案，并开展相关工作。

本募集说明书所称“偿付风险”是指，发行人按本募集说明书等与持有人之间的约定以及法定要求按期足额偿付债务融资工具本金、利息存在重大不确定性的情况。

应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协调机制与联系人、信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金安排、拟采取的违约及风险处置措施、增信措施的落实计划（如有）、舆情监测与管理。

五、风险及违约处置基本原则

发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应按照法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定以及协会相关自律管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、诚实守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作，本募集说明书有约定从约定。

六、处置措施

发行人出现偿付风险或发生违约事件后，可与持有人协商采取下列处置措施：

（一）【重组并变更登记要素】发行人与持有人或有合法授权的受托管理人（如有）协商拟变更本募集说明书中与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利

息的金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排的，并变更相应登记要素的，应按照以下流程执行：

1.将重组方案作为特别议案提交持有人会议，按照特别议案相关程序表决。议案应明确重组后债务融资工具基本偿付条款调整的具体情况。

2.重组方案表决生效后，发行人应及时向中国外汇交易中心和银行间市场清算所股份有限公司提交变更申请材料。

3.发行人应在登记变更完成后的 2 个工作日内披露变更结果。

（二）【重组并以其他方式偿付】发行人与持有人协商以其他方式履行还本付息义务的，应确保当期债务融资工具全体持有人知晓，保障其享有同等选择的权利。如涉及注销全部或部分当期债务融资工具的，应按照下列流程进行：

1.发行人应将注销方案提交持有人会议审议，议案应明确注销条件、时间流程等内容，议案应当经参加会议持有人所持表决权超过 1/2 通过；

2.注销方案表决生效后，发行人应当与愿意注销的持有人签订注销协议；注销协议应明确注销流程和时间安排；不愿意注销的持有人，所持债务融资工具可继续存续；

3.发行人应在与接受方案的相关持有人签署协议后的 2 个工作日内，披露协议主要内容；

4.发行人应在协议签署完成后，及时向银行间市场清算所股份有限公司申请注销协议约定的相关债务融资工具份额；

5.发行人应在注销完成后的 2 个工作日内披露结果。

七、不可抗力

（一）不可抗力是指本期债务融资工具计划公布后，由于当事人不能预见、不能避免并不能克服的情况，致使本期债务融资工具相关责任人不能履约的情况。

（二）不可抗力包括但不限于以下情况：

1.自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等；

- 2.国际、国内金融市场风险事故的发生；交易系统或交易场所无法正常工作；
- 3.交易系统或交易场所无法正常工作；
- 4.社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等。

（三）不可抗力事件的应对措施

- 1.不可抗力发生时，本公司或主承销商应及时通知投资者及本期债务融资工具相关各方，并尽最大努力保护本期债务融资工具投资者的合法权益；
- 2.本公司或主承销商应召集本期债务融资工具持有人会议磋商，决定是否终止本期债务融资工具或根据不可抗力事件对本期债务融资工具的影响免除或延迟相关义务的履行。

八、争议解决机制

任何因募集说明书产生或者与本募集说明书有关的争议，由各方协商解决。协商不成的，由发行人住所地法院管辖。

九、弃权

任何一方当事人未能行使或延迟行使本文约定的任何权利，或宣布对方违约仅适用某一特定情势，不能视作弃权，也不能视为继续对权利的放弃，致使无法对今后违约方的违约行为行使权利。任何一方当事人未行使任何权利，也不会构成对对方当事人的弃权。

第十四章 投资人保护条款

本期债务融资工具未设置投资人保护条款。

第十五章 受托管理人机制

本期债务融资工具未设置受托管理人机制。

第十六章 发行有关机构

声明：发行人与本期发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系及其他重大利害关系。

一、发行人

名称:	上海合晶硅材料股份有限公司
注册地址:	上海市松江区石湖荡镇长塔路 558 号
法定代表人:	毛瑞源
注册资本:	人民币 669,195,352 元
联系人:	庄子祯
电话:	021-57843535
传真:	86-21-57843572
邮编:	201617
网址:	ir@wwxs.waferworks.com

二、主承销商及簿记管理人

名称:	中信证券股份有限公司
注册地址:	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人:	张佑君
联系人:	谢雯、张俊晖、黄应桥、田浩楠、范森荣、赵炜
电话:	021-20262207
传真:	021-20262344
邮编:	518048

三、存续期管理机构

名称:	中信证券股份有限公司
注册地址:	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人:	张佑君



联系人:	谢雯、张俊晖、黄应桥、田浩楠、范森荣、赵炜
电话:	021-20262207
传真:	021-20262344
邮编:	518048

四、登记、托管、结算机构

名称:	银行间市场清算所股份有限公司
注册地址:	上海市北京东路 2 号
法定代表人:	马贱阳
联系人:	发行岗
电话:	021-23198888
传真:	021-23198866
邮编:	200002

五、会计师事务所

名称:	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址:	上海市黄浦区南京东路 61 号
法定代表人:	朱健弟
联系人:	郑贤杰
电话:	021-23280000
邮编:	200002

六、律师事务所

名称:	北京市金杜律师事务所
注册地址:	北京市朝阳区东三环中路 1 号 1 幢环球金融中心办公楼东楼 17-18 层
负责人:	龚牧龙
联系人:	从群基
电话:	010-58785588
传真:	010-58785599



邮编:	100020
-----	--------

七、信用评级机构

名称:	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
注册地址:	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22
法定代表人:	朱荣恩
联系人:	杨蕊彤、张智慧
电话:	021-63500711
传真:	021-63610539
邮编:	200001

八、集中簿记建档系统

名称:	北京金融资产交易所有限公司
注册地址:	北京市西城区金融大街乙 17 号
法定代表人:	郭欠
联系人:	发行部
电话:	010-57896722、010-57896516
传真:	010-57896726
邮编:	100032

第十七章 备查文件

一、备查文件

- (一) 中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》;
- (二) 上海合晶硅材料股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券募集说明书;
- (三) 上海合晶硅材料股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券法律意见书;
- (四) 上海合晶硅材料股份有限公司 2023-2025 年度经审计的合并及母公司财务报告、2026 年第一季度未经审计的合并及母公司财务报表;
- (五) 相关法律、规范性文件要求披露的其他文件。

二、查询地址

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人和主承销商。

1、发行人: 上海合晶硅材料股份有限公司

地址: 上海市松江区石湖荡镇长塔路 558 号

法定代表人: 毛瑞源

联系人: 庄子祯

联系电话: 021-57843535

传真: 86-21-57843572

邮政编码: 201617

2、主承销商: 中信证券股份有限公司

地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座



法定代表人：张佑君

联系人：谢雯、张俊晖、黄应桥、田浩楠、范森荣、赵炜

联系电话：021-20262207

传真：021-20262344

邮政编码：518048

3、投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com.cn>）下载本募集说明书，或在本次科技创新债券发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。

附录一 主要财务指标计算公式

指标名称	计算公式
毛利率/营业毛利率	$(\text{营业收入} - \text{营业成本}) / \text{营业收入}$
总资产收益率	$\text{净利润} / \text{年初年末平均总资产}$
应收账款周转率	$\text{营业收入} / \text{年初年末平均应收账款净值}$
存货周转率	$\text{营业成本} / \text{年初年末平均存货净值}$
总资产周转率	$\text{营业收入} / \text{年末平均总资产}$
流动比率	$\text{流动资产} / \text{流动负债}$
速动比率	$(\text{流动资产} - \text{存货} - \text{预付款项} - \text{其他流动资产}) / \text{流动负债}$
资产负债率	$\text{负债总额} / \text{资产总额}$
EBITDA	税、息、折旧及摊销前的收益（利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销）
EBITDA 利息保障倍数	$\text{EBITDA} / (\text{计入财务费用的利息支出} + \text{资本化利息})$

(本页无正文，为《上海合晶硅材料股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券募集说明书》盖章页)



上海合晶硅材料股份有限公司

2026 年 8 月 21 日